

股票代號：3374

精材科技股份有限公司

Xintec Inc.

民國一一〇年度年報

中華民國一一一年三月三十一日 刊印

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

精材公司年報網址：<http://www.xintec.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：林中安

職稱：副總經理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

代理發言人

姓名：林恕敏

職稱：財務協理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1. 總公司：

桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓

電話：(03) 433-1818

2. 工廠：

Line-A：桃園市中壢區吉林路 25 號 電話：(03) 433-1818

Line-B：桃園市中壢區自強二路 1 號 電話：(03) 433-1818

Line-C：桃園市中壢區中園路 188 號 電話：(03) 433-1818

三、辦理股票過戶機構：

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<https://stocktransfer.tssco.com.tw/>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：蔡美貞、林政治

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www2.deloitte.com/tw>

電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無。

六、公司網址：<http://www.xintec.com.tw>

目錄

	<u>頁次</u>
壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
三、公司治理運作情形	18
四、會計師公費資訊	45
五、更換會計師資訊	46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間	47
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形	47
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊	48
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	48
肆、募資情形	
一、股本來源	49
二、股東結構	51
三、股權分散情形	52
四、主要股東名單	52
五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	53
六、公司股利政策及執行狀況	53
七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	54
八、員工分紅及董事、監察人酬勞	54
九、公司買回本公司股份情形	54
十、公司債、特別股、海外存託憑證及併購之辦理情形	54
十一、員工認股權憑證辦理情形	54
十二、限制員工權利新股	54
十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	54
十四、資金運用計畫執行情形	54

伍、營運概況	
一、業務內容	55
二、市場及產銷概況	64
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率	79
四、環保支出資訊	79
五、勞資關係	79
六、資通安全管理	81
七、重要契約	82
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表及會計師姓名及其查核意見	83
二、最近五年度財務分析	86
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告	88
四、最近年度財務報告	89
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	148
六、最近年度及截至年報刊印日止本公司及關係企業之財務週轉情形	148
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	149
二、財務績效	150
三、現金流量	151
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	151
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計 畫	151
六、風險事項	152
七、其他重要事項	154
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	155
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	155
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	155
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項	155
五、其他必要補充說明事項	155

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一一〇年全球仍壟罩在新冠病毒疫情的陰影之中，兩年來種種隔離防疫措施，已造成人們生活及工作模式的重大改變。遠距網路溝通、居家工作、教學、娛樂等需求劇增，相關終端電子消費性產品市場普遍維持著上一年的榮景。公司的感測器 CSP 封裝訂單受惠，去年仍有小幅的成長。車用相關產品封裝也因汽車市場逐漸復甦，訂單在下半年回籠。3D 感測零組件封裝訂單平穩。12 吋晶圓測試業務雖有季節景氣循環波動，測試業務年營收仍較一〇九年增加 26%。同時公司持續不懈地提升營運效率及改善生產成本，全年的整體表現穩健，營收及獲利均較民國一〇九年成長。

經營實績

精材公司一一〇年全年營收為新台幣 7,667 佰萬元，較前一年營收 7,278 佰萬元成長 5.4%；淨利為新台幣 1,877 佰萬元，較前一年度增加 8.7%，每股盈餘為新台幣 6.92 元。

財務收支及獲利能力分析如下：

單位：新台幣佰萬元

分析項目		110年度	109年度	增減比率	
財務 收支	營業收入	7,667	7,278	5.4%	
	營業毛利	2,587	2,215	16.8%	
	稅後淨利	1,877	1,727	8.7%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	23.64%	25.09%	-1.5%	
	股東權益報酬率(%)	33.42%	41.59%	-8.2%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	81.36%	64.97%	16.4%
		稅前利益	81.03%	63.66%	17.4%
	純益率(%)	24.48%	23.74%	0.7%	
稅後基本每股盈餘(元)	6.92	6.37	8.6%		

技術與創新

精材科技專研影像感測器晶圓級封裝，堅持創新與研發。每年投入相當比例資源，依據客戶產品的需求演進，開發新應用製程。整合如各式光阻塗布、曝光、顯影、蝕刻、晶圓接合、厚薄膜貼合、物理與化學鍍膜、鋁金屬導線製程、深穿孔銅製程、特殊材料薄化、與精準切割等技術，提供客戶更完備全方位晶圓級封裝加工服務。其中新一代光學元件薄化加工已於一一〇年邁入量產。壓電微機電元件中段加工製程也順利完成研發。目前正積極開發 12 吋感測器特殊封裝應用、新一代深穿孔技術

(Cu-TSV)、細線寬及多層次導線、新型微機電後段製程、異質封裝整合及氮化鎳製程加工，以期滿足客戶需求與市場趨勢。

企業治理與社會責任

永續發展與成長一直是精材對股東及社會的承諾。除專注技術開發與追求業績成長，亦重視公司治理與企業社會責任。公司連續五年榮獲櫃檯買賣中心「公司治理評鑑」排名前 5% 榮耀。並自一〇四年起每年編製企業社會責任(CSR)報告書，具體揭露公司於企業社會責任之計畫及成果。

身為負責任的企業公民，因應氣候變遷確保地球環境的永續發展，公司將於今年簽署每年 210 萬度再生能源的購電契約，並逐步實現綠色的低碳生產營運模式，預估一一一年可再節省電力 250 萬度以上。今年亦將透過製程優化、減少 30% 製程用水，同時整體製程水回收比率亦持續提升達 65% 以上，有效降低水資源消耗。

公司不斷致力於營造安全的工作環境，除了通過職安衛相關認證，並推行無災害工時活動，已連續 2 年達成無災害工時，並獲頒無災害工時紀錄表揚。在社會公益方面，公司全體同仁以實際行動參與公益活動，舉辦廠區愛心義賣、募集物資捐助弱勢團體、捐贈電腦予 2 家育幼院，並新增 50 多名兒少認養。

公司計畫今年導入 ESG，從環境、社會與公司治理三大面向提出具體的績效。並積極參與責任商業聯盟(RBA)的稽核認證。期望透過全體同仁的持續努力、利益關係人的信任與客戶的支持，成為善盡社會責任的優質企業。

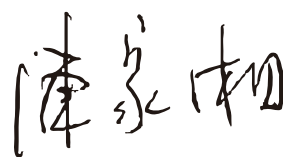
前景與展望

精材聚焦感測器、微機電元件、5G 射頻元件等之封裝與中後段製程加工，將持續投入研發資源以開拓更多相關技術及客戶，期能藉此掌握及接軌未來需求趨勢，達成持續成長之目標。

在 8 吋研發方面，已完成開發之壓電微機電元件加工技術，配合客戶將於一一一年進入小量量產，可望對未來營收有顯著貢獻。公司於一〇九年重新投入 12 吋晶圓車用感測器相關加工技術研發，與客戶密切合作之下，預期今年底導入量產，開啟新商機。新一代深穿孔技術(Cu-TSV)，會應用於客戶合作的專案，計畫 2 年後進入量產。

展望一一一年的營運，車用影像感測器封裝需求應可維持成長，但目前 8 吋晶圓產能嚴重短缺，恐影響公司消費性產品封裝及加工服務的訂單。大環境方面新冠肺炎疫情未熄，又有嚴重全球性通膨新壓力，接續造成終端市場需求的高度不確定性。經營團隊將審慎積極地面對這充滿挑戰的一年。

董事長暨總經理 陳家湘



貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國 87 年 9 月 11 日

二、公司沿革：

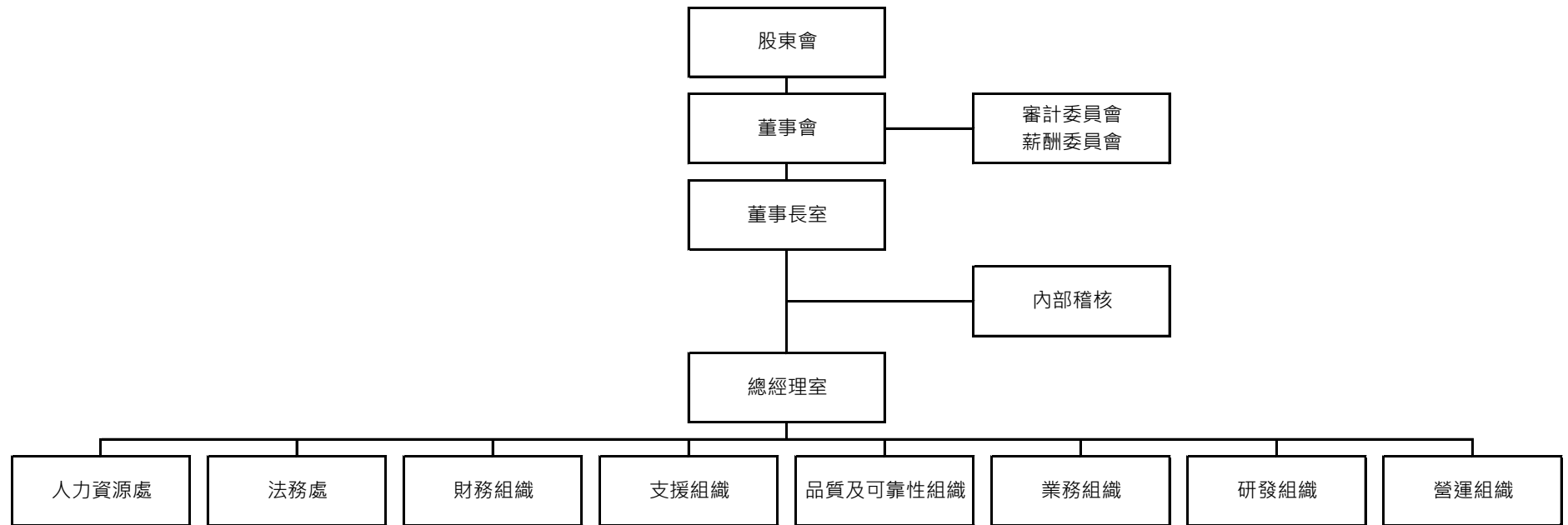
年度 / 月份	重 要 紀 事
87/09	精材科技股份有限公司成立，實收資本額新台幣 280,000 仟元。
89/05	與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. (原以色列商雪兒凱斯 ShellCase Ltd.) 簽定技術授權合約，引進晶圓級封裝技術，並開始從事積體電路封裝業務。
89/10	獲准進駐桃園縣中壢工業區設廠。
90/10	開始進入試產、量產階段。
91/03	通過 ISO9000 品質驗證。
92/02	通過 QS9000 品質驗證。
92/12	經向證期會申報生效後，為股票公開發行公司。
93/07	獲准成立保稅工廠。
93/09	經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准登錄為興櫃股票。
94/01	通過 ISO14001 環境管理系統驗證。
94/12	通過 TL9000 品質管理系統驗證。
94/12	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 持有本公司股份 30% 成為最大股東。
94/12	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 10,000 片。
95/09	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 20,000 片。
95/12	取得中壢 Line-B 廠。
96/01	辦理私募現金增資，策略性引進台灣積體電路製造股份有限公司投資持有本公司股份 43% 成為最大股東。
96/09	8 吋 CSP 月產能達 40,000 片。
96/12	通過 OHSAS18001 職業健康安全管理系統驗證。
96/12	新竹廠 12 吋月產能達 2,000 片。
98/01	通過 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統驗證。
99/11	中壢廠 Line-A 榮獲勞委會勞安衛管理單位績效認證。
99/12	通過 ISO/TS16949 品質管理系統驗證。
100/02	取得中壢 Line-C 廠。
100/03	中壢廠 Line-B 榮獲勞委會勞安衛管理單位績效認證。
100/06	車規 CSP 圖像感測器量產。
100/07	撤銷新竹分公司並將新竹廠辦遷回中壢廠。
101/07	中壢廠區通過 GHG 溫室氣體排放盤查及外部認證機構的查證。
101/09	中壢廠區通過重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證。
102/08	建置 8 吋生物辨識感測器產能。

104/03	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准掛牌上櫃。
106/04	榮獲第三屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5%公司。
107/04	榮獲第四屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5%公司。
107/08	通過 ISO/IATF16949 品質管理系統認證。
108/04	榮獲第五屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5%公司。
108/08	榮獲「108 年統一發票績優營業人獎」。
108/11	通過 ISO45001/TOSHMS 職業安全衛生管理系統改版驗證。
109/05	榮獲第六屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5%公司。
109/06	取得無災害工時紀錄證明。
109/06	建置 12 吋高階晶圓測試產能。
109/08	獲得 SGS ISO45001 Plus Awards。
110/05	榮獲第七屆「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5%公司。
110/11	中壢 Line-C 廠通過勞動部職安衛管理系統績效審查。

參、 公司治理報告

一、 組織系統

(一) 組織結構



(二) 主要部門所營業務：

內部稽核：協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依據。

人力資源處：人力規劃、招募任用、薪酬管理、訓練發展、員工服務及員工關係。

法務處：智權法律事務處理及智權授權談判處理、合約審閱談判管理、公司法律事務處理、法律爭議或訴訟處理。

財務組織：財務及會計帳務服務、稅務管理、投資管理、財務規劃、資金調度及年度成效評估。

支援組織：擬訂物料需求計劃、採購業務管理、進出口及倉儲管理、工廠產能及規劃。規劃、發展及維護企業所需之資訊基礎建設、通訊與後勤資訊系統、營運相關支援系統，並制定公司資訊安全相關政策以確保落實資訊安全。

品質及可靠性組織：品質與可靠性管理。

業務組織：業務發展、客戶協商、訂價指導方針提案與核決、業務支援、生產計劃及管制。

研發組織：專案導入、新製程開發、研發專案技術及光罩模具設計、中長程需求預測與市場情報蒐集、策劃新產品/事業與定義產品發展藍圖。

營運組織：製造封裝、產品工程、設備維護、製程整合、廠務、環安衛及風險管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

1. 董事及監察人資料

111年3月28日

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳家湘	男 61~70歲	106/6/30	108/5/30	3年	0	0	300,000	0.11	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	本公司總經理	無	無	無	註1
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人		96/3/5	108/5/30	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	汪業傑	男 51~60歲	107/11/1	108/5/30	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司智能工程中心處長 台積公司三廠廠長 清華大學材料科學與工程碩士	台積公司營運組織人力資源服務 處處長	無	無	無	
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人		96/3/5	108/5/30	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	王文字	男 61~70歲	102/6/13	108/5/30	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	凱基銀行獨立董事 統一超商公司獨立董事 前行政院公平交易委員會委員 美國史丹福大學法學博士	本公司薪酬委員會召集人 凱基證券獨立董事及薪酬委員會委員 創意電子公司獨立董事及薪酬委員會召 集人 臺灣大學法律學院教授 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人	無	無	無	

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註	
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係		
獨立 董事	中華民國	謝徽榮	男 61~70歲	102/6/13	108/5/30	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	茂達電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 寶勝國際(控股)有限公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席 世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理 美商美國銀行副總經理 臺灣大學商研所碩士 清華大學核子工程系學士	本公司審計委員會召集人及薪酬委員會委員					
獨立 董事	中華民國	溫環岸	女 61~70歲	105/6/14	108/5/30	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	交通大學研究發展處副研發長及電機學院副院長 成功大學電機工程學系博士、碩士及學士	本公司審計委員會及薪酬委員會委員 南茂科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 陽明交通大學電子工程學系教授、社會責任推展辦公室執行長及國際半導體學院副院長					

註1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。5席董事中僅1席具兼任經理人身份，3席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依109年1月2日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人。本公司預計於112年12月31日前增加獨立董事席次為至少4席。

2.法人股東之主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比
台灣積體電路製造股份有限公司 (註1)	花旗託管台積電存託憑證專戶	20.52%
	行政院國家發展基金管理會 代表人：龔明鑫	6.38%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	2.42%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.48%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1.17%
	新制勞工退休基金	1.03%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.95%
	富邦人壽保險股份有限公司 董事長：蔡明興	0.84%
	渣打託管 iShares 新興市場 ETF	0.81%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管歐洲太平洋成長基金投資專戶	0.79%

註1：基準日為110年6月23日。

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

法人名稱	法人之主要股東	持股比
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司董事長：蔡明興	100.0%

4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：陳家湘	具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：汪業傑	具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
王文宇	具法務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	2
謝徽榮	具財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0
溫瓊岸	具公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	1

5. 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

董事會多元化政策：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量

其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。

本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員多元化落實情形：

五位董事中包含1位女性董事。董事具備經營管理、領導決策及產業知識等公司業務所需相關領域，另外，獨立董事個別具備法律、財務會計專業領域。

董事姓名	多元化核心項目								
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財會專業	法律專業
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	3-6年	✓	✓	✓		
汪業傑	男	中華民國	51~60歲	3-6年	✓	✓	✓		
王文宇	男	中華民國	61~70歲	6-9年	✓	✓			✓
謝徽榮	男	中華民國	61~70歲	6-9年	✓	✓		✓	
溫瓊岸	女	中華民國	61~70歲	3-6年	✓	✓	✓		

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會由5位董事組成，其中包含3位獨立董事成員(佔60%)，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，且董事間、監察人間或董事與監察人間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

111年3月28日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳家湘	男	106/7/1	300,000	0.11	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	無	無	無	無	註1
業務組織副總經理	中華民國	林中安	男	95/1/6	125,192	0.05	0	0	0	0	瀚宇彩晶(股)公司資深處長 台積公司製造技術中心薄膜技術委員會經理 成功大學材料工程碩士	無	無	無	無	
營運組織副總經理	中華民國	朱美彥	女	107/12/3	0	0	0	0	0	0	輯方技術(股)公司顧問 精材科技(股)公司產品工程協理 采鈺科技(股)公司產品處長 台積公司製程整合經理 清華大學物理學博士	無	無	無	無	
財務及會計協理	中華民國	林恕敏	男	90/8/1	69,629	0.03	0	0	0	0	致福電子(股)公司會計經理 敦南科技(股)公司會計主任 東吳大學會計系	無	無	無	無	
支援組織協理	中華民國	范振梅	男	108/8/2	16,787	0.01	0	0	0	0	本公司中壢廠區資深廠長/支援組織資深處長 台積公司副理 臺灣工業技術學院電機工程技術系	無	無	無	無	
研發組織協理	中華民國	劉滄宇	男	108/8/2	20,025	0.01	0	0	0	0	本公司研發組織/資深處長 台積公司副理 臺灣大學化學研究所碩士	無	無	無	無	
法務處處長暨公司治理主管	中華民國	周正德	男	109/8/4	5	0.00	0	0	0	0	冠群專利商標/合夥人 將群智權事務所/專利經理 東吳大學法律系	無	無	無	無	
稽核處長	中華民國	黃亮凱	男	103/3/6	675	0.00	0	0	0	0	本公司資材暨資訊處處長 瀚斯寶麗(股)公司供應鏈運籌總管理處處長 台積公司製造策略技術中心經理 清華大學工業工程博士	無	無	無	無	

註1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。5席董事中僅1席具兼任經理人身份，3席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依109年1月2日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人。本公司預計於112年12月31日前增加獨立董事席次為至少4席。

(三) 最近年度(110)給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1. 董事之酬金

110年12月31日 單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及稅後純益之比例		無領取自子公司以外投資或母業公司
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	840	840	120	120	960/0.05%	960/0.05%	4,680	4,680	0	0	7,427	0	7,427	0	13,067/0.70%	13,067/0.70%	無
董事	汪業傑 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	840	840	120	120	960/0.05%	960/0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/0.05%	960/0.05%	無
獨立董事	王文宇	840	840	0	0	0	0	120	120	960/0.05%	960/0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/0.05%	960/0.05%	無
獨立董事	謝徽榮	840	840	0	0	0	0	120	120	960/0.05%	960/0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/0.05%	960/0.05%	無
獨立董事	溫環岸	840	840	0	0	0	0	120	120	960/0.05%	960/0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/0.05%	960/0.05%	無

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。本公司給付獨立董事每人每月報酬及車馬費。

註2：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳家湘-台灣積體電路製造(股)公司代表人、汪業傑-台灣積體電路製造(股)公司代表人、王文宇、謝徽榮、溫瓊岸	陳家湘-台灣積體電路製造(股)公司代表人、汪業傑-台灣積體電路製造(股)公司代表人、王文宇、謝徽榮、溫瓊岸	汪業傑-台灣積體電路製造(股)公司代表人、王文宇、謝徽榮、溫瓊岸	汪業傑-台灣積體電路製造(股)公司代表人、王文宇、謝徽榮、溫瓊岸
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	陳家湘-台灣積體電路製造(股)公司代表人	陳家湘-台灣積體電路製造(股)公司代表人
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總 計	5	5	5	5

2. 監察人之酬金

業於 102 年 6 月 13 日由全體獨立董事組成審計委員會並取代監察人，故不適用。

3.總經理及副總經理之酬金

110年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及特支費等 等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例(%)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳家湘	23,605	23,605	648	648	1,902	1,902	23,393	0	23,393	0	49,548 / 2.6%	49,548 / 2.6%	無
副總經理	林中安													
副總經理	朱美彥													
協理	林恕敏													
協理	范振梅													
協理	劉滄宇													
處長暨公司 治理主管	周正德													

註1：退職退休金金額全數為提列提撥數，並無實際支付數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	周正德	周正德
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林中安、朱美彥、林恕敏、 范振梅、劉滄宇	林中安、朱美彥、林恕敏、 范振梅、劉滄宇
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	陳家湘	陳家湘
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	7 人	7 人

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額占稅後純 益之比例 (%)
經 理 人	總經理	陳家湘	0	23,393	23,393	1.2%
	副總經理	林中安				
	副總經理	朱美彥				
	協理	范振梅				
	協理	劉滄宇				
	財務及會計協理	林恕敏				
	處長暨公司治理 主管	周正德				

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

本公司 109 年度及 110 年度支付董事及監察人之酬金分別為 3,783 仟元及 4,800 仟元，其佔 109 年度及 110 年度稅後淨利比例分別為 0.2%及 0.3%。本公司 109 年度及 110 年度支付總經理及副總經理之酬金分別為 45,179 仟元及 49,548 仟元，佔 109 年度及 110 年度稅後淨利比例分別為 2.6%及 2.6%。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 依公司章程規定，公司如有獲利，提撥不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。本公司董事之報酬係依本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」給付之，且董事報酬給付政策係依其對公

司營運參與程度及貢獻價值，暨國內外業界水準後訂定，將董事績效評估之相關結果納入考量，並經薪資報酬委員會審議及董事會通過。

(2)本公司依公司章程規定，如有獲利提撥不低於百分之一為員工酬勞，本公司經理人之薪資報酬視其個人對本公司營運參與程度、個人績效貢獻與目標達成情況、職務、職級等因素而訂，評估項目如：目標達成率、獲利率、營運效益及貢獻度等綜合考量後，參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審議及董事會通過後執行。

綜合以上，本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險有一定之關聯性。

3.定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：

本公司定期檢討董事及經理人績效評估，薪資報酬委員會於每年第四季報告及討論當年度董事會績效評估作業方式，於年度結束後進行評核，次年度第一季之薪資報酬委員會說明董事會績效評估結果，並於董事會中報告。

經理人之績效評估，於每年第四季由總經理依管理權責作成次年度之經理人績效目標及考核表，經薪資報酬委員會及董事會同意後，於次年度結束後進行考核，於每年第一季薪資報酬委員會中報告及檢視經理人績效評估結果。

薪資報酬委員會每年定期審議董事及經理人績效評估及薪資報酬情形，請參閱薪資報酬委員會開會資訊。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

本公司董事會於 110 年度共召開 5 次(A)董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	5	0	100%	
董事	汪業傑 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	5	0	100%	
獨立董事	王文宇	5	0	100%	
獨立董事	謝徽榮	5	0	100%	
獨立董事	溫環岸	3	2	60%	

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
110 年 2 月 23 日 (第九屆第八次)	1. 核准本公司 109 年度董事酬勞及報酬。 2. 核准本公司具董事身份之經理人及經理人 109 年特別激勵獎金。 3. 核准本公司 109 年度發放之董事報酬及酬勞及 110 年度董事報酬及酬勞政策。 4. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 109 年度之績效評估及 110 年度薪資調整。 5. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 109 年度之員工酬勞。 6. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 109 年度薪資報酬及 110 年度薪資報酬政策。	無	無
110 年 11 月 5 日 (第九屆第十二次)	1. 核准本公司與台灣積體電路製造股份有限公司簽訂 Collaboration Agreement。 2. 核准本公司 111 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費。另，經評估後，蔡美貞會計師及林政治會計師均符合簽證會計師獨立性及適任性要求。 3. 核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 110 年特別激勵獎金。	無	無

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：

(1) 110 年 2 月 23 日召開第九屆第八次董事會決議核准本公司 109 年度董事酬勞及報酬，各董事於有自身利害關係之事項皆已迴避。

(2) 110 年 2 月 23 日召開第九屆第八次董事會決議核准具董事身份之經理人及經理人之 109 年特別激勵獎金，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他出席董事無異議一致通過。

(3) 110 年 2 月 23 日召開第九屆第八次董事會決議核准本公司 109 年度發放之董事報酬及酬勞及 110 年度董事報酬及酬勞政策，各董事於有自身利害關係之事項皆已迴避。

(4) 110 年 2 月 23 日召開第九屆第八次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 109 年度之績效評估及 110 年度薪資調整，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他出席董事無異議一致通過。

(5) 110 年 2 月 23 日召開第九屆第八次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 109 年度之員

工酬勞，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他出席董事無異議一致通過。

(6) 110年2月23日召開第九屆第八次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人109年度薪資報酬及110年度薪資政策，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他出席董事無異議一致通過。

(7) 110年11月5日召開第九屆第十二次董事會決議核准公司與台灣積體電路製造股份有限公司簽訂 Collaboration Agreement，台積公司法人董事代表陳家湘及汪業傑迴避本案之討論及表決，其他出席董事無異議一致通過。

(8) 110年11月5日召開第九屆第十二次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人之110年特別激勵獎金，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他出席董事無異議一致通過。

3. 董事會自我(或同儕)評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	董事會、個別董事成員	董事會內部自評、董事成員自評	(1)董事會整體績效評估包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 (2)董事成員績效評估包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1) 本公司已於100年11月11日成立薪酬委員會，以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及經理人之報酬。

(2) 本公司102年度業經股東會通過設置審計委員會，並由三位獨立董事組成，強化董事會公司治理職能。

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 財務報表；
- 稽核及會計政策與程序；
- 內部控制制度暨相關之政策與程序；
- 重大之資產或衍生性商品交易；
- 重大資金貸與背書或保證；
- 募集或發行有價證券；
- 衍生性金融商品及現金投資情形；
- 法規遵循；
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能性；
- 申訴報告；
- 防止舞弊計畫及舞弊調查報告；
- 資訊安全；
- 公司風險管理；
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評估；
- 簽證會計師之委任、解任或報酬；
- 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- 審計委員會職責履行情形。

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	王文宇	4	0	100%	
獨立董事	謝徽榮	4	0	100%	
獨立董事	溫瓊岸	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
110年2月23日 (第三屆第八次)	1. 請同意本公司一〇九年度之營業報告書及財務報表。 2. 請同意本公司一〇九年度之盈餘分派案。 3. 請同意本公司一〇九年度之「內部控制制度聲明書」。	無	出席委員一致決議照案通過	無
110年8月5日 (第三屆第十次)	1. 請同意本公司民國一一〇年度第二季財務報告。	無	出席委員一致決議照案通過	無
110年11月5日 (第三屆第十一次)	1. 請同意本公司一一一年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費。另，經評估後，蔡美貞會計師及林政治會計師均符合簽證會計師獨立性及適任性要求。 2. 請同意本公司與與台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司)簽訂 Collaboration Agreement (“Agreement”)，並推舉獨立董事王文宇先生代表本公司簽署 Agreement。	無	出席委員一致決議照案通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

2.會計師定期與審計委員會溝通說明財務報表查核情形及其相關法令要求事項，且獨立董事得隨時要求會計師進行報告與溝通。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要，請參考本公司網站：

https://www.xintec.com.tw/chi/CSR_CG_Committees.aspx

(三) 監察人參與董事會運作情形：

本公司於 102 年 6 月 13 日已設置審計委員會，故不適用監察人制度。

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公開資訊關測站及公司網站揭露公司治理實務守則。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司設有發言人制度，統一由發言人或代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司每月向董事及持股10%以上大股東取得持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，並與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 制定及落實內部控制制度及相關管理辦法，稽核單位並定期監督執行情形。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 公司定有內部重大資訊處理作業程序，以規範內部重大資訊保密作業程序，並定期宣導不得利用市場上未公開資訊買賣本公司之有價證券。	
三、董事會之組成及職責				無重大差異
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一) 董事會多元化政策： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																					
	是	否	摘要說明																																																																						
			<p>經驗與閱讀財務報表能力等條件。</p> <p>本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>董事會多元化落實情形：</p> <table border="1" data-bbox="972 954 1787 1189"> <thead> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th colspan="9">多元化核心項目</th> </tr> <tr> <th>性別</th> <th>國籍</th> <th>年齡</th> <th>年資</th> <th>經營管理</th> <th>領導決策</th> <th>產業知識</th> <th>財務會計</th> <th>法律</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陳家湘</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>3~6年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汪業傑</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>51~60歲</td> <td>3~6年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>王文宇</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>6~9年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>謝徽榮</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>6~9年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溫環岸</td> <td>女</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>3~6年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>董事會多元化管理目標與目前達成情形</p> <p>董事會成員目前已達成多元化的要求；未來於董事改選提名時，將持續考量公司長期發展目標、董事專業的互補性等，以強化董事會成員多元化之目標。</p>	董事姓名	多元化核心項目									性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	陳家湘	男	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓			汪業傑	男	中華民國	51~60歲	3~6年	✓	✓	✓			王文宇	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓			✓	謝徽榮	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓		✓		溫環岸	女	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓			
董事姓名	多元化核心項目																																																																								
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律																																																																
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓																																																																		
汪業傑	男	中華民國	51~60歲	3~6年	✓	✓	✓																																																																		
王文宇	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓			✓																																																																
謝徽榮	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓		✓																																																																	
溫環岸	女	中華民國	61~70歲	3~6年	✓	✓	✓																																																																		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	(二) 公司雖未設置其他功能性委員會，惟透過獨立董事及審計委員會的運作，可有效監督公司業務之執行。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三) 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於109年2月通過董事績效評估辦法，以提昇董事會功能，強化董事會運作效率。內部評估董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制。董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下四大面向：A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制。自民國102年起每年執行一次，定期辦理董事自評與同儕互評，評估結果於第一季檢討並提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，民國110年度本公司內部董事會績效評估結果為「良」，董事成員績效評估結果為「良」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師每年提供「超然獨立聲明書」外，另製作「會計師獨立性及適任性評估表」，針對可能影響獨立性項目逐一評估簽證會計師之獨立性，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求，認為符合獨立性及適任性之要求，並提報審計委員會及董事會討論通過。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司董事會於 109 年 8 月 4 日決議通過任命法務處處長周正德先生為公司治理主管。本公司所有董事皆可取得公司治理主管之協助，以確保董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守，並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流良好。</p> <p>本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事法務之主管經驗達三年以上。</p> <p>本公司董事會指定議事事務單位由董事會秘書單位負責，由財務組織協理擔任董事會秘書。董事會秘書單位負責統籌提供董事執行業務所需資料及公司治理相關事務，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。 五、協助董事、獨立董事遵循法令。 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 <p>年度公司治理業務執行情形彙整如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 20%;">依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜</th> <th style="width: 15%;">協助董事就任及完成持續進修時數</th> <th style="width: 45%;">協助董事遵循法令及執行職務</th> <th style="width: 10%;">辦理公司登記及變更登記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">5 次董事會， 1 次股東會</td> <td style="text-align: center;">36 小時</td> <td>每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。 修訂本公司「職務授權及代理管理辦法」</td> <td style="text-align: center;">未有需辦理變更登記事項。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司參加 105 年至 109 年主管機關之公司治理評鑑結果，均列於前 5%。</p>	年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記	110	5 次董事會， 1 次股東會	36 小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。 修訂本公司「職務授權及代理管理辦法」	未有需辦理變更登記事項。	無重大差異
年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記										
110	5 次董事會， 1 次股東會	36 小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。 修訂本公司「職務授權及代理管理辦法」	未有需辦理變更登記事項。										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設置違反從業道德行為舉報系統，提供客戶、廠商或其他利害關係人檢舉本公司人員不當行為之管道。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√ √ √		(一) 本公司已架設公司中英文網站，並責成相關部門維護及揭露公司財務業務等相關資訊。 (二) 本公司已指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，並設有發言人及代理發言人制度，公司亦將定期召開法人說明會之簡報及影音檔放置於公司網站。 (三) 本公司年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報，第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前提早公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 在環境保護方面，遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求，並持續關注國際環保發展趨勢，強化綠色環保責任，並致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。 (二) 在勞動權益方面，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以提供平等就業機會及預防傷害事故與職業疾病的發生。 (三) 在員工權益方面，成立職工福利委員會、實施退休金制度、	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>辦理員工團體保險及定期舉辦健康檢查，並提供各項員工訓練課程等持續進修管道。</p> <p>(四) 在供應商管理方面，本公司設有供應商考核制度確保供應商能符合本公司的品質及環境政策，訂有供應商評鑑制度以確保稽核之執行，並與供應商維持順暢的溝通管道，保持良好的上下游關係，促進產業鏈永續發展。</p> <p>(五) 在資訊保密方面，尊重與保護客戶之技術文件與資料。對外，本公司與客戶及供應商簽有保密協議，明訂具法律效力的權利及義務；對內，本公司設有機密資訊保護委員會，要求員工遵守相關保密規定，並落實保全管理，以保障公司及客戶之機密資訊安全。</p> <p>(六) 本公司依法令規定公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權利。</p> <p>(七) 本公司每年舉辦董事進修相關課程，雖未強制要求董事進修專業知識課程，但係以積極態度鼓勵董事依個人需求參與。</p> <p>(八) 本公司為落實公司治理，已為本公司董事投保責任保險。</p>	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司自 105 年度起參加主管機關主辦之公司治理評鑑，歷屆評鑑結果均獲得上櫃組前 5% 之殊榮。

持續針對 110 年度未得分之項目進行改善，茲就以下項目未得分項目之改善情形說明如下：

優先加強事項與措施：

評鑑指標內容	改善措施執行情形
公司是否未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	公司計畫 112/12/31 前增加一席獨立董事，以符合法令規定董事長兼任總經理，獨立董事人數不得少於 4 人。

(五) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
薪資報酬委員會：

1.組成：本公司於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，並於 108 年 5 月 30 日改選後由王文宇先生(召集人)、謝徽榮先生及溫瓊岸女士三位獨立董事組成薪酬委員會。

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事及薪資報酬委員會召集人	王文宇	(註一)	(註一)	2
獨立董事	謝徽榮	(註一)	(註一)	0
獨立董事	溫瓊岸	(註一)	(註一)	1

註一：參閱第 10 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊之揭露

2.職權範圍：

- (1)定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- (2)定期評估並訂定公司整體薪酬政策。
- (3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (4)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員共計三人，每年至少開會 2 次。
- (2)本屆委員任期：108 年 5 月 30 日至 111 年 5 月 29 日，110 年度薪資報酬委員會共開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	王文宇	2	0	100%	
委員	謝徽榮	2	0	100%	
委員	溫瓊岸	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

4.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	項次	議案內容及後續處理
110年2月23日 第四屆第七次	一	審議本公司具董事身份經理人及經理人109年特別激勵獎金，並提請董事會決議。
	二	審議本公司提撥109年度員工酬勞案，並提請董事會決議。
	三	審議本公司董事之109年度董事報酬及酬勞及110年度董事報酬及酬勞政策案，並提請董事會決議。
	四	審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度績效評估及110年度薪資調整案，並提請董事會決議。
	五	審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度員工酬勞，並提請董事會決議。
	六	審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度薪資報酬及110年度薪資報酬政策案，並提請董事會決議。
		薪酬委員會決議結果：除第三案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，其餘委員會全體成員同意通過。
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：除第一案、第四案、第五案及第六案因陳家湘董事長涉及自身利害關係之事項，自行迴避討論及表決，第三案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
110年11月5日 第四屆第八次	一	審議本公司111年薪酬預算。
	二	審議本公司具董事身份經理人及經理人110年特別激勵獎金，並提請董事會決議。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。	
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：除第二案因陳家湘董事長涉及自身利害關係之事項，自行迴避討論及表決，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。

提名委員會：本公司並未設立提名委員會。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會督導情形？	V		<p>本公司已成立企業社會責任委員會(預計 111 年起更名為永續發展委員會(ESG Committee))，每季召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項永續發展相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人之各項議題管控，落實高階經理人之承諾，促進經濟、環境與社會之間的平衡與企業永續發展之實踐。</p> <p>本公司訂有企業永續發展政策，也將依該政策持續推動、改善以俾追求提升公司競爭力與回饋社會的理念，實踐企業應負之社會責任，並將實踐成果每年定期至董事會報告，內容有環境保護與節能減碳、員工關懷與發展、安全職場、供應鏈管理、社會公益及利害關係人關注議題等。</p> <p>企業社會責任委員會組織圖</p> <pre> graph TD Board[董事會] --> Chair[董事長] Board --> Comp[薪酬委員會] Board --> Audit[審計委員會] Chair --> CSR[CSR委員會] CSR --> Econ[經濟治理組] CSR --> Env[環境保護組] CSR --> Social[社會參與組] Econ --> Exec[相關關切議題執行部門] Env --> Exec Social --> Exec </pre>	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</p> <p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p>	V		<p>本委員會之具體推動計畫及實施成效請見網站：https://www.xintec.com.tw/chi/CSR_CSR_Policy_Reports.aspx</p> <p>本公司訂有企業永續發展政策及ESG Committee，且於109年成立風險管理委員會，於每季召開一次會議。相關風險管理策略請參見第38頁之附表。</p>	無重大差異
	V		(一) 公司已建立健全環境管理程序及制度，並已於94年1月取得ISO14001環境管理系統驗證迄今。	無重大差異
	V		(二) 公司致力於提升資源使用及再利用之效能，已訂定相關資源使用管理程序及設置水資源回收再利用系統。2021年共執行13項節水節電相關措施，均已完成，節省效益為新台幣22.54百萬元。	
	V		(三) 嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用ISO14001環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。 引用國際標準ISO/CNS14064-1建立、實施及維持溫室氣體盤查管理系統，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。 公司以優化製程，逐年更換節能設備為目標，訂立廠區與辦公室各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量。	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) 公司於101年度完成GHG溫室氣體排放盤查、重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證，並以104年度為基準年。</p> <p>每年度持續執行溫室氣體排放量盤查與查證，公司全廠區 2019 年及 2020 年溫室氣體排放量分別為 114,334 及 160,207 ton-CO₂e，其排放密集度分別為 24.57 及 22.01(ton-CO₂e/百萬營收) (因 2021 年溫室氣體排放量尚未經外部認證機構的查證，故未揭露相關數據)，並通過不斷提高資源循環利用，減少溫室氣體排放、廢棄物產生、廢水排放和化學品的使用，以提高製程的生態效益，預計在 2030 年達到範疇一溫室氣體排放量較基準年減少 80%之目標。</p> <p>公司全廠區於2020年及2021年外部水源用水量(包含自來水及井水)分別為 2,846,406 公噸及 2,631,095 公噸，用水密集度分別為 391.1 公噸/百萬營收及 343.2 公噸/百萬營收，每百萬營收的用水量減量 12.3%。公司全廠區於 2020 年及 2021 年廢棄物分別為 1,384 公噸(有害廢棄物 947 公噸，非有害廢棄物 437 公噸)及 1,255 公噸(有害廢棄物 806 公噸，非有害廢棄物 449 公噸)，廢棄物密集度分別為 0.19 公噸/百萬營收及 0.16 公噸/百萬營收，每百萬營收的廢棄物減量 13.9%。</p> <p>我們以 ISO 14001 環境管理系統為基礎並採用了「P-D-C-A」的管理模式，以推動我們於污染防治上持續進步。每年達成節能減碳 1%、廢棄物減量 2%及減少用水 3%之量化管理目標，直至合理可行水位。</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 公司為樹立制度，健全組織，保障員工合法權益，特遵照勞動基準法、政府法令、『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及『責任商業聯盟及其行為準則』，訂定工作規則及招募聘僱政策，以作為全體同仁管理與遵守之依據，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、考核、升遷等，不因性別而有差別待遇（但工作性質僅適合特定性別者，不在此限）。本公司不得雇用童工從事工作，招募員工不得有歧視之行為，視實際業務需要而遴用，並以公開甄選方式力求機會均等，使人盡其才為選用原則。新進同仁需先經甄試或審核合格，再依公司新人進用規定，經簽呈核准後正式僱用之。本公司禁用被強迫、抵押、契約約束或非自願勞工，所有的工作必須自願的，並且員工基於適切告知擁有自由離職之權利。本公司承諾營造杜絕騷擾與虐待的工作環境。不得威脅或令其工作人員遭受嚴酷或非人道待遇。</p> <p>110年度RBA責任商業聯盟行為守則訓練(含誠信經營、法律和客戶要求、勞動人權、無不正當利益、公平交易、禁止內線交易等相關宣導)，計1,681人次，共3,362人時。</p>	無重大差異
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V	<p>(二) 公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞。</p>		

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>本公司員工之薪資報酬，乃依據個人工作績效表現、對公司的貢獻度、職務、職級等因素而訂，與經營績效成果之關聯性成正相關，主要包含基本薪資、津貼、獎金、員工酬勞及福利等。基本薪資主要以員工所擔任職位之同業市場水準及公司政策予以釐薪；津貼部分主要考量工作相關事項；獎金與員工酬勞則是連結員工工作績效、部門目標達成及公司經營成果計算發給；福利項目主要以符合法令規定為前提，並兼顧員工的需求。</p> <p>本公司女性員工超過50%，女性高階經理人占比為14%。公司提供優於勞基法的特別休假制度，員工到職滿兩個月即可享有特別休假，方便員工於一年中排定假期。我們並依法給予各種假別，當同仁有請假需求時，能夠更無後顧之憂。此外，員工補助津貼包含婚喪喜慶補助、三節禮券、生日禮券及社團經費補助。</p> <p>(三) 公司每年定期舉辦員工健檢與特殊作業體檢，依法設置駐廠醫師與專任護理師，規劃健康促進活動及配合政府推展防癌、戒菸、傳染病預防等相關活動，以符合員工健康需求，亦提供的良好的職場環境，並獲頒企業健康職場自主認證標章；每月參與全廠環安衛會議，以稽查、追蹤、檢討與改善部門環安衛相關議題，以確保同仁身心健康及防範於未然。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四) 為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計畫，讓員工與公司一同成長。</p> <p>本公司年度訓練計畫包含主管及同仁訓練，110年共舉</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		辦了72個班次的實體訓練課程。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		(五) 公司遵循品質系統要求，建有完善之缺陷防範機制及客訴反應系統，配合上下游整套供應鏈檢核機制為消費者層層把關且迅速回應。並秉持誠信正直的理念來對待客戶，以客戶為導向，提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。 (六) 公司在供應商企業社會責任行為準則中有相關規定。並於供應商責任條款中要求供應商之營運應透明、公開，注重股東權益，並努力達到企業的社會責任。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		本公司企業社會責任報告書依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI)準則標準(Standards)之核心選項，並經第三方驗證機構英國標準協會(British Standards Institution, 簡稱 BSI)保證，通過 AA 1000 AS Type 1 中度保證等級。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於111年第一季將企業社會責任實務守則修訂為永續發展實務守則，運作情形皆依循永續發展實務守則辦理。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： <ul style="list-style-type: none"> • 為落實綠色地球之環保意識，已全面採用環保筷以減少衛生筷之使用，並落實垃圾分類與減量、減排、綠化、循環、節約用水、用電等環境保護措施。 • 配合政府 "1+1" 晉用身障宣導方案執行成功，獲頒績優獎狀一面。 • 連續進用中壢啟智訓練中心身障員工並捐助課桌椅給中壢啟智訓練中心，獲頒感謝狀。 • 96年建置中壢標準廠辦園區中庭水景綠美化工程，經費超過新台幣200萬元，並持續每月回饋植栽園丁一名。 • 參與98年北區工業局舉辦企業綠美化競賽，獲得績優廠商第一名以及全國第四名。 • 參與捐助99年新竹縣之公益活動國際身心障礙日獎品。 • 熱心公益，當選100年中壢標準廠房管理委員會主委。 				

推 動 項 目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<ul style="list-style-type: none"> · 每年回饋中壢標準廠辦園區綠美化植栽捐款活動。 · 長期認養中壢標準廠辦園區員工宿舍旁綠帶，種植蔬果綠化有成。 · 長期認養中壢工業區自強二路Line-B廠房，週邊人行道之路樹修剪與植栽綠美化。 · 創造中壢新竹地區民眾就業機會，分別與6所高職學校建教合作，善盡學生與老師實務理論相輔相成之企業責任。 · 不定期參與台中博物館導覽義工及台積電志工社慰問榮民之家。 · 不定期參與桃園怡德養護中心與新竹慈善社會團體之慰勞老人活動。 · 發動公司與員工共同捐助八八水災，發揮人飢己飢人溺己溺的精神，捐款總額約計新台幣100多萬元，協助災後重建。 · 針對員工之安全與健康，提供舒適安全的工作環境、教育員工並加強對環保及安全認知。 · 101年響應萬海慈善基金會公益活動募集寒冬送暖二手外套活動。 · 102年海燕颱風重創菲律賓災情慘重，發動員工捐助菲國風災，捐贈總額約新台幣3萬多元。 · 依事業廢棄物清理計畫書內容執行廢棄物清理，並依法上網申報廢棄物流向，合法清理廢棄物及回收資源廢棄物。 · 102年8月完成中壢廠區揮發性有機化合物(VOC)排放處理設施性能提昇投資建設，排放處理效率有效達到90%以上，達到節能減碳及降低空氣污染排放之目的。 · 103年發動員工高雄8/1氣爆愛心捐款，捐贈總額約計新台幣60多萬元，協助災後重建。 · 104年發動八仙樂園粉塵氣爆愛心捐款，捐贈總額約計新台幣100萬元，協助傷者日後重建人生之路。 · 105年為扶助偏鄉學校推展校務及運動，捐贈新台幣20萬元支持關西國中棒球隊。 · 106年志工社舉辦愛心義賣金額新台幣71,623元，協助弱勢團體。 · 107年邀集伊甸基金會等18個公益團體，辦理愛心義賣活動3場次，募得款項新台幣212,800元均全數捐贈。 · 108年邀集路得啟智學院、觀音愛心家園、自閉症協進會、勵馨基金會及創世基金會參與公益活動、義賣及植樹節活動，募得款項新台幣144,596元全數捐贈。 · 108年蒐整桃園地區社福機構實際物資需求，發起物資募集、捐贈活動，捐贈物資至鄰近樂活育幼院、睦祥育幼院。 · 109年發起物資募集助社福機構實際物資需求、定期物資捐贈至鄰近樂活育幼院、睦祥育幼院、參與愛心義賣志工活動，認購公益團體物資，所募得款項全數捐贈。 · 連續8年晉用視障按摩師，提供視障人員穩定就業機會。 · 連續10年獲得衛生署國民健康局頒給之「健康職場自主認證標章」殊榮。 · 連續6年舉辦同仁愛心捐血活動，鼓勵同仁捐血救人，積極參與公益。 · 110年精材響應力挺防疫，發起咖啡捐贈募集活動，提供近500杯咖啡至桃園區域醫院、警察局與消防隊之辛苦，溫暖醫警消的心。

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
				<ul style="list-style-type: none"> · 發起6次愛心捐贈及義賣活動所得\$367,270全數捐贈予小胖威利病友關懷協會、喜憨兒社會福利基金會、兒童福利聯盟文教基金會等。 · 發起2次物資捐贈活動，募集尿布、奶粉及祭祀供品白米、麵條、調味品及零食持續捐贈至鄰近樂活育幼院、睦祥育幼院。 · 響應財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會之百元俱樂部助養活動，依月定期助/認養家扶孩童計58名(\$116,000)。 · 捐贈電腦至樂活育幼院、睦祥育幼院共計10組，提供育幼院孩童因疫情線上學習課程使用。

風險管理策略

面向	風險項目	說明	因應策略
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立公司治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員作業確實遵守相關法令規定	公司指定法務處周正德先生為公司治理主管，由人力資源處負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，並每年一次向董事會報告。本公司訂有「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」等規章制度以供員工遵循，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。本公司定期或不定期針對員工進行誠信經營相關教育訓練，也設置內部申訴及外部檢舉管道，並對申訴人或檢舉人及其提供之檔案予以加密保護，以落實誠信經營。
財務風險	匯率變動	本公司營收主要係以美元計價，部分製造成本亦以外幣支付，因此，任何顯著的國際匯率變動均可能對公司損益造成不利之影響。	本公司主要以進貨所產生之應付帳款(外幣負債)與收入所產生之應收帳款(外幣資產)相互沖抵，發揮自然避險之效果，以降低匯率變動風險。同時密切注意匯率趨勢，定期檢視非功能性貨幣計價之資產及負債之部位變化，使用遠期外匯合約等衍生金融工具或買賣即期外匯管理匯率風險，以降低匯率波動對損益的影響。
	利率變動	利率的變動對公司損益影響可分為兩部分，營業外收入部分，約當現金利息收入隨利率上升而增加，利息費用則將因利率上升而增加。	為避免未來利率走高，增加融資成本之不確定性，本公司持續關注利率走勢，未來將視市場狀況及中長期負債部位，決定是否向銀行簽定利率交換交易，以部份規避利率波動之風險，降低升息之不利影響。
營運風險	技術開發	半導體業技術發展速度快，客戶需求快速變動，同業間競爭激烈，對於先進製程之需求不斷提高。	配合市場以及客戶感應器(Sensor)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術並購入相關設備，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。
	供應商管理	原物料供應商及生產設備有單一供應商之情形，可能造成營運生產之斷料或不穩定之風險。	透過新供應商開發及現有供應商生產及品質系統的稽核，減少單一供應商比例，同時降低現有供應商缺料及品質不穩定風險。
	業務風險	客戶過於集中。	積極開發多元化的產品與客戶群，以分散業務集中風險。
	法律風險	遵循所有適用的法規。 法令法規修正。	各部門須就其業務範圍內適用之法規進行監控，法務部門亦會不定期至相關網站下載適用法規之最新法律規定，並轉寄給有關單位以利各單位進行風險辨識、評估，訂定

環境風險	氣候變遷	氣候變遷所導致之影響不容小覷，全球隨著溫室氣體排放量日趨益增，溫室效應明顯加劇導致全球暖化，使全球地表平均溫度升高、海洋酸化、冰層消融、海平面上升等顯著環境變遷，影響範圍涵蓋海洋與陸地，全球暖化所引發極端氣候近年來更是頻繁易見，首當其衝者為周遭環境生態遭受破壞，進而甚至可能波及社會經濟活動與人類安全。	<p>策略並為風險處理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用 ISO14001 環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。 2.引用國際標準 ISO/CNS14064-1 建立、實施及維持溫室氣體盤查管理系統，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。 3.評估氣候變遷對公司可能帶來之機會與風險，於營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子；積極推動綠色製程及各項環保節能減碳措施，評估綠電購買，提升尾氣削減設備安裝率，逐年更換節能設備，並訂立廠區各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量，以減緩與調適氣候變遷所帶來之營運衝擊。
	水資源	極端型氣候造成水資源匱乏	<ol style="list-style-type: none"> 1.透過回收設備建立與改善，增加水回收次數並減少自來水用量。 2.改善製程用水量，降低生產時對於水的使用量。
社會風險	員工招募	公司的成長與發展需仰賴全體同仁的努力與貢獻，即時招募適當充足的人才更是營運發展重要的一環。惟，在人力市場激烈競爭時，或有無法即時滿足人力需求的風險。	配合人力規劃及各單位業務所需，定期審視人力供需情形，如有人才需求，除對外招募外，亦可同時對內進行工作輪調或教育訓練，再佐以定期進行薪資調查，以確保公司營運不受人力短缺影響且具有競爭力以吸引人才。
	勞動安全	精材公司重視勞動安全，認為做好安全與衛生管理是照顧員工及其家庭應有的作為，也是對社區與社會承諾的直接回饋。	<ol style="list-style-type: none"> 1.精材所有廠區均取得職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001：2007）與「台灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS）」雙系統認證，並將於108年更新至ISO 45001。 2.透過持續改善安全衛生管理系統，以風險管理精神為基礎，持續進行改善，杜絕可預見的危險與損失控制，達成預防意外事故、促進員工安全、衛生及保護公司資產的目標。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。</p> <p>(二) 本公司「工作規則」規定不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式的賄賂。</p> <p>(三) 誠信正直係本公司企業文化中最重要核心價值，會於新進員工教育訓練及全體在職員工訓練中宣導，並建立完善的違規懲戒及申訴制度。</p>	無重大差異

<p>二、落實誠信經營</p>			無重大差異
<p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	V	<p>(一) 本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分了解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。</p>	
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V	<p>(二) 本公司為健全與落實誠信經營之管理，由人力資源處負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，且每年一次向董事會報告。</p>	
<p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	V	<p>(三) 本公司已於「工作規則」明訂應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之間的衝突，並完成年度迴避利益衝突申報。董事會各項議案，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。</p>	
<p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	V	<p>(四) 本公司均依照會計制度、內部控制制度運作，內部稽核人員定期於防範內線交易管理及其他稽核循環查核其遵循情形，並未發現員工或管理階層有違反誠信經營事項。</p>	
<p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V	<p>(五) 公司每年均定期舉辦誠信經營之教育訓練，以落實誠信價值，並將重點宣導事項製作宣導DM，宣導於同仁執行業務時應注意。</p>	

<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>√</p>	<p>本公司已於「工作規則」明訂懲戒制度，並於公司網站中載明若有任何人發現本公司員工或利害關係人進行任何疑似或可能違反本公司從業道德之行為時，請務必通知本公司；且此舉報行為，將交由董事長或其指定之高階主管直接進行調查、處理及預防再發之對策，對於檢舉人均予以保密，免於遭受不當之處置。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>√</p>	<p>(一) 已於本公司架設之網站中，揭露公司之經營理念係以誠信/創新/客戶導向為宗旨，並於年報及公開說明書中揭露誠信經營情形。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，與上市上櫃公司誠信經營守則並無差異。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。</p>			

(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：請參閱公開資訊觀測站或至本公司網站查詢。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

精材科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一一年二月十日

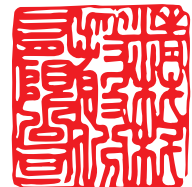
本公司民國一一〇年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一〇年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一一年二月十日董事會通過，出席董事五人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精材科技股份有限公司

董事長：陳家湘

總經理：陳家湘



簽章



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

本公司股東會於110年度至年報刊印日止共召集一次常會，重要決議及執行情形如下：

1.盈餘分配或盈虧撥補：核准109年度盈餘分派案。

執行情形：決議通過。本公司民國109年度稅後淨利為新台幣1,727,445仟元，減列確定福利計劃之再衡量數新台幣3,262仟元後，民國109年度可分配盈餘為新台幣1,724,183仟元，經提撥法定盈餘公積新台幣172,418仟元後，加計以前年度未分配保留盈餘新台幣163,086仟元後，期末未分配盈餘為新台幣1,714,851仟元。考量109年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自109年度可分配盈餘中提撥新台幣678,411仟元，每股分派現金股利新台幣2.5元。其配息基準日訂定為民國110年9月6日。

2.章程修訂：無。

3.營業報告書及財務報表：承認109年度營業報告書及財務報表。

執行情形：承認民國109年度營業報告書及財務報表，其中全年營收為新台幣7,277,589仟元，稅後淨利為新台幣1,727,445仟元，每股淨利為新台幣6.37元。

4.董監事選舉：無。

5.其他事項：無。

本公司於110年度至年報刊印日止共召開六次董事會，重要決議摘要有：

核准109年度之營業報告書及財務報表、核准109年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准109年度盈餘分派案、核准召集110年股東常會、核准資本支出預算、核准110年度財務計畫、核准具董事身份之經理人及經理人之109年特別激勵獎金、核准109年度發放之董事報酬及酬勞及110年度董事報酬及酬勞政策、核准具董事身份之經理人及經理人109年度之績效評估及110年度薪資調整、核准具董事身份之經理人及經理人109年度之員工酬勞、核准具董事身份之經理人及經理人109年度薪資報酬及110年度薪資報酬政策、核准109年度之「內部控制制度聲明書」、核准取得銀行額度、核准110年股東常會召開日期、時間及地點、核准本公司與台積公司簽訂Collaboration Agreement、核准111年度簽證會計師服務公費、核准具董事身份之經理人及經理人之110年特別激勵獎金、核准修訂「職務授權及代理管理辦法」、核准111年度稽核計畫、核准110年度之營業報告書及財務報表、核准110年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准110年度盈餘分派案、核准應選董事五人(含獨立董事三人)，並於111年股東常會辦理改選、核准召集111年股東常會、核准111年度財務計畫、核准具董事身份之經理人及經理人之110年9月至12月特別激勵獎金、核准110年度發放之董事報酬及酬勞及111年度董事報酬及酬勞政策、核准具董事身份之經理人及經理人110年度之績效評估及111年度薪資調整、核准具董事身份之經理人及經理人110年度之員工酬勞、核准具董事身份之經理人及經理人110年度薪資報酬及111年度薪資報酬政策、因配合會計師事務所內部輪調需要，核准自111年起委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及黃裕峰會計師辦理本公司財務報表簽證、核准修訂「永續發展實務守則」、核准修訂「公司治理實務守則」、核准110年度之「內部控制制度聲明書」。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、簽證會計師公費資訊：

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞	林政治	110 年度	2,280	540	2,820	

註：本年度非審計公費為稅務簽證440仟元、覆核年報80仟元及出具非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表20仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	不適用		
更換原因及說明	不適用		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情況		委任人
	主動終止委任		不適用
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	√	
說明	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	不適用
會計師姓名	不適用
委任之日期	不適用
就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	110 年 度		111 年度截至3月28日止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
董 事	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0
	代表人-陳家湘	0	0	0	0
	代表人-汪業傑	0	0	0	0
獨立董事	王文宇	0	0	0	0
獨立董事	謝徽榮	0	0	0	0
獨立董事	溫環岸	0	0	0	0
總 經 理	陳家湘	0	0	0	0
副總經理	林中安	0	0	0	0
副總經理	朱美彥	0	0	0	0
協 理	劉滄宇	0	0	0	0
協 理	范振梅	0	0	0	0
財 務 及 會 計 協 理	林恕敏	(3,000)	0	0	0
處 長 暨 公 司 治 理 主 管	周正德	0	0	0	0
大 股 東	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

111年3月28日；單位：千股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱	關係	
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：劉德音	111,282	41.01	0	0	0	0	無	無	
曾孟超	3,130	1.15	0	0	0	0	無	無	
何宗翰	2,730	1.01	0	0	0	0	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：黃調貴	2,600	0.96	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,182	0.80	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,099	0.77	0	0	0	0	無	無	
莊明郎	1,667	0.61	0	0	0	0	無	無	
湯文萬	1,031	0.38	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶	895	0.33	0	0	0	0	無	無	
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	682	0.25	0	0	0	0	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：不適用。

肆、募資情形

一、股本來源

單位：新台幣仟元；千股 111年3月28日

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
87/9	10	64,000	640,000	28,000	280,000	創立 216,000	技術股 64,000	87/9/11 經(○八七)商字第 087127301 號核准在案
88/7	10	64,000	640,000	43,250	432,500	現增 152,500	無	88/7/26 經(○八八)商字第 088127212 號核准在案
89/9	10	64,000	640,000	55,000	550,000	現增 117,500	無	89/9/20 經(○八九)商字第 089134667 號核准在案
91/8	12	64,000	640,000	64,000	640,000	現增 90,000	無	91/8/19 經授商字第 09101336780 號核准在案
92/3	12	88,000	880,000	73,000	730,000	現增 90,000	無	92/3/19 經授商字第 09201078970 號核准在案
92/4	11	88,000	880,000	83,000	830,000	現增 100,000	無	92/4/30 經授商字第 09201130010 號核准在案
92/9	15	120,000	1,200,000	103,000	1,030,000	現增 200,000	無	92/9/1 經授商字第 09201260090 號核准在案
92/12	20	120,000	1,200,000	115,000	1,150,000	現增 120,000	無	92/12/4 經授商字第 09201327560 號核准在案
95/4	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現增 50,000	無	95/4/10 經授商字第 09501063960 號核准在案
95/7	-	180,000	1,800,000	120,000	1,200,000	核定股本變更	無	95/7/4 經授商字第 09501131570 號核准在案
96/2	15	260,000	2,600,000	210,526	2,105,260	私募現增 905,260	無	96/2/16 經授商字第 09601036790 號核准在案
96/8	-	260,000	2,600,000	215,739	2,157,391	盈餘轉增資： 27,368 員工紅利轉增資： 24,763	無	96/8/6 經授商字第 09601184170 號核准在案
97/7	-	260,000	2,600,000	221,279	2,212,794	盈餘轉增資： 21,574 員工紅利轉增資： 33,829	無	97/7/24 經授商字第 09701180530 號核准在案
97/11	-	260,000	2,600,000	221,909	2,219,091	行使員工認股權 憑證 6,297	無	97/11/27 經授商字第 09701302390 號核准在案
98/3	-	260,000	2,600,000	222,225	2,222,251	行使員工認股權 憑證 3,160	無	98/3/30 經授商字第 09801056560 號核准在案
98/6	-	260,000	2,600,000	222,660	2,226,601	行使員工認股權 憑證 4,350	無	98/6/26 經授商字第 09801127190 號核准在案
98/7	-	260,000	2,600,000	224,629	2,246,289	盈餘轉增資：11,111 員工紅利轉增資： 8,577	無	98/7/22 經授商字第 09801153270 號核准在案
98/9	-	260,000	2,600,000	225,533	2,255,327	行使員工認股權 憑證 9,038	無	98/9/9 經授商字第 09801206430 號核准在案
98/12	-	260,000	2,600,000	225,766	2,257,657	行使員工認股權 憑證 2,330	無	98/12/18 經授商字第 09801290970 號核准在案
99/4	-	260,000	2,600,000	226,529	2,265,287	行使員工認股權 憑證 7,630	無	99/4/8 經授商字第 09901068120 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
99/7	-	260,000	2,600,000	227,275	2,272,746	行使員工認股權 憑證 7,459	無	99/7/16 經授商字第 09901144980 號核准在案
99/9	-	260,000	2,600,000	227,367	2,273,666	行使員工認股權 憑證 920	無	99/9/2 經授商字第 09901200650 號核准在案
99/12	-	260,000	2,600,000	227,968	2,279,684	行使員工認股權 憑證 6,018	無	99/12/6 經授商字第 09901271820 號核准在案
100/4	-	260,000	2,600,000	228,561	2,285,607	行使員工認股權 憑證 5,923	無	100/4/11 經授商字第 10001069460 號核准在案
100/7	-	260,000	2,600,000	229,026	2,290,265	行使員工認股權 憑證 4,658	無	100/7/1 經授商字第 10001142280 號核准在案
100/8	-	260,000	2,600,000	233,256	2,332,557	盈餘轉增資: 22,883 員工紅利轉增資: 19,410	無	100/8/10 經授商字第 10001184920 號核准在案
100/9	-	260,000	2,600,000	233,396	2,333,962	行使員工認股權 憑證 1,405	無	100/9/6 經授商字第 10001207740 號核准在案
100/12	-	260,000	2,600,000	233,579	2,335,794	行使員工認股權 憑證 1,831	無	100/12/2 經授商字第 10001274670 號核准在案
101/4	-	260,000	2,600,000	233,581	2,335,811	行使員工認股權 憑證 17	無	101/4/2 經授商字第 10101055600 號核准在案
101/6	-	260,000	2,600,000	233,785	2,337,846	行使員工認股權 憑證 2,035	無	101/6/27 經授商字第 10101120250 號核准在案
101/7	-	260,000	2,600,000	236,121	2,361,209	盈餘轉增資: 23,363	無	101/7/30 經授商字第 10101155880 號核准在案
101/9	-	260,000	2,600,000	236,153	2,361,526	行使員工認股權 憑證 317	無	101/9/13 經授商字第 10101188740 號核准在案
101/12	-	260,000	2,600,000	236,205	2,362,046	行使員工認股權 憑證 520	無	101/12/12 經授商字第 10101253820 號核准在案
102/4	-	260,000	2,600,000	236,208	2,362,079	行使員工認股權 憑證 33	無	102/04/01 經授商字第 10201058510 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,267	2,362,667	行使員工認股權 憑證 588	無	102/08/06 經授商字第 10201152570 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,290	2,362,896	行使員工認股權 憑證 229	無	102/08/30 經授商字第 10201179150 號核准在案
102/12	-	260,000	2,600,000	236,371	2,363,714	行使員工認股權 憑證 818	無	102/12/11 經授商字第 10201249330 號核准在案
103/3	-	260,000	2,600,000	236,402	2,364,019	行使員工認股權 憑證 305	無	103/03/28 經授商字第 10301053810 號核准在案
103/7	-	260,000	2,600,000	236,474	2,364,739	行使員工認股權憑 證 720	無	103/7/8 經授商字第 10301136750 號核准在案
103/9	-	260,000	2,600,000	236,481	2,364,814	行使員工認股權憑 證 75	無	103/9/4 經授商字第 10301184300 號核准在案
103/12	-	260,000	2,600,000	238,051	2,380,508	行使員工認股權憑 證 15,694	無	103/12/5 經授商字第 10301253830 號核准在案
104/3	-	260,000	2,600,000	238,121	2,381,207	行使員工認股權憑 證 699	無	104/3/6 經授商字第 10401033070 號核准在案
104/4	42	300,000	3,000,000	268,121	2,681,207	現增 300,000	無	104/4/15 經授商字第 10401064200 號核准在案
104/6	-	300,000	3,000,000	268,427	2,684,265	行使員工認股權憑 證 3,059	無	104/6/8 經授商字第 10401105400 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
104/12	-	300,000	3,000,000	268,768	2,687,680	行使員工認股權憑證 3,414	無	104/12/2 經授商字第 10401254910 號核准在案
105/3	-	300,000	3,000,000	268,876	2,688,761	行使員工認股權憑證 1,082	無	105/3/3 經授商字第 10501040250 號核准在案
105/5	-	300,000	3,000,000	269,195	2,691,948	行使員工認股權憑證 3,187	無	105/5/31 經授商字第 10501108730 號核准在案
105/11	-	300,000	3,000,000	269,590	2,695,901	行使員工認股權憑證 3,953	無	105/11/30 經授商字第 10501277360 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	269,853	2,698,534	行使員工認股權憑證 2,633	無	106/3/16 經授商字第 10601032450 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	271,353	2,713,534	發行限制員工權利新股 15,000	無	106/3/30 經授商字第 10601037310 號核准在案
106/6	-	300,000	3,000,000	272,149	2,721,493	行使員工認股權憑證 7,959	無	106/6/2 經授商字第 10601069300 號函
106/8	-	300,000	3,000,000	272,109	2,721,093	行使員工認股權憑證 1,480, 註銷限制員工權利新股 1,880	無	106/8/17 經授商字第 10601111270 號函
106/11	-	300,000	3,000,000	271,919	2,719,193	註銷限制員工權利新股 1,900	無	106/11/28 經授商字第 10601158830 號函
107/2	-	300,000	3,000,000	271,695	2,716,949	註銷限制員工權利新股 2,244	無	107/2/22 經授商字第 10701019760 號函
107/8	20	300,000	3,000,000	271,795	2,717,949	發行限制員工權利新股 1,000	無	107/8/22 經授商字第 10701106860 號
108/3	20	300,000	3,000,000	271,744	2,717,441	發行限制員工權利新股 2,000, 註銷限制員工權利新股 2,508	無	108/3/15 經授商字第 10801026540 號函
108/6	-	400,000	4,000,000	271,744	2,717,441	變更額定股本	無	108/6/18 經授商字第 10801072960 號函
108/8	-	400,000	4,000,000	271,723	2,717,225	註銷限制員工權利新股 216	無	108/8/26 經授商字第 10801115200 號函
109/3	-	400,000	4,000,000	271,364	2,713,643	註銷限制員工權利新股 3,582	無	109/3/12 經授商字第 10901031500 號函

單位：股 111年3月28日

股份 種類	核定股本			未發行股份	合計
	已發行股份				
	已上櫃	未上櫃	合計		
普通股	271,364,316	-	271,364,316	128,635,684	400,000,000

二、股東結構

單位：股 111年3月28日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	0	21	132	42,561	127	42,841
持有股數	0	1,997,959	117,031,645	137,552,018	14,782,694	271,364,316
持股比例	0.00%	0.73%	43.13%	50.69%	5.45%	100.00%

註：本公司無陸資持股。

三、股權分散情形

111年3月28日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
1 至 999	6,082	1,138,914	0.42
1,000 至 5,000	32,208	59,288,242	21.85
5,001 至 10,000	2,716	20,985,531	7.73
10,001 至 15,000	655	8,393,554	3.09
15,001 至 20,000	399	7,449,191	2.74
20,001 至 30,000	341	8,714,928	3.21
30,001 至 40,000	129	4,643,763	1.71
40,001 至 50,000	94	4,423,378	1.63
50,001 至 100,000	118	8,263,724	3.05
100,001 至 200,000	51	7,182,929	2.65
200,001 至 400,000	30	8,395,298	3.09
400,001 至 600,000	6	2,933,000	1.08
600,001 至 800,000	3	1,943,000	0.72
800,001 至 1,000,000	1	895,000	0.33
1,000,001 以上	8	126,713,864	46.70
合 計	42,841	271,364,316	100.00

四、主要股東名單

(股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比率佔前十名之股東名稱、持有股數及比例)

單位：股 111年3月28日

主 要 股 東 名 稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：劉德音		111,281,925	41.01
曾孟超		3,130,000	1.15
何宗翰		2,723,000	1.01
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：黃調貴		2,600,000	0.96
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		2,182,225	0.80
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		2,098,714	0.77
莊明郎		1,667,000	0.61
湯文萬		1,031,000	0.38
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶		895,000	0.33
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		682,000	0.25

五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；千股

項 目		年 度		當年度截至 111年3月28日	
		109年	110年		
每股 市價	最 高	213.50	219.00	151.50	
	最 低	44.00	116.00	115.50	
	平 均	127.07	171.91	133.40	
每股 淨值	分 配 前	18.48	22.91	-	
	分 配 後	15.98	19.91(註 1)	-	
每股 盈餘	加權平均股數	271,364	271,364	-	
	每股盈餘	6.37	6.92	-	
每股 股利	現 金 股 利	2.5	3.0(註 1)	-	
	無 償 配 股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利	-	-	-	
投資報 酬分析	本益比	19.95	24.84	-	
	本利比	50.83	57.30(註 1)	-	
	現金股利殖利率	1.97	1.75(註 1)	-	

註 1：尚待 111 年度股東會決議分配

六、公司股利政策及執行狀況

(一) 公司章程所訂之股利政策說明：

本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司章程第廿七條之一內容如下：

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五十。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

(二) 本次股東會擬議股利分配之情形：

盈餘分配議案業經 111 年 2 月 10 日董事會決議分派現金股利 814,092,948 元 (每股 3.0 元)。

七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

八、員工、董事及監察人酬勞：

(一) 本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(二) 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 110 年度估列員工酬勞 285,941 仟元、董事酬勞 1,680 仟元及董事報酬 2,520 仟元，係依稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為基礎按一定比率估列。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

111 年 2 月 10 日董事會決議通過員工酬勞 285,941 仟元、董事酬勞 1,680 仟元及董事報酬 2,520 仟元，與認列費用年度估列金額並無差異。

2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本期無擬議配發員工股票酬勞之情事，故不適用。

(四) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形 (包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 109 年度配發員工酬勞 259,117 仟元及董事酬勞 1,273 仟元，實際配發情形與估列之費用並無差異。

九、公司買回本公司股份情形：無。

十、公司債、特別股、海外存託憑證及併購或受讓他公司股份發行新股情形：無。

十一、員工認股權憑證辦理情形：無。

十二、限制員工權利新股：無。

十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十四、資金運用計畫執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容及其營業比重：

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度營業額	營 業 比 重 (%)
晶圓級尺寸封裝	5,538,550	72.24
晶圓測試	1,390,701	18.14
晶圓級後護層封裝	648,869	8.46
其 他	89,223	1.16
合 計	7,667,343	100.00

2. 公司目前之產品及服務項目：

(1) 目前商品(服務)項目：

a. 晶圓級尺寸封裝(Wafer Level Chip Scale Packaging)

- 影像感應器 (Image Sensor)
- 光學感應器 (Light Sensor)
- 慣性感測器 (IMU)
- 新型生物辨識器(Biometric Sensor)

b. 晶圓級後護層封裝(Wafer Level Post Passivation Interconnection)

- 3D 後護層互連 (3D Post Passivation Interconnection)
- 晶背電極製程 (Backside Metal Process)
- 厚銅 (Thick Cu)
- 指紋辨識器 (Finger Print Sensor)
- 微機電系統 (MEMS)

c. 晶圓級測試(Wafer Level Chip Probing Test)

- 300mm 晶圓測試 (300mm Wafer CP Testing)

(2) 計劃開發之新商品(服務)：

a. 開發新的晶圓級封裝技術應用於手機、筆記型電腦、個人行動電子裝置、穿戴式裝置、先進駕駛輔助系統、汽車環景安全、倒車影像、安全監測裝置、醫療、健康科技及光學影像感測器等。

b. 供應晶圓級封裝測試技術及資源，應用於各類輕薄短小之消費性電子、電腦、通

訊、資訊電子、光學元件、各類微機電系統、環境、氣壓元件製造及 IoT (物聯網)。
c. 應用晶圓級封裝技術，提供微機電系統、射頻元件、功率元件與指紋辨識器、新型生物辨識器的封裝服務。

(二) 總體經濟環境

伴隨全球疫情趨緩、疫苗接種率的提高，經濟活動逐步復甦，加上各國財政紓困政策的加持，2021 年主要國家及區域的經濟都較 2020 年大幅成長。根據 IHS Markit 的資料，2021 年全球經濟成長率約 5.54%。其中美國成長率達 5.44%；歐元區也有 5.06% 左右的成長；中國大陸成長 8.21%；日本成長稍微緩和，在 2.34% 左右；台灣則有高達 6.06% 的成長。

展望 2022 年，因為 2021 年基期較高，加上各國財政政策逐步退場，另一方面 Omicron 新病毒對整體經濟影響與通膨升溫可能使貨幣政策緊縮、利率上升，多重衝擊下，各國預測 2022 年的成長率將普遍低於 2021 年。

在台灣方面，根據中華經濟研究院景氣展望中心的估計，隨著政府振興經濟方案的實施，以及國內民生消費相關業者的加碼，民間消費可望由原本的低迷情況 (0.09%)，轉為大幅成長 (5.01%) 的局面，成為台灣經濟成長的主要動力。根據中經院的預測，2022 年全年可望經濟成長 3.69%，通膨率維持在 1.77% 左右，失業率保持在 4% 以下 (3.82%)。

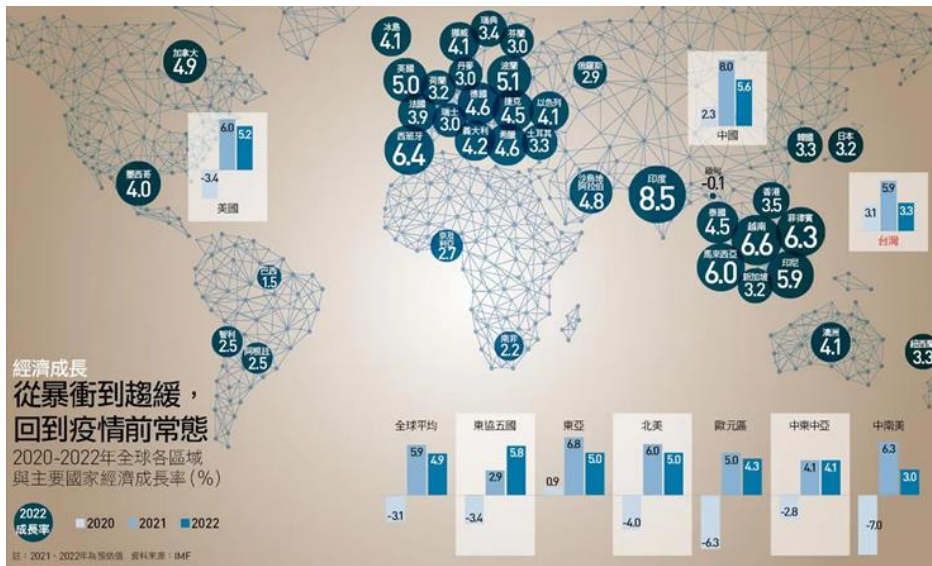
不過，2022 年的成長率仍有不少的變數，分析如下：

第一，Omicron 病毒的不確定性：雖然 Omicron 病毒帶來重症的比率低，但它會降低疫苗的有效性，使邊境開放面臨一些變數，如此民間消費要恢復正常軌道，或許需要更多的時間。

第二，通膨升溫致貨幣政策緊縮、利率上升，可能衝擊經濟的復甦，美國聯準會亦表示通膨將延續到 2022 年，並預計於 2022 年第二季起陸續展開資產負債表縮表與升息的舉措。縮表與升息勢將直接影響到房市、股市及債市等金融市場表現。亦有可能進一步推升原物料價格持續上揚造成通膨率螺旋性上揚進而直接影響整體經濟表現。

第三，全球經濟回落，美國、中國兩大經濟體成長率都可能下修的情況下，可能會衝擊到台灣這個以外貿為主的經濟體。

尤其是 2021 年下半年開始，中國大陸進行平台反壟斷、教育強監管、房地產去金融的一連串改革，導致數百萬中小企業大幅縮減營業規模甚至倒閉、引發經濟下滑與失業率提升。另中國房地產公司所引發市場的恐慌，牽連到房地產、銀行保險、電動車等領域，引發骨牌效應。嚴監管亦使中國大陸的房地產公司負債累累、面臨重整、賣產業降低負債、流動性的困境。在財富效果影響下，消費性產品的需求也會跟著下滑。



第四，地緣政治持續影響全球供應鏈，包含東亞台海問題持續緊張，北朝鮮導彈試射，中東伊朗核問題以及俄烏戰爭等，再再均影響全球供應鏈重組與物流正常回歸。

(三) 產業概況

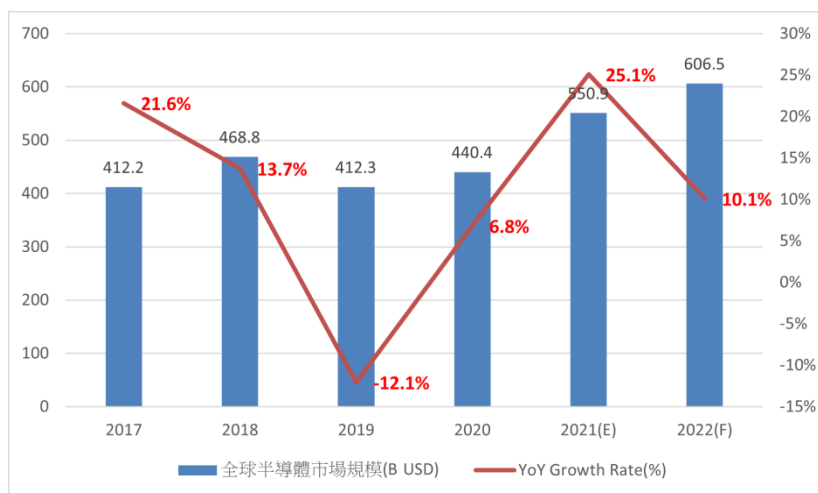
1. 產業之現況與發展

疫情時代半導體產業發展機會分析

(1) 全球晶片供不應求，引爆 2021 年半導體市場大幅成長

全球受到 COVID-19 疫情肆虐，居家辦公及遠距教學改變人們的生活型態，個人電腦、雲端伺服器等終端需求大增，帶動全球半導體市場高度成長。

儘管 2021 年疫情情勢較前一年度更為嚴峻，但卻無法壓抑市場需求的反彈，首當其衝的便是汽車市場的復甦力道超乎預期。但全球政府為了防堵疫情蔓延也祭出各種封鎖措施，導致半導體廠產能供應不及，引發全球汽車晶片短缺，整車廠及車用電子廠商開始轉向晶圓代工廠下單，進一步擠壓到晶圓代工廠已經窘迫的產能，直接導致於全球電子產業供應鏈為了避免缺料開始提高庫存水準，更進一步加劇半導體產能不足問題，半導體產業產能滿載的情況下，也造就了整體市場創下 2011 年以來成長率最高的一年。根據 WSTS 的調查，2021 年整體市場規模也突破 5,000 億美元，來到 5,509 億美元，較 2020 年大幅成長 25.1%。預估 2022 年全球半導體市場規模仍將持續成長，預估如下圖所示。



(2) 晶圓代工及專業封測產能大舉滲透車用市場

由於汽車供應鏈對產品可靠度、穩定性的要求較高，且產品需要較長時間認證，因此相較於消費性電子產品供應鏈更加封閉，車用半導體廠商也多以 IDM 的生產模式供應車廠所需的晶片。加上上下游供應鏈緊密配合的型態在整車廠 JIT (Just In Time) 的生產模式下，雖然可以穩定運作無虞，但是最大的風險在於，一旦產業鏈上游任何一個環節出現問題，將導致下游整條產業鏈欠缺即時調整的彈性而因此停擺。

而 2021 年初，正當汽車產業迎接快速復甦的汽車市場需求、汽車產品電子化程度日益提升，以及整車市場電動化的趨勢帶動車用半導體需求快速成長的同時，卻因為日本地震、美國德州暴風雪造成大規模停電，使得全球主要車用半導體廠商所屬晶圓廠被迫停工，加上日本最大車用半導體供應商的 12 吋晶圓廠在 3 月初發生火災直到 6 月初才恢復運轉後，更讓原本已相當緊俏的車用半導體產能雪上加霜。再加上 6 月起東南亞疫情嚴重，尤其是佔全球半導體封測產能 13% 的馬來西亞在當地政府的管制之下被迫停工，亦使車用半導體廠後段產能受到影響。

對 IDM 來說，要填補產能儘速完成訂單缺口的燃眉之急，最快的方法便是尋求晶圓代工及專業封測廠，因此，原先由少數 IDM 業者分食的車用半導體市場，因為疫情影響之下打開合作大門，紛紛與晶圓代工及專業封測廠簽訂長期合約或密切合作，以避免產能無法滿足客戶需求喪失市場先機。如此一來，也使得原先封閉的車用半導體產業生產模式發生變化，短期而言，晶圓代工加上專業封裝的生產模式因 IDM 轉單效應而受惠；長期而言，將有機會持續擴大專業分工模式在車用半導體市場的滲透比率。

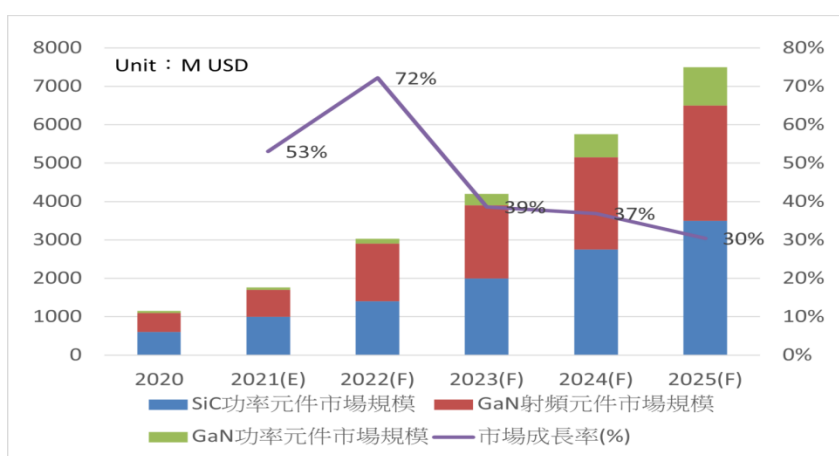
(3) 第三代半導體市場蓄勢待發

在上個世紀半導體產業發展初期，以矽(Si)為晶圓材料的半導體產品蓬勃發展之下，帶動了資通訊產業的快速起飛。矽晶圓應用雖廣，但在高溫、高壓、高電流、高功率、要求散熱/開關速度快、轉換效率高等情境下仍未臻完美，產業界一方面追逐摩爾定律的極致方面，另一方面也在尋找更合適的材料及製程滿足上述要求，化合物半導體便為一條主要發展方向。

因此，在行動通訊市場的快速滲透之下，砷化鎵(GaAs)等材料被廣泛應用於衛星通訊、行動通訊、光通訊、光電感測器等新領域。而隨著 5G 通訊、電動車市場蓬

勃發展，物聯網、人工智慧(AI)、自動駕駛、電動化等趨勢帶動之下，更高頻、耐高壓的射頻元件與功率元件便成為廠商關注焦點，對於碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等新材料應用於寬能隙半導體領域的研究更成為當紅炸子雞。

如今，全球主要國家政府均大力投入資源支持第三代化合物半導體研究，吸引晶圓材料廠、晶圓代工廠、IDM 及 LED 大廠透過自主研發或採取併購方式進行佈局，並已陸續開發出可用於取代傳統矽製程元件的替代產品。預計在汽車、通訊及電力供應等主要應用市場陸續採用之下，根據 OMDIA 的統計顯示，包括碳化矽功率元件、氮化鎵射頻元件及氮化鎵功率元件等寬能隙化合物半導體應用市場於 2021 年可達到 17.6 億美元的規模，至 2025 年將成長至 75 億美元，在四年內市場擴大規模至 4 倍，2021~2025 年間的年複合成長率達到 43.7%，成為整體半導體市場中成長速度最快的領域。全球碳化矽、氮化鎵射頻及功率元件市場規模預估如下圖所示。



(4) 異質整合趨勢下，晶圓製造延伸晶片性能提升需求

早期摩爾定律發展靠的是晶圓生產製程微縮技術達到晶片尺寸縮小及性能提升的目的，後摩爾定律時代下，先進封裝技術便是延續晶片性能的重要方法。而透過異質整合的立體封裝技術，可以將不同性質、不同材料或是不同功能的晶片，採用系統級的立體封裝技術整合另外一個半導體材料上，異質整合封裝除了可以增加效能、減少功耗之外，也可以加快 IC 設計的速度。但是要在不同功能、不同材料的晶片之間的互相溝通，就需要高度仰賴晶圓生產廠商強大的技術整合能力。

半導體產業發展面臨之挑戰

(1) 因疫情及天然災害所帶來的挑戰

全球半導體產業乃至於整體電子產業鏈當前所必須面對的首要問題，仍是受 COVID-19 疫情影響期間，因為國家封鎖、停工等問題衝擊短期產能規劃及交貨時程。在過去兩年期間，肺炎病毒已多次變種，於近期再度發現比 Delta 病毒更具威脅性的新型變種病毒，並經 WHO 正式命名為 Omicron，全球針對最新的變種病毒都已展開防堵措施，雖然陸續有國家開始開放邊境嘗試與病毒共存，然病毒對於經濟運作的影響何時終止將是持續關注的重點。

另一方面，因全球氣候變遷，極端氣候影響之下，天然災害問題所引發的水電供應問題都可能對晶圓廠的正常運作造成不同程度影響。尤其是晶圓廠運作需要大量高

純度水及大量電力供應，而台灣目前供應全球 21.4% 晶圓產能，未來五年內還有多座晶圓廠將陸續完工投入生產，如何維持穩定的水電供給問題，將是未來台灣半導體產業能否維持高速發展的重要關鍵。

(2) 美中貿易戰所引發的地緣政治效應，增加半導體產業鏈佈局風險

美中貿易戰與科技戰發展僵持不下，美國一方面對中國大陸及特定廠商採取關鍵設備禁運、禁制關鍵技術輸出、禁止投資先進製程產能、禁止供應晶片產品等措施進行封堵；另一方面也強推自主半導體產業鏈，邀請台灣及韓國晶圓代工領導廠商前往設廠。此舉也讓全球各國意識晶圓當地生產供應的重要性，紛紛力邀晶圓廠前往設廠。在此趨勢之下，晶圓廠必須由以往集中生產全球化銷售的營運模式，轉變為區域佈局、在地生產及就近供應的生產體系，如若當地欠缺完整產業鏈配套基礎，晶圓廠需於當地重新建立，亦將提高晶圓廠生產成本。

全球地緣政治風險升高之下，若高度仰賴特定國家客戶，將可能因禁令或技術封鎖特定廠商，導致營收大幅波動，如何於國際不同國家客戶間取得平衡分散風險，便成為半導體產業必須面對的重要課題。

(3) 原物料價格持續攀升，關鍵材料掌握於少數國家手中

隨全球疫情趨緩，經濟體系逐漸恢復正常運作後，由於用電、運輸等需求擴大，帶動石油、煤炭、天然氣等原料價格持續上揚。除了中國大陸多省宣佈限電之外，全球各地缺電問題也陸續浮現。

全球關鍵科技材料掌握於少數國家手中，如中國大陸掌握全球已開採稀土的 50%，並生產及出口全球 90% 的稀土，對於稀土價格具有高度話語權，並將影響以稀土為材料生產的半成品或成品的價格，如晶圓生產材料中的拋光液、靶材等材料；在化合物半導體中使用稀土的比重更高，未來中國大陸若進一步管制稀土出口，將提升晶圓材料成本。

另俄烏戰爭，除了使歐洲安全問題拉升至前所未有的緊張狀況，兩國均為半導體相關氣體與原物料靶材主要供應國，俄羅斯更供應歐洲超過 40% 的天然氣使用量，無法穩定能源供應必定影響全球半導體，雙方戰事倘若拉長勢必影響全球半導體產業。

(4) 終端應用市場新需求何在？

現階段先進製程終端應用市場以智慧型手機 CPU、筆記型電腦 CPU、挖礦機高效能運算 HPC 需求為主，運算能力與人工智慧的持續發展預期雖可持續帶動應用市場需求，但中國大陸對虛擬貨幣的態度採取堅決禁止、嚴格取締的方式，也曾造成挖礦機生產廠商砍單，更有可能影響未來 HPC 市場發展前景。除了目前已知的應用產品外，未來新一代新興消費性電子產品市場尚未明朗。

如今多數廠商雖已佈局元宇宙(Metaverse)相關概念，創造出一個完整的虛擬世界，且預估未來商機將不可限量，但究其本質可發現實際上元宇宙是一個以 VR/AR (虛擬實境/擴增實境)設備為主要應用產品，以及其所衍生的產業生態系所構成，此類產品問世已有多年時間，然目前市場仍處於萌芽階段。

結論

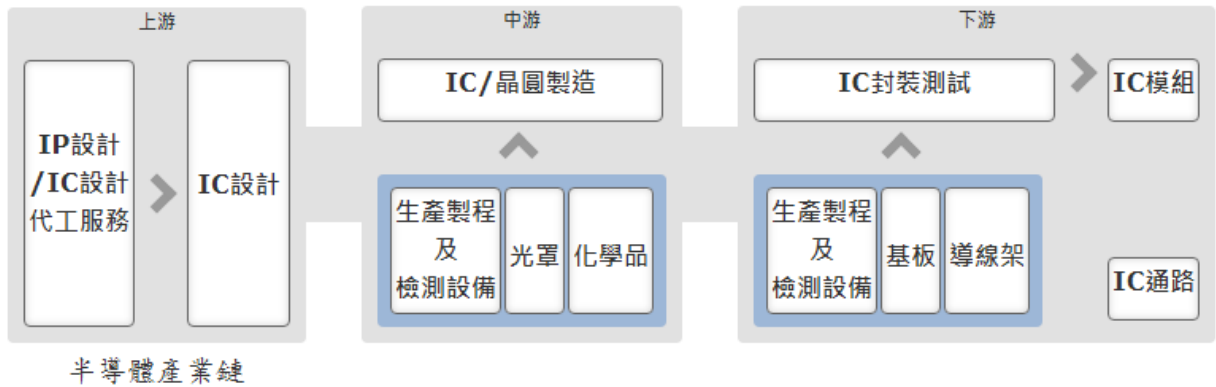
雖然全球經濟持續面臨 COVID-19 疫情的挑戰，但 2021 年仍是全球半導體產業豐收的一年，除了整體市場創下有史以來最大規模，成長率更是 10 年內罕見。但深究其主因，乃是來自於疫情期間消費需求的壓抑，於疫情紓緩後消費需求復甦；但供應鏈卻因為天災及疫情影響下，因為停工或封鎖等問題，無法回應市場需求的供需失衡所導致。也因此全球半導體產業的重要性受到高度關注，除美、中政府外，包括歐洲各國乃至於日本、韓國等傳統半導體生產重鎮國家，也將半導體產業地位重要性提升到前所未有的高度，未來半導體產業佈局形式將更加分散，伴隨而來的將是當地供應鏈體系重新建立的重要課題。

此外，未來汽車產品電子化，以及整車市場電動化的腳步加速等因素造成車用晶片需求持續提升，在供需失衡的情況下，晶圓代工模式將有機會滲透車用半導體市場；另外，寬能隙化合物半導體在 5G 射頻，以及汽車市場上的應用市場也將持續擴大，碳化矽與氮化鎵產品應用領域將持續提升，廠商將加速佈局速度，在生產模式上 IDM 模式仍為主流，大廠積極整合併購上下游快速建立競爭門檻，而台灣半導體產業以晶圓代工模式領先全球，如何延續既有優勢、持續領先將是未來關注重點；最後，除了先進製程、新材料應用等方向外，異質整合 3D 封裝技術將是未來大廠技術研發的重要技術路線。

在半導體產業經營所面臨的相關挑戰方面，在 COVID-19 疫情尚未完全解除之前，首先仍需持續關注全球疫情變化導致市場需求是否產生重大變化，或者供應鏈能否正常運作，並關注原物料價格變動情形；最後，儘管半導體生產技術及晶片效能持續提升，然而半導體市場成長力道的延續，仍須仰賴終端產品不斷的推陳出新，元宇宙相關產品在大廠陸續投入之後是否有助於產業生態的加速成形，將是未來持續關注的重點。

2. 產業上、中、下游關聯

半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。



在半導體產業鏈中，在後摩爾定律時代，IC產品的複雜度已難由單一半導體技術節點所實現。對IC設計業者而言，並不是每一個IP都能縮小技術節點。不同技術節點的IP或設計要混合使用，像系統單晶片（SOC）就是其中一種方法。但有時候因為不同節點成熟度不一，把不同技術的電路集合在同一顆晶片上不只成本上並不具優勢，連良率都會有影響；系統級封裝（SiP）為解決此問題而應運而生。產品owner可以把不同專長design house設計的IC運用SiP整合成同一個封裝。這種整合的彈性不只可以跨技術節點，甚至可以跨平台，把矽基材的IC與非矽基材的元件（例如III-V族或被動元件）整合在一起，開創無限可能。

這種封裝的興起，讓介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程之間的中段（Mid-End）製程平台擴大，除了過往所知的晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、晶圓級封裝（Wafer Level Package），如扇外型晶圓級封裝技術（Fan-out Wafer Level Package, FOWLP）、晶圓級尺寸封裝（Wafer Level Chip Scale Package, WLCSP）、3D WLP、WL Optics 及 3D IC 等技術型態外，還能混合這些技術以客製化各種形式的SiP。本公司為專業晶圓層級封裝之領導者，也是第一家將三維晶圓層級封裝技術商品化的公司。

三維晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，包括消費性電子、通訊、可攜式電腦和汽車等。產品應用包括影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器、各項生物辨識晶片(如:指紋辨識器)和整合式被動元件等。

鑒於高階封裝製程的需求，如覆晶封裝（Flip Chip BGA or Flip Chip CSP）、晶圓層級封裝（Wafer Level CSP）、銅打線（Cu Wire Bond）、銅柱凸塊（Cu Pillar）等。尤其是在未來 2.5D/ 3D IC 整合矽穿孔（Through Silicon Via TSV）技術，晶圓層級封裝服務將持續在各相關的應用產品繼續扮演關鍵性角色。

3. 競爭情形：

本公司之主要產品為影像感測器、新型生物辨識器、指紋辨識器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，目前主要競爭對手如下：

主要產品	主要晶圓級封裝競爭對手
影像感測器/指紋辨識器	晶方、華天科技

(四) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止之研究發展費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	110 年度	截至 111 年 3 月 31 日止
研發費用		283,673	65,401
營業收入淨額		7,667,343	1,671,261
占當年度營業額比重(%)		3.70%	3.91%

2. 所營業務之技術層次與研究發展

- (1) TSV (矽穿孔封裝) 封裝技術：成功導入 CIS(CMOS Image Sensor) 產品量產，並應用於 MEMS 等相關封裝製程且已完成封裝驗證導入量產。
- (2) CIS-CSP 製程改善技術：導入車規影像封裝產品，已完成車規封裝驗證導入量產。
- (3) 導入特殊光學鍍層玻璃，並應用於各式先進光學感測器。
- (4) 開發厚銅製程，成功應用於整合式被動元件產品及射頻元件產品。
- (5) 導入紅外線鍍層玻璃，並應用於手機之先進光學感測器元件。
- (6) 新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)晶圓級封裝技術研發。
- (7) 超薄感測器元件晶圓級封裝技術開發暨量產。
- (8) 指紋辨識器的晶圓級封裝技術開發暨量產。
- (9) 開發 GaN 功率元件封裝製程，已完成客戶打樣樣品。
- (10) 新一代生物辨識感測器封裝製程開發完成，通過可靠度測試並量產。
- (11) 利用核心技術開發應用於客戶 IR sensor 特殊需求之 Si 載板蓋，並完成客戶打樣樣品。
- (12) 持續利用核心 TSV 技術，開發 MEMS speaker 封裝方式，並完成客戶測試，進入小量量產階段。
- (13) 截至 110 年底，本公司已取得 263 件台灣專利、197 件大陸專利、7 件日本專利、1 件德國專利及 254 件美國專利。於 110 年度，本公司新取得之專利數為：台灣專利數 11 件，中國專利數 4 件，美國專利數 7 件，日本專利數 1 件。

3. 最近年度成功開發之技術或產品

年度	研發成果	主要功能/效益
109	開發 MEMS speaker 封裝方式。	應用於手機，可讓聲音達更佳效能。
110	開發 12 吋 CIS IR glass 模組封裝方式，並通過客戶測試。	搭配 module house 的封膠成型技術，可利用在於車用影像模組。

(五) 長、短期業務發展計劃

因應市場快速變化及國內外同業競爭壓力不斷加劇，本公司特擬訂長、短期計畫如下：

1.短期計畫：

(1) 建立以客戶導向之專業封裝服務，強化顧客滿意度

提升本公司客戶值得信賴的高品質服務，以更快、更好的技術與服務，滿足客戶的需求；並在晶圓級製程平台上提供更多樣的封裝技術，以因應多元化產品的需求。

(2) 加強上、中、下游產業鏈之合作

先進製程需求越來越高，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，精材科技與晶圓代工業者及測試大廠共同策略聯盟，並與國際整合元件製造大廠之技術合作開發，致力於成為先進晶圓級尺寸封裝技術服務之領導廠商。

(3) 健全公司經營體質，以職能為培育核心，提昇管理及經營績效

透過教育訓練達成公司經營策略目標，以提升管理及技術專業為訴求，有效發揮職能作為培育核心，並以改善工作成效為導向，進一步提升員工工作效率，使公司能因應環境的快速變化與不斷的挑戰。

2.中長期計劃：

(1) 注重客戶與供應商長期合作發展關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

(2) 加強研發創新能力

致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進 3D 晶圓層級堆疊之應用、新生物辨識產品之應用、矽晶圓連接之載板、各種微機電產品之應用等。產品之類別將從消費、汽車、電腦等擴展至監控、醫療等電子產業。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地 區	年 度	110年度	
		金 額	%
台	灣	6,029,429	79
美	國	1,536,767	20
歐	洲	64,549	1
其	他	36,598	0
合	計	7,667,343	100

2.先進封裝市場分析與市佔率

基於物理極限和製造成本的原因，透過電晶體微縮製程以實現更高經濟價值的選

輯正逐漸變得不再有效。而事實證明，使用較小的功能模組建構大型系統將更具競爭力。

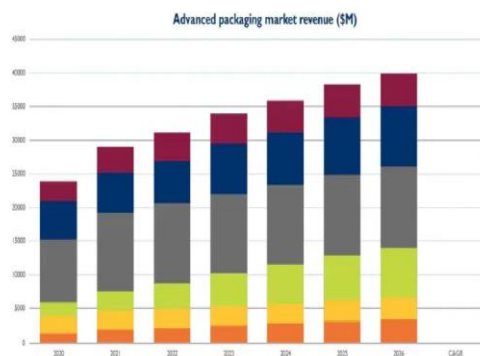
從技術發展角度來看，當製程節點從 16/12nm 向 3nm、2nm 演進，甚至跨過奈米門檻後，先進的邏輯技術能否繼續提供未來運算系統所需的能源效率，成為產業關心的重點。而從市場趨勢來看，過去十年中，資料運算量的發展超過了過去四十年的總和，雲運算、大數據分析、人工智慧(AI)、AI 推斷、行動運算，甚至自動駕駛車都需要海量運算。

於是，一條不再是直線的 IC 技術發展路線，以及市場對創新解決方案的需求，將封裝，尤其是先進封裝技術，推向了创新的前端。

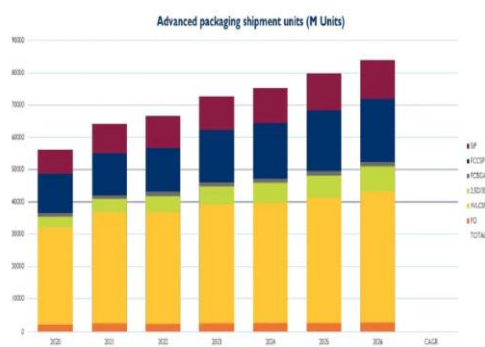
根據 Yole Développement 最新的資料，2020~2026 年，先進封裝市場年複合成長率約為 8.96%。其中以 5G，車用半導體，AI，資料中心及穿戴裝置等為成長中心。

到 2025 年，該市場營收就將突破 420 億美元，這幾乎是傳統封裝市場預期成長率(2.2%)的三倍。其中，2.5D/3D 堆疊 IC、嵌入式晶片封裝(Embedded Die, ED)和扇外型封裝(Fan-Out, FO)是成長最快的技術平台，年複合成長率分別為 21%、18% 和 16%。

ADVANCED PACKAGING MARKET DYNAMICS – REVENUE



ADVANCED PACKAGING MARKET DYNAMICS – UNITS



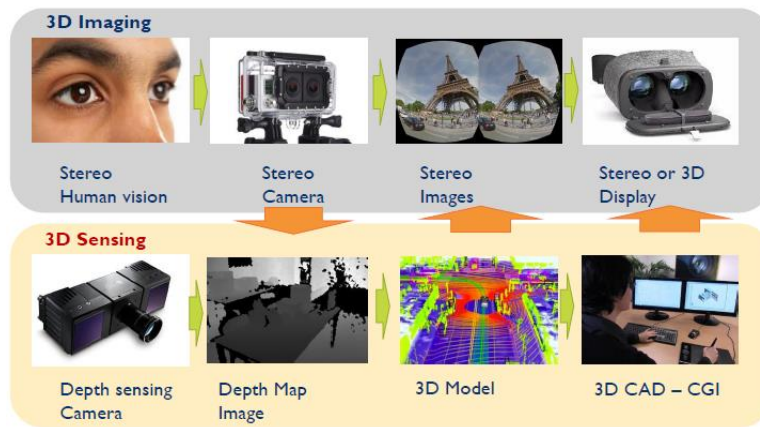
本公司目前服務項目包含晶圓級尺寸封裝，晶圓級後護層封裝等均屬先進封裝市場範疇，後續配合前端晶圓製程微縮與客戶應用整合開發相對因應新封裝與製程，持續擴大先進封裝市場佔有率。

3. 市場未來之供需狀況與產品之各種發展趨勢

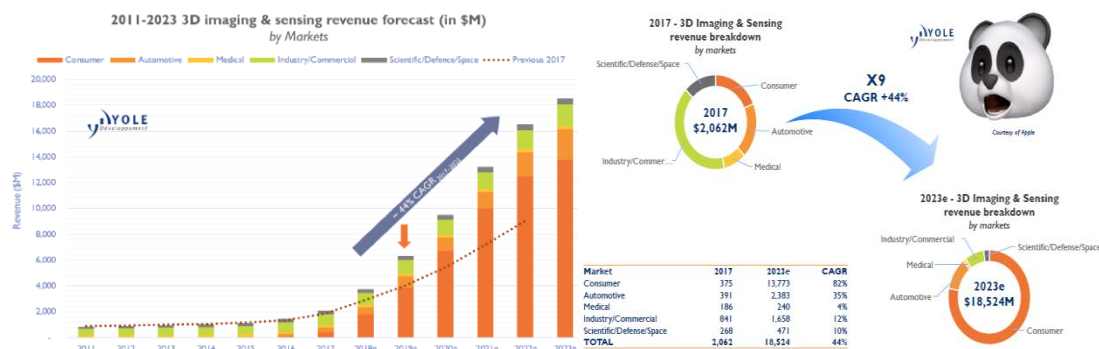
鑑於未來在智慧物聯 (AIOT) 趨勢帶動下，AI、5G、物聯網、工業4.0、自動駕駛等新的多元應用都是半導體的發展契機，全球專業封測產業來自先進應用與封裝製程產值仍將成為帶動產值成長重要動能。本公司主要產品為晶圓層級之封裝代工服務，應用產品包含行動裝置、5G通訊、汽車電子及穿戴式裝置等應用。其主要應用領域之供需狀況與成長性分析如下：

(1) 3D Sensing

科技不斷進步之下，終端設備開始大量處理圖像資訊，這也使得手機、汽車、AR 等應用的可拓展性變得越來越高，而從 2D 走向 3D 是未來感測器發展的一大趨勢。3D 感測 (3D Sensing) 多方應用於各領域。小到智慧型手機上的人臉解鎖、3D 相機、人臉鑰匙、手勢感應，大到自駕車的偵測系統、工廠控制、醫療、AR/VR 等應用。

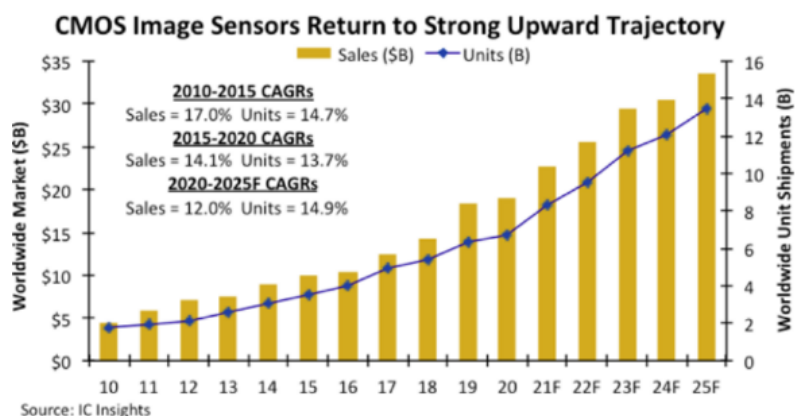


根據研調機構 Yole Développement 研究指出，全球 3D 影像及感測市場將由 2019 年到 2023 年，3D Sensing 於各領域的 CAGR 超過 44%，其中又以智慧型手機高達 87%，車載應用 35% 為主要應用。另在醫療、工業製造及其他探測領域亦快速成長。



(2) CMOS 影像感測器

在新冠疫情的爆發過程中，CMOS 圖像傳感器 (CIS) 市場迅速發展。據估計，全球總體銷售總額在 2021 年將增加 19%，達到 2280 億美元。這將是自 2010 年以來連續第十個全球銷售記錄 (如下圖)。

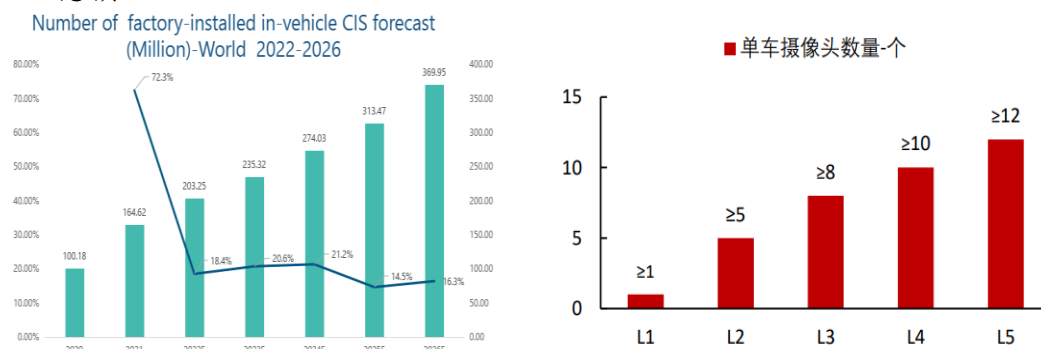


當 2020 年上半年的疫情尚未被緩解，業務，學校，旅遊和世界各地的大多數公共活動被迫停滯，導致 CIS 應用中的急劇下降 (包括智能手機，汽車和廣泛的範圍嵌入式設備)。所有 CIS 供應商都曾經擔心其商業環境惡化，其重中之重在於全球智能手機出貨量的下降。

然而，CIS 需求在 2020 年第三季開始飆升。截至 2020 年底，全球 CIS 銷售成長率仍呈現小幅成長，未因疫情反噬影響長期成長趨勢。預計全球經濟將繼續恢復 2021 年的增長，預計 CIS 銷售將以 12.0% 的複合年增長率增長。IC Insights 報告指出，該領域將於 2025 年達到 336 億美元。

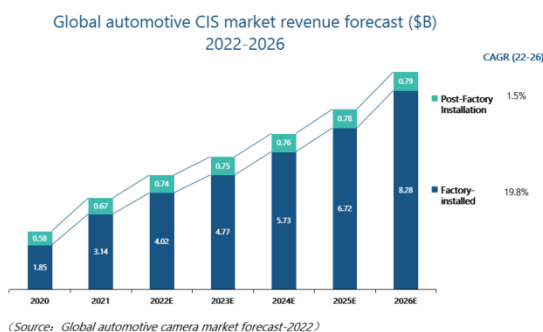
該報告還顯示，在未來五年內，行動電話的 CIS 銷售將重回成長軌道以 6.3% 的複合年增長率增長，達到 2025 年的 157 億美元，佔總市場的 47%。汽車將成為 CIS 增長最快的應用領域，到 2025 年汽車中使用的複合年增長率為 33.8%，達到 51 億美元。其他領域的 CIS 的增長預測還包括：醫療和科學系統（複合年增長率為 26.4%，達到 18 億美元）；監控（複合年增長率為 23.2%，達到 32 億美元）；工業機器人和物聯網（複合年增長率為 21.8%，達到 35 億美元）。

2021 年，隨著 Level 2 智慧駕駛汽車數量和滲透率的增加，帶動車載攝像頭數量的快速增長，2021 年全球 L2 以上車輛的滲透率達到 28.62%，數量達到 1,952.94 萬輛，較 2000 年增長了 80.34%；L2 級乘用車平均配置 5 顆攝像頭，僅 L2 級乘用車就配置了 9,734.7 萬顆攝像頭。全球 2021 年總計 CIS 配置量為 1.64 億顆，2026 年預計將配置 3.7 億顆。



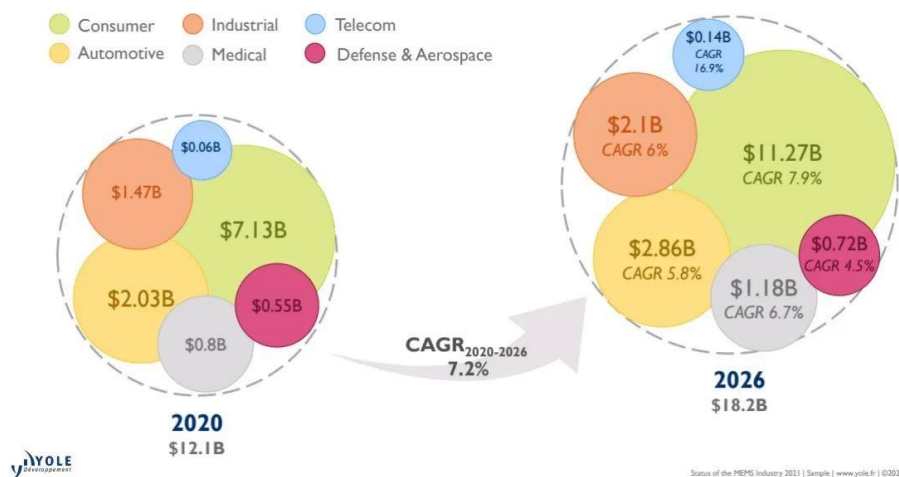
另車載攝像頭隨著智慧駕駛等級的提升，在攝像頭的性能品質要求上會出現變化，例如，L1 級乘用車平均配置 1~2 顆攝像頭，基本性能要求為 Display 等級，解析度在 200 萬以下即可，但到了 L2 級乘用車，就需要有 ADAS 功能的攝像頭，平均總配置 5 顆攝像頭中有 2 顆是 ADAS 功能的，單價較 Display 功能的要高出一倍多，到了 L4 和 L5 級，就需要配置 Full autonomy 的攝像頭，單價又會上漲。

根據 ICV 的資料統計，2021 全球車載 CIS 總價值為 38.1 億美元，前裝車載攝像頭及 CIS 必須符合車規級的產品性能要求，市場價值較後裝市場要高很多。2021 年前裝車載 CIS 市場總價值為 31.4 億美元，後裝 CIS 為 6.7 億美元，後裝 CIS 單價幾乎為前裝的一半。由於受到全球車載半導體產能吃緊的影響，車載 CIS 價格提升帶動整體市場價值提升，此次 ICV 對於 2021 年的市場統計，較 2020 年的市場預估要高出 4.3%。

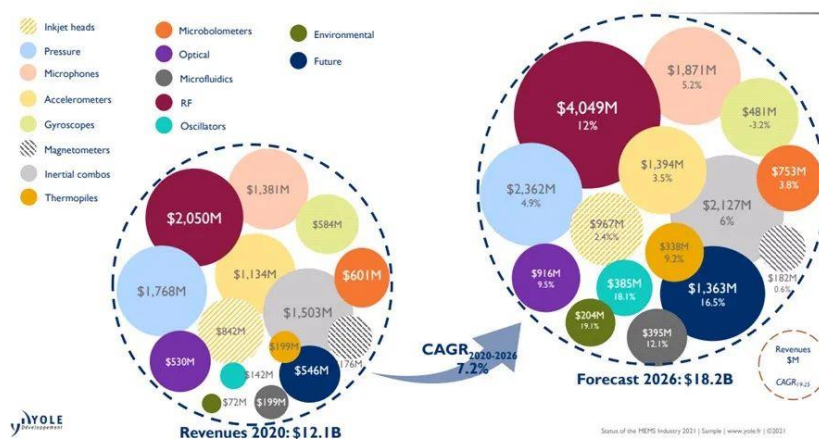


(3) 微機電感測器 (MEMS)

根據市場調研機構於 2021 年發佈的 MEMS 行業狀況報告，預估到 2026 年，MEMS 市場將達到 182 億美元，複合增長率約為 7.2%，傳統 MEMS 器件會保持增長，但其增長速度較慢。增長的主要推動力是音訊領域的麥克風、微型揚聲器和慣性 MEMS、光學 MEMS 的 AR/VR (增強與虛擬實境) 及其他應用。



按終端市場劃分 MEMS 市場嚴重依賴於占總市場 62% 的消費類應用和 16% 的汽車產業。因此，伴隨智慧手機和汽車出貨量的恢復性反彈，MEMS 感測器銷售在 2020 年下半年得到了恢復。預估各領域 MEMS 的銷售金額將於 2026 年成長至 180.2 億美元。CAGR 6.2% 高速成長。



另外來自感測器的所有資料都需要先行處理後交付系統。Edge Computing 趨勢有助於實現低延遲、更安全和更隱私，因此從原本前端製造到封裝、模組和系統集成的方式。轉向系統級方法和集成不同元件，如 MEMS、專用積體電路 (ASIC)、天線和電源，這些元件在同一個外殼中使用不同的材料和工藝，因此需要更複雜的系統級封裝 (SiP) 技術將成為 MEMS 系統化集成的主要趨勢，目標是提高系統級性能並降低總體功耗。

(4) 5G 通訊：GaN 元件

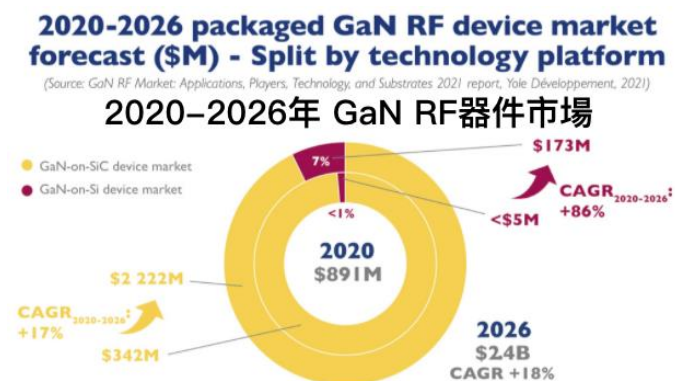
通訊頻率在不斷的向高頻發展，因此基地台及通訊設備對射頻元件高頻性能的要求也不斷提高。在此背景下，GaN 必將以其獨特的高頻特性、超高的功率密度，以及優越的整合度成為 5G 技術的核心元件。

射頻GaN元件:

在 5G 產品中，GaN 主要應用在 Sub-6GHz 基地台和毫米波 (24GHz 以上) 的小基地站。全球GaN射頻元件的市場規模到2025年預測將超過20億美元，其中無線通訊和軍事應用佔據絕大部分。以18%的年複合成長率，從2020年的8.91億美元增長到2026年的超過24億美元。並預計到2026年，GaN射頻器件市場將由國防和5G電信基礎設施應用主導，分別佔整個市場的49%和41%。尤其是，到2026年，基於GaN的大型/微型基地領域將佔GaN電信基礎建設市場的95%以上。

GaN-on-Si作為挑戰者，有望藉由提供具有成本效益和可擴展性的解決方案，來說獲得市場青睞。儘管截至2021年為止，其市場仍舊很小，但GaN-on-Si PA因其具備較大頻寬和小尺寸也正吸引智慧型手機廠商的注意。預估隨著創新廠商的重大技術進步，其可能很快就會被一些Sub-6GHz的5G手機採用。這標誌著GaN-on-Si射頻的一個里程碑。

Yole預估，在手機以及國防和5G電信基礎建設應用的推動下，GaN-on-Si器件市場正以86%的年複合成長率前進，進而讓2020年不到500萬美元的市場，成長到2026年的1.73億美元的規模。



功率GaN元件:

汽車電動化和可攜式電子產品的充電需求，以及高瓦數、高功率的電源供應器都將驅動氮化鎵功率元件逐漸替代傳統的矽功率元件。由於電源市場的需求驅動，氮化鎵市場將穩步成長。

根據市場分析公司Yole預測，GaN功率器件市場將從2020年的4600萬美元成長至2026年的11億美元，平均年複合成長率達70%。其中，在2020年，由於GaN器件滲透到智慧型手機快速充電器應用中，使得GaN功率市場成長了一倍。

因此預計未來幾年消費性電子產品的電源，將成為GaN器件的市場驅動力。根據其預估，這一市場區隔將從2020年的將近2900萬美元成長到2026年的約6.72億美元（約佔GaN功率市場比例達61%），年複合成長率為69%。

儘管GaN在消費性電子市場已經崛起，但是隨著規模經濟效益和價格下跌，將讓電信、數據通訊、汽車與行動市場受益。Yole預計，從2023年至2024年，GaN器件的滲透率將有所成長。

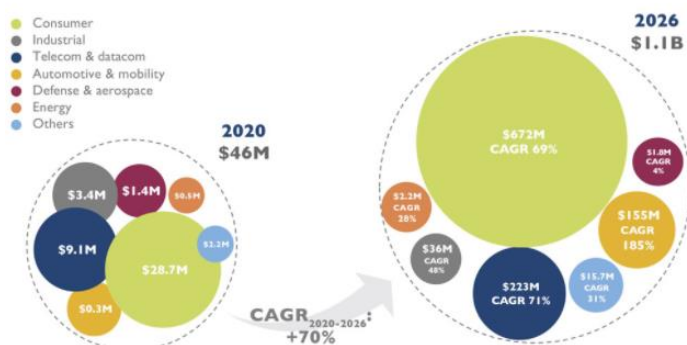
至於在汽車市場，由於電動車的快速成長，以及對通過系統效率優化來增加行駛距離的帶動下，GaN功率器件更變得該領域積極開發的領域。從長遠來看，如果GaN

能以較低的價格進入，且能夠證明其可靠性和高電流能力，未來將可以打入更具挑戰性的EV/HEV（混合動力汽車）電源轉換器市場，這一趨勢可能為其創造出更顯著的價值。

從2022年開始，預計GaN以小量滲透到車載充電器（OBC）和DC/DC轉換器等應用中。因此，Yole預計，到2026年，汽車和行動市場價值將超過1.55億美元，年複合成長率達185%。

2020-2026 power GaN market forecast split by application

(Source: GaN Power 2021: Epitaxy, Devices, Applications and Technology Trends report, Yole Développement, 2021)



4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

(a) 生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化、產線流程優化以提升生產力產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

(b) 技術領先暨產品應用多樣化

精材科技深耕晶圓層級封裝市場，致力技術研發及擴展產品應用，除品質優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術專利，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝，並獲得國際品牌大廠認證之合格供應商。

(c) 集團整合

本公司為台積電轉投資公司，不僅利用本身之技術與行銷能力，建立強大之客戶群，更結合台積電半導體製造技術與本公司在下游提供晶圓級封裝的專業技術，於半導體供應鏈中可提供客戶完整之一條龍服務（Turn-key service），與客戶形成長期的伙伴關係，不斷正向循環。

(d) 國際分工之優勢

台灣封裝業的發展，扮演全球半導體業供應鏈的夥伴，藉先進技術發展策略，並整合品質、成本、交期、產能及服務之總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。本公司為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶封

裝服務，並藉由與晶圓代工公司合作，提供完整之供應生產鏈體系，解決生產過程衍生之相關議題。

(2)發展遠景之有利因素

(a) 先進晶圓層級封裝之成長

因應終端產品需求，晶圓層級封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小、功率降低、功能與頻寬增加，以期超越摩爾定律，希望將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的 3D 堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，臺灣因半導體產業鏈完整，因此具有晶圓層級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

(b) 開發新利基應用，持續投資中長期商機

鑑於產業需求變動快速，本公司持續拓展新客戶與新利基產品之開發，如拓展 5G GaN 通訊用高頻功率元件加工服務及新客戶、客製化微機電元件加工服務、持續開發元件薄化製程與新創模組技術，協助客戶新創產品需求，持續 12 吋晶圓測試業務。

(c) 關鍵技術之自主研發

本公司持續強化研發能量，汽車電子相關之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝，由於產品品質優異，獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商。另本公司近年亦開發多種微機電感測器、指紋辨識感測器、新型生物辨識感測元件之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝技術，此等技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

(3)發展遠景之不利因素及因應之道

(a) 智慧手機趨於飽和，消費者換機周期延長

智慧型手機市場面臨產品成熟、產品差異化降低、市場滲透率已高，新興市場採購動能支撐成長等不利因素，讓手機產業經營相對困頓。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術並搭配新興應用之需求，強化與關鍵客戶合作並整合上游產業龍頭技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，持續精進製造管理以提高生產力並降低營運成本。

(b) 中美貿易戰與地緣政治牽動半導體產業

近來國際局勢變動，全球貿易壁壘加劇，為貿易協定及區域競爭關係增添變數，也讓半導體產業發展不確定性劇增。美中貿易戰若持續，長期將波及全球 ICT 產業，邏輯、類比以及記憶體晶圓半成品及模組受到的衝擊最大。

因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升生產力及品質，並有效降低成本。轉進利基應用市場，包括醫療、汽車、監控電子等領域。對於類比、感測器等晶片出現高度需求，強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。同時強化台美產業供應鏈整合、緊密雙方的經貿夥伴關係，並發展多元化的國際市場。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

產品別	主要用途	主要應用領域
晶圓級尺寸封裝	影像感測器、環境感測器	手機、平板、筆記型電腦、汽車、醫療
晶圓級後護層封裝	指紋辨識器、作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件	手機、平板、筆記型電腦、汽車

2. 主要產品產製過程

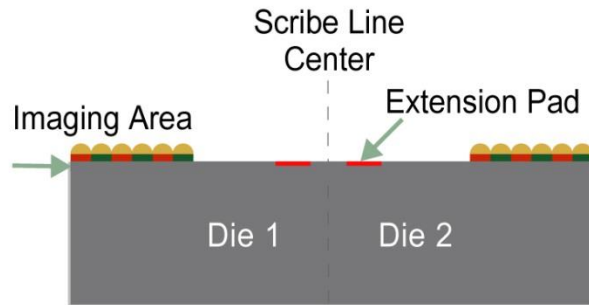
(1) 晶圓級 CSP 封裝技術製程：

在晶片尚未切割前即進行，整片晶片經由薄膜，黃光及蝕刻等晶圓製程完成封裝，最後再切割成單顆的 IC，此種製程可視為前段半導體晶圓廠製程的延伸。最大優點是在封裝的過程中，藉由整片晶片的製程方式，但卻同時將個別的 IC 封裝完成來降低封裝過程中的支出。整個封裝製程的基本步驟如下列所述：

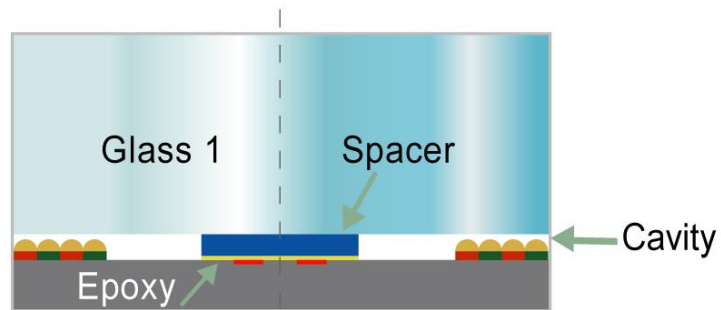
- A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。
- B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度，並以蝕刻的方式將晶片切割道背面的矽材料去除，使一顆顆獨立 IC 產生於黏著的玻璃保護片上。
- C. 將玻璃保護層黏貼於晶片背面，以達到完全包覆 IC 的保護作用。
- D. 在玻璃表面準備製作銲接點(Solder Joint)的所在位置覆上一層有機材料，以作為絕緣緩衝層。
- E. 在個別的 IC 之間切割露出 IC 銲墊的截面並濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 銲墊的截面相連通。
- F. 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。
- G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，再經過迴銲(Reflow)形成錫球。
- H. 切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

Wafer Level CSP –Shell 3D Process Flow

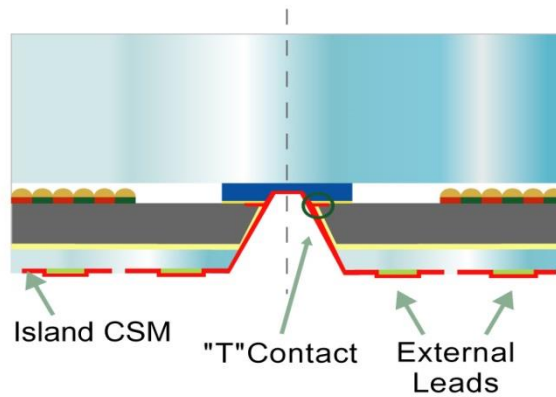
Step A: Passivation and Pad Extension Layers



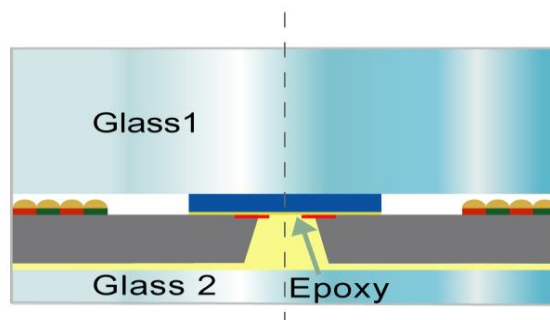
Step B: Glass 1 Attachment



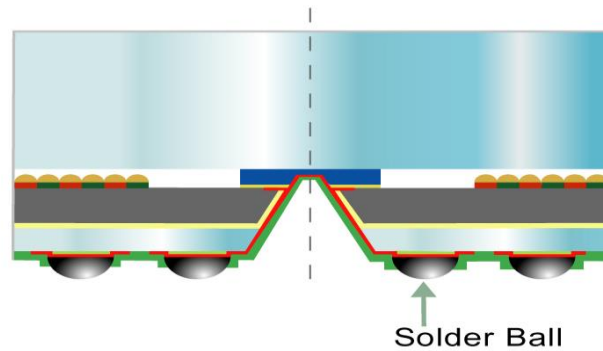
Step C: Etching and Glass-2 bonding



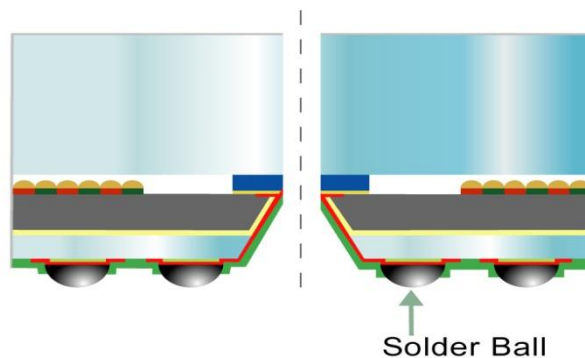
Step D: Barrier deposition and T-contact formation



Step E: Passivation coating and BGA formation



Step F: Dicing and Final inspection

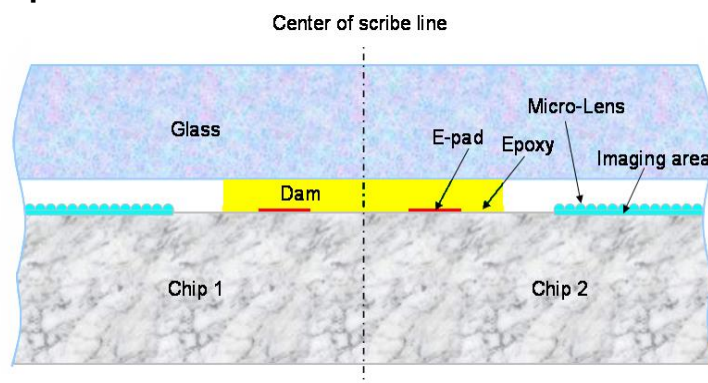


(2) TSV (矽穿孔封裝) 技術步驟說明：

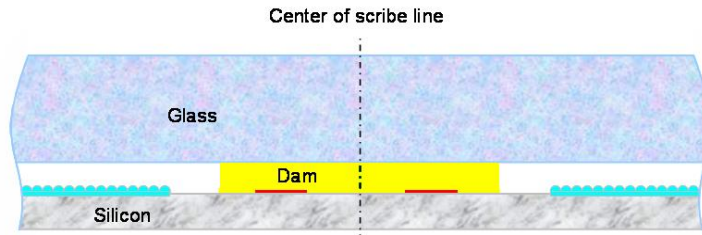
- A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。
- B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度。
- C. 以蝕刻的方式從晶片背面的矽材料去除，作為 RDL 線路連接之孔洞。
- D. 在晶片表面覆上一層二氧化矽作為絕緣層。
- E. 在晶片表面濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 錐墊的截面相連通。
- F. 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。
- G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上錐接點的所在位置，再經過迴錫(Reflow)形成錫球。最後切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

TSV Wafer Level Package – Process Flow

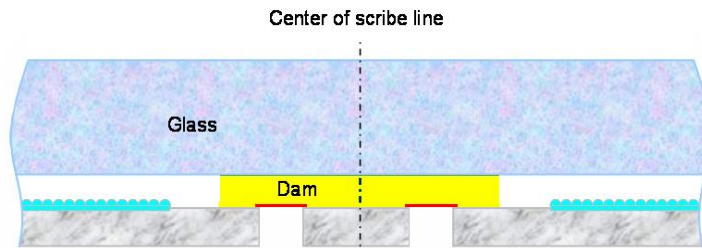
Step A: Glass attachment



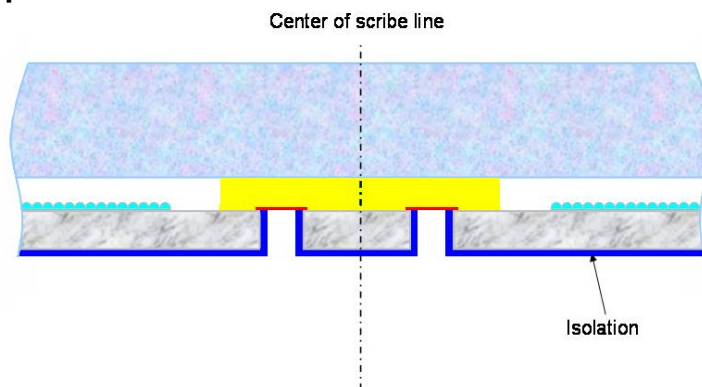
Step B: Wafer thin down



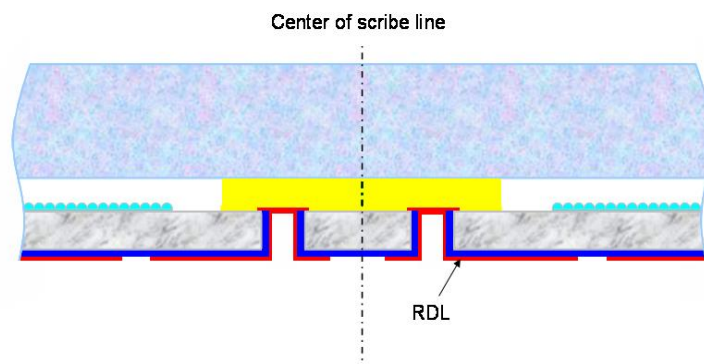
Step C: TSV formation



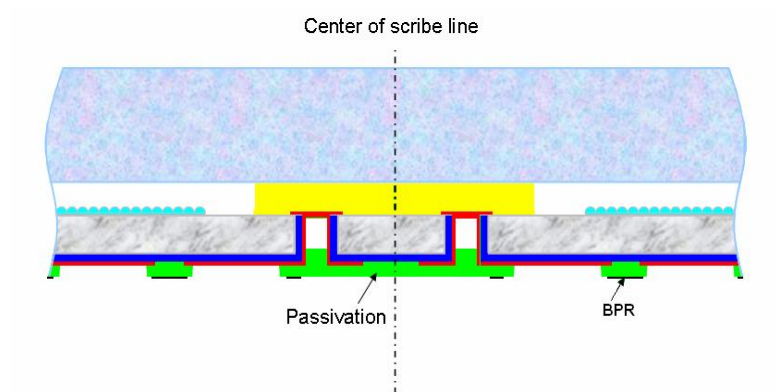
Step D: Isolation formation



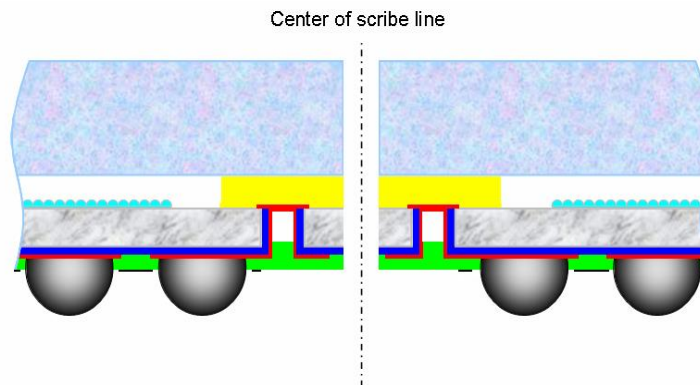
Step E: RDL process



Step F: Passivation process

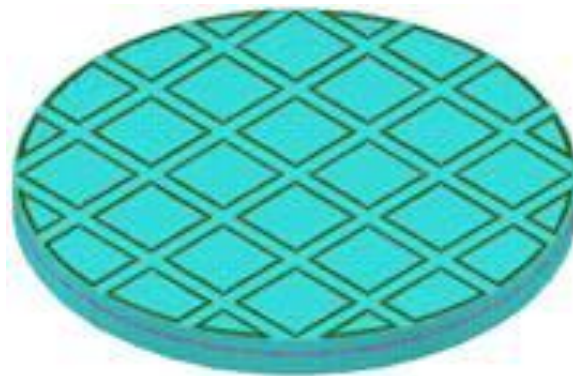


Step G: BGA & Dicing processes

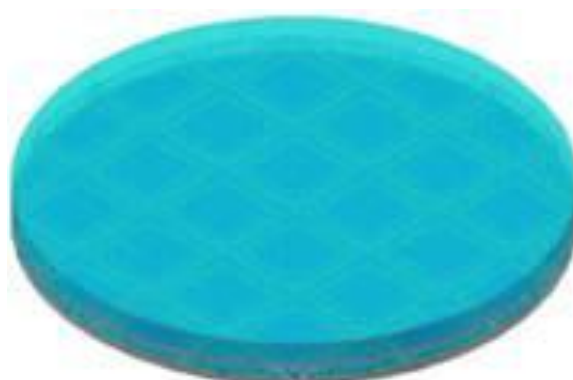


(3) CIS IR glass 模組封裝步驟說明：

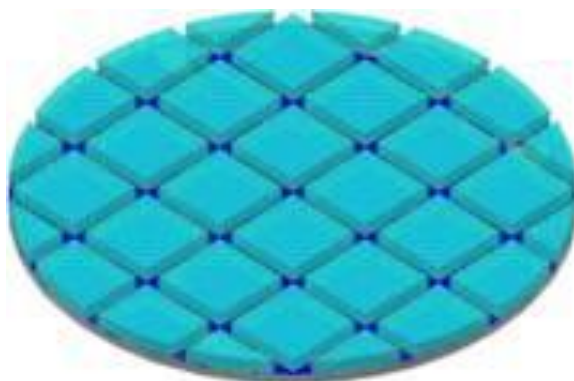
A. IR glass 模組化



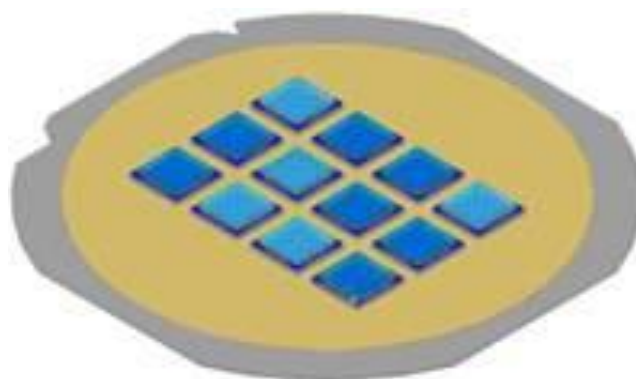
B. Si device 和 模組化 glass 結合



C. Si device 薄化和切割



D. 重新排列後以 frame type 出貨



3. 未來研發計畫：

配合市場以及客戶感應器(Sensor)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	國外	國內	供應情形
薄型玻璃	SCHOTT、NEG	✓		良好
靶材	優美科、有研、臺灣萬騰榮		✓	良好
研磨液	台灣艾杰旭		✓	良好
鍍金液	OKUNO	✓		良好
切削液	UDM SYSTEMS LLC		✓	良好

(四) 最近二年度主要進、銷貨客戶名單：

1. 最近二年度占進貨總額百分之十以上之進貨廠商名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	109 年				110 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	154,106	13	無	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	202,843	16	無
	其他	993,714	87		其他	1,029,914	84	
	進貨淨額	1,147,820	100		進貨淨額	1,232,757	100	

2. 最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度				110 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	5,498,556	76	具重大影響力之投資者	A 公司	5,597,445	73	具重大影響力之投資者
2	B 公司	1,041,770	14	無	B 公司	1,249,709	16	無
	其他	737,263	10		其他	820,189	11	
	銷貨淨額	7,277,589	100		銷貨淨額	7,667,343	100	

(五) 最近二年度生產量值表：

單位：新台幣仟元、千片

年度 生產量值 主要商品	109 年度			110 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
晶圓級尺寸封裝	354	300	3,931,414	357	294	3,718,161
晶圓級後護層封裝	544	224	624,464	484	299	578,896
晶圓測試及其他	275	298	580,571	606	461	951,903
合計			5,136,449			5,248,960

註：晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝的產量與產能單位為千片約當八吋晶圓，晶圓測試則為千片十二吋晶圓。

(六) 最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣仟元、千片

年度 銷售量值 主要商品	109 年度				110 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓級尺寸封裝	158	4,167,169	140	1,282,233	148	4,070,662	145	1,467,888
晶圓級後護層封裝	154	579,358	70	88,023	143	489,536	155	159,333
晶圓測試及其他	298	1,140,827	0	19,979	461	1,469,231	0	10,693
合計		5,887,354		1,390,235		6,029,429		1,637,914

註：晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝的銷售量單位為千片約當八吋晶圓，晶圓測試則為千片十二吋晶圓。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		109 年度	110 年度	當 年 度 截 至 111 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直 接 人 員	1,033	954	922
	間 接 人 員	607	591	583
	合 計	1,640	1,545	1,505
平 均 年 歲		37	38	38
平 均 服 務 年 資		6.8	7.6	7.8
學 歷 分 布 比 率	博 士	15	13	13
	碩 士	265	262	256
	大 專	884	838	821
	高 中	430	390	375
	高 中 以 下	46	42	40

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：109年度及110年度均無違反環保法令遭處分情事。

(二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

本公司除依環保法規規定操作與維護廢水處理設備、空氣污染防治設備與廢棄物分類與管理外，並持續關注國際環保發展趨勢，致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，以降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。

本公司除已獲得 ISO14001 及 ISO45001 等環安衛管理系統驗證多年，每年亦均持續推動與改善廠區環安衛制度及文化，更推動與獲得 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統、GHG 溫室氣體排放及重要產品的碳足跡驗證通過，致力達成公司環安衛政策(客戶至高滿意、安全零事故、環境永續發展)。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施：

(1) 本公司已依照「職工福利金條例」之規定，提撥福利金，組織職工福利委員會，辦理職工福利事項，從業人員得享有各項福利措施及年節獎金。

(2) 本公司從業人員一律參加全民健保、勞工保險及團體保險，享有各項保險給付權利等。

(3) 本公司每年發放年終獎金，於年度結算時，如有盈餘，除繳納稅捐彌補虧損及提撥股息、公積金外，依年度考核之結果及相關制度配發員工酬勞。

(4) 本公司訂有獎金發放制度，總經理會視實際營運成果，發放特別激勵獎金。

2. 員工學習與發展：

培育專業人才、改善人力素質一直是本公司秉持的信念。為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過

系統化的訓練藍圖展開教育訓練計劃，讓員工與公司一同成長。

110 年度共舉辦了 72 個班次的實體訓練課程，總訓練時數為 159.1 小時，總參與人次為 1,536 人次。另外，錄製及重製共 138 堂專業技術的數位課程，總時數為 45.76 小時。訓練類別包含：

(1)新進人員訓練

由人資單位安排新進人員訓練活動，內容包含公司簡介、環安衛介紹、品質與環境限用物質管理系統介紹。

(2)個人效能訓練

為提升個人工作能力、加強工作技能，以提升工作效率，規劃個人效能提升課程，如簡報技巧、溝通技巧等相關課程。

(3)技術訓練

為強化研發能力與改善產品技術以增加公司競爭力，提供技術類專業訓練課程，以強化工程與研發人員之專業技術能力。

(4)OJT 訓練

為使工程技術得以傳承，透過工作中學習，以培養技術人才，確保產品品質。

(5)管理學習

根據不同階層的管理職能，系統化的規劃管理人員學習計劃，並依此展開相關的管理課程。

(6)特定資格人員訓練

依相關法令規定或工作需求辦理特定資格人員訓練，並定期檢定，以增進工作技能，進而提升產品之品質。

3.退休制度：

依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，專戶存入臺灣銀行信託部。並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。截至 110 年底本公司台灣銀行退休金專戶已存入新台幣 52,904 仟元。自 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶，於 110 年認列費用之金額為新台幣 52,296 仟元。

4.勞資間之協議情形：

本公司制訂工作規則、人事管理規則及人事作業準則，從員工進用、升遷至退休、撫卹福利皆有完整規劃，作為公司與員工共同的規範，勞資的協調均透過勞資會議、員工溝通會進行討論與協調，並積極促進勞資雙方和諧與共贏。

5.工作環境與員工人身安全保護措施：

公司的環境安全衛生政策重點是建立一個安全的工作環境，防止職業傷害與疾病，保持健康的員工，增強每一位員工的意識和責任意識。公司的出入口都設有門禁刷卡裝置，健身房及集乳室有緊急壓扣，主要出入口和公共區域亦有保全人員 24 小時守衛與巡邏，以保障員工人身安全。

推動職場健康促進，包括健身計劃、控制體重計劃、身體健康檢查、健康講座、提供視障按摩站和醫療保健專業人士提供醫療服務。符合員工健康需求及提供的良好的職場環境，並獲得衛生福利部國民健康署頒發「企業健康職場自主認證標章」。

(二)最近年度及年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

為保障公司及客戶之機密資訊安全，本公司自民國 97 年 1 月設置「機密資訊保護委員會」並制定下列五大行動指導方針：

1. 建立與落實機密資訊及資訊安全管理系統。
2. 遵守法規與合約之機密資訊及資訊安全要求。
3. 落實員工與相關團體機密資訊及資訊安全教育及宣導。
4. 評估與鑑識風險並設定目標與控制措施。
5. 透過內部稽核活動持續改善機密資訊及資訊安全管理系統。

機密資訊保護委員會負責資訊安全管理及監督，並制定「機密資訊保護政策」及「機密資訊保護作業管理辦法」，明定公司機密資訊保護的管理程序及規範。委員會每季定期召開會議檢視資安政策及執行成果，且每年定期向董事會報告資安治理概況。民國 106 年 1 月增設獨立且專責之資安單位「企業保全部」(現改名為「員工服務部」)負責資訊安全治理、規劃、監督及推動執行，協同資訊單位共同建構全方位的資安防衛能力，並提升員工對資訊安全保護的正確觀念及警覺性，降低機密資訊外洩的風險。

近年度公司推行資安政策如下：

1. 強化資訊系統防護：
 - 完善資訊設備進出廠區掃毒作業流程。
 - 對外資訊系統定期弱點掃描與檢測。
 - 建立端點裝置防護及設備合法認證機制。
 - 導入多因子認證機制。
 - 電腦機房環境危害因子改善。
 - 關鍵設施重要參數異動監控。
 - 採購規格及驗收規範修訂資安相關條文。
2. 防範機密資料外洩：
 - 定期查核研發單位與機敏資料之存取權限。
 - 檔案伺服器全面導入檔案軌跡系統，並落實機密文件分級，以利後續日誌分析及資安鑑識，捕捉可能潛在的資安威脅。
 - 特權帳號限縮與連線稽核，落實權限區隔。
 - 因應疫情狀況啟動居家辦公措施，並搭配螢幕浮水印、連線全程側錄及事後主管查核等保護機制。
3. 資安宣導與訓練：
 - 了解資安趨勢，參加研討會及關注近期議題，及時規劃因應。
 - 定期舉辦資安措施教育訓練及溝通宣導，強化員工與廠商資安意識。
 - 定期進行資安災害應變演練，如社交工程攻擊、病毒擴散處置，提升資安人員的應變能力。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：
最近年度及截至年報刊印日止無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	經濟部	92/5~112/5	中壢工業區 A 棟(A5-3)	不得轉租、出借或以其他方式供他人使用。
		92/10~112/10	中壢工業區 A 棟(A1-3,A1-4, A2-4)	
		110/4~116/4	中壢工業區 A 棟(A4-1,A4-2, A4-3)	
		109/1~112/11	中壢工業區 A 棟(A5-1)	
		99/10~115/10	中壢工業區 A 棟(A8-1)	
		102/1~115/10	中壢工業區 C 棟(C7-1,C7-2)	
		101/4~116/03	中壢工業區 A 棟(A7-3)	
		102/1~116/11	中壢工業區 C 棟(C9-1,C9-2)	
		101/3~117/02	中壢工業區 C 棟(C10-1,C10-2)	
		99/5~119/4	中壢工業區 A 棟(A5-4、A7-2、A8-3)	
		110/1~121/8	中壢工業區 A 棟(A1-1)	
	宏惠光電	109/11~119/12	中壢工業區 A 棟(A3-3, A3-4)	
	新創人工智能	110/4~112/3	中壢工業區 C 棟(C2-2)	
借款合約	台北富邦銀行	106/06~111/05	營運週轉	無
	遠東銀行	106/06~111/06	營運週轉	無
	遠東銀行	108/06~113/12	營運週轉	無
後段服務合約	台灣積體電路製造股份有限公司	102/6~(註 1)	後段封裝服務	保密責任
設備寄託合約	台灣積體電路製造股份有限公司	108/10~109/10(註 2)	寄託供後段測試封裝之設備	保密責任
Collaboration Agreement	台灣積體電路製造股份有限公司	108/11~113/11(註 3)	後段晶圓測試代工業務	保密責任 賠償責任

註 1：本契約至任一方重大違約，經他方終止為止。

註 2：本契約自生效日起算一年，除另有規定外，自動展延一年，其後亦同。

註 3：本契約自生效日起算五年，除提前終止外，自動展延一年。

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一) 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
流動資產	2,470,933	2,300,458	2,189,356	3,152,343	3,881,788	
不動產、廠房及設備	5,457,634	3,940,619	3,439,913	4,054,174	3,892,324	
無形資產	57,240	38,758	23,341	48,073	38,118	
其他資產	216,845	214,913	516,171	500,596	360,390	
資產總額	8,202,652	6,494,748	6,168,781	7,755,186	8,172,620	
流動負債	分配前	1,363,854	1,253,376	1,276,369	1,987,204	1,400,533
	分配後	1,363,854	1,253,376	1,276,369	2,665,615	(註2)
非流動負債	2,434,681	2,143,338	1,601,603	752,526	555,909	
負債總額	分配前	3,798,535	3,396,714	2,877,972	2,739,730	1,956,442
	分配後	3,798,535	3,396,714	2,877,972	3,418,141	(註2)
歸屬於母公司業主之權益	4,404,117	3,098,034	3,290,809	5,015,456	6,216,178	
股本	2,719,193	2,717,597	2,713,643	2,713,643	2,713,643	
資本公積	1,630,968	1,613,146	396,424	396,424	396,424	
保留盈餘	分配前	79,104	(1,228,208)	181,206	1,905,389	3,106,111
	分配後	79,104	(1,228,208)	181,206	1,226,978	(註2)
其他權益	(25,148)	(4,501)	(464)	-	-	
庫藏股票	-	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	-	
權益總額	分配前	4,404,117	3,098,034	3,290,809	5,015,456	6,216,178
	分配後	4,404,117	3,098,034	3,290,809	4,337,045	(註2)

註1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：俟股東會決議後定案。

2. 簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)				
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
營 業 收 入	4,078,484	4,714,446	4,653,180	7,277,589	7,667,343
營 業 毛 利 (損)	(349,608)	9,512	547,628	2,214,992	2,587,215
營 業 (損) 益	(719,390)	(1,304,492)	233,537	1,762,948	2,207,924
營 業 外 收 入 及 支 出	(41,464)	(47,459)	(51,559)	(35,503)	(9,208)
稅 前 淨 利 (損)	(760,854)	(1,351,951)	181,978	1,727,445	2,198,734
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 (損)	(733,280)	(1,351,951)	181,978	1,727,445	2,198,734
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利 (損)	(733,280)	(1,351,951)	181,978	1,727,445	1,877,082
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(1,254)	(2,972)	(772)	(3,262)	2,051
本 期 綜 合 損 益 總 額	(734,534)	(1,354,923)	181,206	1,724,183	1,879,133
淨 利 (損) 歸 屬 於 母 公 司 業 主	(733,280)	(1,351,951)	181,978	1,727,445	1,877,082
淨 利 (損) 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	(734,534)	(1,354,923)	181,206	1,724,183	1,879,133
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
每 股 盈 餘 (淨 損)	(2.71)	(4.99)	0.67	6.37	6.92

註1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
106年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、林政治	無保留意見
107年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、林政治	無保留意見
108年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見
109年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見
110年	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡美貞、林政治	無保留意見

二、最近五年度財務分析

年 度		最近五年度財務分析				
		106年	107年	108年	109年	110年
財務結構	負債占資產比率(%)	46.31	52.30	46.65	35.33	23.94
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	125.31	133.01	142.22	142.27	173.99
償債能力	流動比率(%)	181.17	183.54	171.53	158.63	277.17
	速動比率(%)	143.25	163.34	138.51	131.34	225.63
	利息保障倍數(倍)	(18.16)	(31.60)	6.03	72.05	307.10
經營能力	應收款項週轉率(次)	4.78	4.56	5.05	5.79	5.84
	平均收現日數	76.35	80.04	72.27	63.03	62.50
	存貨週轉率(次)	14.29	23.71	21.65	26.36	20.84
	應付款項週轉率(次)	15.43	13.95	14.39	17.72	18.24
	平均銷貨日數	25.54	15.39	16.85	13.84	17.51
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	0.70	1.00	1.26	1.94	1.93
	總資產週轉率(次)	0.49	0.64	0.72	1.05	0.96
獲利能力	資產報酬率(%)	(8.42)	(17.89)	3.25	25.09	23.64
	權益報酬率(%)	(15.42)	(35.81)	5.70	41.59	33.42
	稅前純益占實收資本額比率(%)	(27.98)	(49.75)	6.71	63.66	81.03
	純益率(%)	(17.98)	(28.68)	3.91	23.74	24.48
	基本每股盈餘(淨損)(元)	(2.71)	(4.99)	0.67	6.37	6.92
現金流量	現金流量比率(%)	(12.43)	66.56	74.63	118.61	219.81
	現金流量允當比率(%)	66.53	69.96	90.16	126.04	172.15
	現金再投資比率(%)	(1.08)	5.35	5.98	13.73	12.92
槓桿度	營運槓桿度	(2.55)	(1.63)	10.25	2.44	2.15
	財務槓桿度	0.95	0.97	1.18	1.01	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20%者可免分析)						
1.負債占資產比率減少，主要係負債總額減少且資產總額增加所致。						
2.長期資金占不動產、廠房及設備比率增加主要係股東權益增加所致。						
3.流動比率增加主要係流動資產增加及流動負債減少所致。						
4.速動比率增加主要係速動資產增加及流動負債減少所致。						
5.利息保障倍數增加，主要係稅前損益增加及利息費用減少所致。						
6.存貨週轉率減少及平均銷貨日數增加，主要係平均存貨增加所致。						
7.權益報酬率減少，主要係平均權益總額增加所致。						
8.稅前純益占實收資本額比率增加主要係稅前純益增加所致。						
9.現金流量比率增加主要係營業活動淨現金流量增加及流動負債減少所致。						
10.現金流量允當比率增加主要係最近五年度營業活動淨現金流量增加所致。						

計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

精材科技股份有限公司



審計委員會召集人

謝徽榮



中 華 民 國 一 一 一 年 二 月 十 日

四、一一〇年度財務報告

精材科技股份有限公司

財務報告暨會計師查核報告
民國 110 及 109 年度

地址：桃園市中壢區吉林路23號9樓

電話：(03)4331818

會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

精材科技股份有限公司（以下簡稱精材公司）民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與精材公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對精材公司民國 110 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對精材公司民國 110 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

晶圓測試收入之認列

精材公司今年晶圓測試收入業務相對成長，其成長金額約 289,708 仟元，成長率約 26%，其係依客戶約定合約進行晶圓測試，由於隨精材公司進行測試服務，客戶同時取得並耗用精材公司測試服務所提供之效益，故符合國際財務報導準則第 15 號第 35 段(a)條件，應隨時間逐步認列收入。收入認列之相關會計政策，請參閱財務報表附註四、五及二十。由於精材公司之晶圓測試收入係依據合約進行測試完成時認列收入，因前述交易包含較多之人工計算作業，故存在因錯誤而造成晶圓測試收入未正確認列之風險，因此將晶圓測試收入之認列列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解晶圓測試收入認列之主要內部控制設計。
2. 抽核晶圓測試收入明細，並核對至相關憑證，以確認收入認列金額之正確性。
3. 抽核晶圓測試收入明細，核對實際收款金額及匯款證明與收入認列之金額是否相符；尚未收款者則檢視是否在授信期間內，如已逾授信期間則進一步了解有無異常情事，並發函詢證核對是否與收入認列之金額相符。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精材公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算精材公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

精材公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存

有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對精材公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使精材公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致精材公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對精材公司民國 110 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

會計師 林 政 治

林政治



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 1 0 日



精利科技股份有限公司

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 2,112,281	26	\$ 1,012,987	13	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註七)	\$ 18	-	\$ 58	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	7,006	-	10,245	-	2170	應付帳款	239,304	3	317,729	4
1140	合約資產(附註二十及三一)	397,927	5	275,032	4	2201	應付薪資及獎金	165,414	2	164,960	2
1170	應收帳款淨額(附註八)	312,880	4	228,133	3	2206	應付員工及董事酬勞(附註二七)	287,621	4	260,390	3
1180	應收關係人款項淨額(附註八及三一)	725,261	9	1,358,624	17	2213	應付工程及設備款	154,336	2	377,594	5
1310	存貨(附註五及九)	275,184	3	212,305	3	2230	本期所得稅負債(附註二五)	118,496	1	24,950	-
1476	其他金融資產	2,612	-	37	-	2280	租賃負債-流動(附註十一及二九)	39,187	-	40,012	1
1479	其他流動資產(附註十三及三一)	48,637	1	54,980	1	2320	一年內到期之長期銀行借款(附註十六)	-	-	233,333	3
11XX	流動資產合計	<u>3,881,788</u>	<u>48</u>	<u>3,152,343</u>	<u>41</u>	2399	應付費用及其他流動負債(附註十五及三一)	396,157	5	568,178	7
	非流動資產					21XX	流動負債合計	<u>1,400,533</u>	<u>17</u>	<u>1,987,204</u>	<u>25</u>
1600	不動產、廠房及設備(附註十)	3,892,324	48	4,054,174	52		非流動負債				
1755	使用權資產(附註十一)	253,949	3	261,432	3	2541	長期銀行借款(附註十六)	-	-	205,556	3
1780	無形資產(附註十二)	38,118	-	48,073	1	2550	負債準備(附註十四)	339,703	4	323,902	4
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	91,714	1	229,444	3	2580	租賃負債-非流動(附註十一及二九)	216,206	3	220,902	3
1920	存出保證金	12,871	-	9,720	-	2600	淨確定福利負債(附註十七)	-	-	2,166	-
1975	淨確定福利資產(附註十七)	1,856	-	-	-	25XX	非流動負債合計	<u>555,909</u>	<u>7</u>	<u>752,526</u>	<u>10</u>
15XX	非流動資產合計	<u>4,290,832</u>	<u>52</u>	<u>4,602,843</u>	<u>59</u>	2XXX	負債合計	<u>1,956,442</u>	<u>24</u>	<u>2,739,730</u>	<u>35</u>
							權益(附註十八及十九)				
							股本				
						3110	普通股股本	2,713,643	33	2,713,643	35
						3200	資本公積	396,424	5	396,424	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	190,538	2	18,120	-
						3350	未分配盈餘	2,915,573	36	1,887,269	25
						3300	保留盈餘合計	3,106,111	38	1,905,389	25
						3XXX	權益合計	<u>6,216,178</u>	<u>76</u>	<u>5,015,456</u>	<u>65</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 8,172,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,755,186</u>	<u>100</u>		負債與權益總計	<u>\$ 8,172,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,755,186</u>	<u>100</u>

後附註附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		110 年度		109 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二十及三一）	\$ 7,667,343	100	\$ 7,277,589	100
5000	營業成本（附註九、二七及三一）	<u>5,080,128</u>	<u>66</u>	<u>5,062,597</u>	<u>70</u>
5950	營業毛利	<u>2,587,215</u>	<u>34</u>	<u>2,214,992</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註二七及三一）				
6100	行銷費用	53,822	1	49,529	1
6200	管理費用	124,082	1	147,836	2
6300	研究發展費用	<u>283,673</u>	<u>4</u>	<u>253,999</u>	<u>3</u>
6000	合 計	<u>461,577</u>	<u>6</u>	<u>451,364</u>	<u>6</u>
6500	其他營業收益及費損淨額 （附註二一、二七及三一）	<u>82,304</u>	<u>1</u>	<u>(680)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>2,207,942</u>	<u>29</u>	<u>1,762,948</u>	<u>24</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	3,051	-	3,081	-
7050	財務成本（附註二三）	<u>(7,183)</u>	-	<u>(24,314)</u>	-
7020	其他利益及損失（附註二四）	<u>(5,076)</u>	-	<u>(14,270)</u>	-
7000	合 計	<u>(9,208)</u>	-	<u>(35,503)</u>	-
7900	稅前淨利	2,198,734	29	1,727,445	24
7950	所得稅費用（附註二五）	<u>(321,652)</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>1,877,082</u>	<u>25</u>	<u>1,727,445</u>	<u>24</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110 年度		109 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 七)	\$ 2,051	-	(\$ 3,262)	-
8300	本年度其他綜合損 益	2,051	-	(3,262)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,879,133</u>	<u>25</u>	<u>\$ 1,724,183</u>	<u>24</u>
	每股盈餘(附註二六)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 6.92</u>		<u>\$ 6.37</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.86</u>		<u>\$ 6.33</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

權益變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股 股數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 保 留 盈 餘 合 計	其 他 權 益 項 目 員 工 未 賺 得 酬 勞	權 益 合 計	
A1	109 年 1 月 1 日餘額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ -	\$ 181,206	\$ 181,206	(\$ 464)	\$ 3,290,809
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	18,120	(18,120)	-	-	-
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	1,727,445	1,727,445	-	1,727,445
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,262)	(3,262)	-	(3,262)
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,724,183	1,724,183	-	1,724,183
N1	認列限制員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-	464	464
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	271,364	2,713,643	396,424	18,120	1,887,269	1,905,389	-	5,015,456
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	172,418	(172,418)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(678,411)	(678,411)	-	(678,411)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	1,877,082	1,877,082	-	1,877,082
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,051	2,051	-	2,051
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,879,133	1,879,133	-	1,879,133
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	<u>271,364</u>	<u>\$ 2,713,643</u>	<u>\$ 396,424</u>	<u>\$ 190,538</u>	<u>\$ 2,915,573</u>	<u>\$ 3,106,111</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,216,178</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：




 精材科技股份有限公司
 現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110 年度	109 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 2,198,734	\$ 1,727,445
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	843,002	817,901
A20200	攤銷費用	18,160	19,609
A20300	預期信用減損損失	63	8
A20900	財務成本	7,183	24,314
A21200	利息收入	(3,051)	(3,081)
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	-	464
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(31,564)	(10,442)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	-	67,676
A29900	租賃修改利益	(107)	-
A24100	外幣兌換淨益	(2,481)	(128)
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	3,199	(5,158)
A31125	合約資產	(122,919)	(56,078)
A31150	應收帳款淨額	(84,786)	(6,822)
A31160	應收關係人款項淨額	633,363	(651,658)
A31190	其他應收關係人款項	-	29,781
A31200	存 貨	(62,879)	(40,506)
A31240	其他流動資產	4,317	(28,280)
A31250	其他金融資產	(2,451)	1,037
A32150	應付帳款	(78,425)	64,046
A32180	應付薪資及獎金	454	10,417
A32180	應付員工及董事酬勞	27,231	231,893
A32230	應付費用及其他流動負債	(176,305)	166,577
A32240	淨確定福利資產／負債	(1,971)	(2,054)
A33000	營運產生之現金	3,168,767	2,356,961
A33500	(支付)收回所得稅	(90,187)	157
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,078,580</u>	<u>2,357,118</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110 年度	109 年度
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 841,824)	(\$ 967,859)
B02800	處分不動產、廠房及設備	32,768	10,442
B03700	存出保證金增加	(8,115)	(515)
B03800	存出保證金減少	4,964	561
B04500	購置無形資產	(8,205)	(44,341)
B07500	收取之利息	<u>2,927</u>	<u>3,154</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(817,485)</u>	<u>(998,558)</u>
	籌資活動之現金流量：		
C01600	舉借長期借款	-	150,000
C01700	償還長期借款	(438,889)	(1,236,111)
C04020	租賃本金償還	(39,566)	(42,479)
C04500	發放現金股利	(678,411)	-
C05600	支付之利息	<u>(4,935)</u>	<u>(20,371)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,161,801)</u>	<u>(1,148,961)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	1,099,294	209,599
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,012,987</u>	<u>803,388</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,112,281</u>	<u>\$ 1,012,987</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

財務報表附註

民國 110 及 109 年度

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

精材科技股份有限公司（以下簡稱本公司）於 87 年 9 月 11 日經經濟部核准設立，主要營業項目為半導體之晶圓級尺寸封裝、晶圓級後護層封裝及晶圓測試業務。本公司股票自 104 年 3 月 30 日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。本公司註冊地及業務主要營運據點為桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告業已於 111 年 2 月 10 日經本公司董事會核准並通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下稱「IFRSs」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 111 年適用之金管會認可之 IFRSs

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會 (IASB) 發布之生效日</u>
「IFRSs 2018-2020 之年度改善」	2022 年 1 月 1 日 (註 1)
國際財務報導準則第 3 號之修正「對觀念架構之引述」	2022 年 1 月 1 日 (註 2)
國際會計準則第 16 號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日 (註 3)
國際會計準則第 37 號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日 (註 4)

註 1：國際財務報導準則第 9 號之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改。

註 2：收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 3：於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 4：於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

1. IFRSs 2018-2020 之年度改善

IFRSs 2018-2020 之年度改善修正若干準則，其中國際財務報導準則第 9 號「金融工具」之修正，為評估金融負債之交換或條款修改是否具重大差異，比較新舊合約條款之現金流量折現值（包括簽訂新合約或修改合約所收付費用之淨額）是否有 10% 之差異時，前述所收付費用僅應包括借款人與貸款人間收付之費用。

2. 國際會計準則第 16 號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」

該修正規定，為使不動產、廠房及設備達到能符合管理階層預期運作方式之必要地點及狀態而產出之項目之銷售價款，不宜作為該資產之成本減項。前述產出項目應按國際會計準則第 2 號「存貨」衡量，並按所適用之準則將銷售價款及成本認列於損益。

該修正適用於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備，本公司於首次適用該修正時，比較期間資訊應予重編。

3. 國際會計準則第 37 號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」

該修正明訂，於評估合約是否係虧損性時，「履行合約之成本」應包括履行合約之增額成本（例如，直接人工及原料）及與履行合約直接相關之其他成本之分攤（例如，履行合約所使用之不動產、廠房及設備項目之折舊費用分攤）。

本公司將於首次適用該修正時，將累積影響數認列於首次適用日之保留盈餘。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註1)</u>
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
國際財務報導準則第 17 號「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 17 號之修正	2023 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 17 號之修正「初次適用國際財務報導準則第 17 號及國際財務報導準則第 9 號—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日 (註 2)
國際會計準則第 8 號之修正「會計估計之定義」	2023 年 1 月 1 日 (註 3)
國際會計準則第 12 號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日 (註 4)

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註 3：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

註 4：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

1. 國際會計準則第 1 號之修正「負債分類為流動或非流動」

該修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本公司於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少 12 個月之權利。若本公司於報導期間結束日具有該權利，無論

本公司是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。該修正並釐清，若本公司須遵循特定條件始具有遞延清償負債之權利，本公司必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本公司是否遵循該等條件亦然。

該修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依國際會計準則第 32 號「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

2. 國際會計準則第 12 號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

該修正釐清，原始認列時產生相同金額之應課稅及可減除暫時性差異之交易，不適用國際會計準則第 12 號原始認列之豁免規定。本公司將於 2022 年 1 月 1 日就與租賃及除役義務有關之所有可減除及應課稅暫時性差異認列遞延所得稅資產（若很有可能課稅所得以供可減除暫時性差異使用）及遞延所得稅負債，並於該日將累積影響數認列為保留盈餘初始餘額之調整。對租賃及除役義務以外之交易則自 2022 年 1 月 1 日以後發生者推延適用該修正。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。惟負債之條款可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致其清償者，並不影響分類。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外 幣

編製財務報告時，以功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，係按交易日匯率予以換算認列。於報導期間結束時，外幣貨幣性項目以該日即期匯率重新換算，兌換差額於發生當年度認列為損益；以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益；以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

(五) 約當現金

約當現金係可隨時轉換成定額現金，且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資，係用於滿足短期現金承諾。

(六) 存 貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算採加權平均法。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本減累計折舊及累計減損衡量。成本包括可直接歸屬於取得或建置資產之增額成本。直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產幾乎已達預定使用或出售狀態為止。除上述者外，所有其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

建造過程中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

折舊係採直線法提列，於資產耐用年限內沖銷其成本減除殘值後之金額。折舊係按下列耐用年數計提：房屋及建築，3 至 32 年；機器設備，3 至 8 年；辦公設備，3 至 11 年；租賃改良，3 至 16 年；其他設備，3 至 11 年。估計耐用年限、殘值及折舊方法於報導期間結束日進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響，土地不提列折舊。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備予以除列。不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(八) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。攤銷金額係依直線法按下列耐用年數計提：專門技術，20 年；電腦軟體成本，3 年；專利權，2 年；其他，2 至 5 年。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用。

研究階段之支出於發生時認列為費用；發展階段之支出於符合規定條件時，認列為無形資產，採用直線法依其耐用年限分年攤銷，不符合規定條件之支出則列為當年度費用。

(九) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。若可按合理基礎分攤時，共用資產亦分攤至個別現金產生單位，反之，則分攤至按可依合理基礎分攤之最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或

發行透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益。公允價值之決定方式，請參閱附註三十。

(十一) 金融資產

金融資產分類係於金融資產原始認列時視其性質及目的而決定。符合慣例交易金融資產之認列與除列，依相同金融資產種類分別採交易日會計處理。

1. 金融資產種類及衡量

本公司所持有之金融資產種類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及按攤銷後成本衡量之金融資產。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

係未能符合避險會計條件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

(2) 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及其他應收款項）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

2. 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）及合約資產之減損損失。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯

著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

本公司為內部信用風險管理目的，在不考量所持有擔保品之前提下，判定下列情況代表金融資產已發生違約：

- (1) 有內部或外部資訊顯示債務人已不可能清償債務。
- (2) 逾期超過 90 天，除非有合理且可佐證之資訊顯示延後之違約基準更為適當。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

3. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

(十二) 金融負債及權益工具

1. 金融負債或權益工具之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

2. 權益工具

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

3. 金融負債

金融負債係按有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值作後續衡量。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係未能符合避險會計要件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

4. 金融負債之除列

本公司僅於義務解除、取消或到期時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額之差額認列為損益。

(十三) 衍生金融工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(十四) 負債準備

本公司因過去事件負有現時義務（法定或推定義務），且很有可能須清償該義務，並對該義務金額能可靠估計時，認列負債準備。

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所須支出之最佳估計。若負債準備係以清償該現時義務之估計現金流量衡量，其帳面金額係為該等現金流量之現值。

(十五) 收入認列

1. 封裝服務收入

本公司於客戶封裝服務合約辨認履約義務後，於滿足各履約義務時認列收入。

封裝服務係依客戶約定規格製造商品，由於客戶於封裝服務過程中即對商品取得控制，故本公司係隨時間逐步認列收入。封裝服務收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

2. 測試服務收入

本公司於履行測試合約時，客戶同時取得並耗用本公司履約所提供之效益，本公司對迄今已完成履約之款項具有可執行之權利，故本公司係隨時間逐步認列測試合約之收入。

本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債（帳列應付費用及其他流動負債）。

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 60 天，部分客戶則為發票日後 30 天。封裝及測試服務收入之對價為短期應收款，因折現效果不重大，故按原始發票金額衡量。

(十六) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付及取決於指數之變動租賃給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、用於決定租賃給付之指數變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

（十七）員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益及扣除利息後之計畫資產

報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

(十八) 股份基礎給付協議

本公司對於轉換日前已既得之員工認股權，選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」之豁免。

本公司於101年1月1日後給與之員工認股權，係以給與日員工認股權之公允價值衡量。員工認股權係按給與日所決定之公允價值及預期既得員工認股權之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

本公司給與之現金交割股份基礎給付協議，係認列為取得商品或勞務所產生之負債，並以所承擔負債之公允價值作為原始衡量。該負債係於清償前之每一資產負債表日及清償日再衡量其公允價值，並將公允價值變動認列為損益。

本公司發行限制員工權利股票時，係於給與日認列其他權益(員工未賺得酬勞)，並同時調整資本公積－限制員工權利股票。若屬有償發行，且約定員工離職時須退還價款者，應認列相關應付款。若員工於既得期間內離職無須返還已領取之股利，於宣告發放股利時認列費用，並同時調整保留盈餘及資本公積－限制員工權利股票。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之限制員工權利股票估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積－限制員工權利股票。

(十九) 所得稅

所得稅費用係當年度所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當年度所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用附註四所述之會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情近期在我國之發展及對經濟環境可能之影響，納入對現金流量推估、成長率、折現率、獲利能力等相關重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

重大會計判斷

(一) 收入認列

本公司依照客戶合約之約定及所適用之相關法規，評估履約義務係隨時間逐步滿足，其條件如附註四、(十五)所述。相關銷貨退回及折讓之估列係基於歷史經驗及考量不同合約條件，以估計可能發生之產品退回及折讓，於當年度滿足各履約義務時認列為營業收入之減項，且管理階層定期檢視估計之合理性。

估計及假設不確定性之主要來源

(一) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定報導期間結束日存貨之淨變現價值。

由於科技快速變遷，本公司評估報導期間結束日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

六、現金及約當現金

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
現金及銀行存款	\$ 1,832,281	\$ 543,987
附買回條件公司債	<u>280,000</u>	<u>469,000</u>
	<u>\$ 2,112,281</u>	<u>\$ 1,012,987</u>

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
衍生金融資產		
遠期外匯合約	<u>\$ 7,006</u>	<u>\$ 10,245</u>
衍生金融負債		
遠期外匯合約	<u>\$ 18</u>	<u>\$ 58</u>

本公司從事衍生金融工具交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司上述之衍生金融工具因不符合有效避險條件，故不適用避險會計。

本公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

	到 期 期 間	合 約 金 額 (仟 元)
<u>110年12月31日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	111年1月~111年3月	USD 49,910/ NTD 1,388,197
<u>109年12月31日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	110年1月~110年2月	USD 49,740/ NTD 1,407,732

八、應收帳款

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
<u>非關係人</u>		
應收帳款	\$ 313,160	\$ 228,374
備抵損失	(280)	(241)
應收帳款淨額	<u>312,880</u>	<u>228,133</u>
<u>關係人</u>		
應收帳款	725,261	1,358,624
備抵損失	-	-
應收帳款淨額	<u>725,261</u>	<u>1,358,624</u>
合 計	<u>\$ 1,038,141</u>	<u>\$ 1,586,757</u>

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 60 天，部分客戶則為發票日後 30 天。本公司參考歷史經驗及考量個別客戶現時財務狀況及未來展望（如參考客戶所處產業展望以及未來一定期間之採購需求變化等），除個別客戶實際發生信用減損提列減損損失外，將個別客戶區分為不同風險群組並依各群組之預期損失率認列備抵損失；另針對逾期超過 90 天且無其他信用保證方式之應收帳款係認列 100%備抵損失。

除已提列減損者，其餘應收帳款金額於報導期間結束日之帳齡分析請參閱下表。本公司針對已逾期但未提列減損之應收帳款，經評估其信用品質並未發生重大改變且相關帳款仍可回收，故尚無減損疑慮。

應收帳款淨額之帳齡分析

	110年12月31日	109年12月31日
未逾期亦未減損	\$ 1,038,141	\$ 1,581,985
逾期 30 天	-	1,187
逾期 31~60 天	-	3,585
合 計	<u>\$ 1,038,141</u>	<u>\$ 1,586,757</u>

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	110年度	109年度
年初餘額	\$ 241	\$ 217
加：本年度提列減損損失	39	24
年底餘額	<u>\$ 280</u>	<u>\$ 241</u>

九、存 貨

	110年12月31日	109年12月31日
原 物 料	<u>\$275,184</u>	<u>\$212,305</u>

本公司與存貨相關之營業成本中，分別包括下列收益及費損：

	110年度	109年度
存貨（跌價損失）回升利益	(\$ 6,589)	\$ 3,253
出售下腳收入	<u>\$ 1,382</u>	<u>\$ 2,486</u>

十、不動產、廠房及設備

	110年12月31日	109年12月31日
自 用	\$ 3,823,630	\$ 3,969,444
營業租賃出租	<u>68,694</u>	<u>84,730</u>
	<u>\$ 3,892,324</u>	<u>\$ 4,054,174</u>

(一) 自 用

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	辦 公 設 備	租 賃 改 良	其 他 設 備	未 完 工 程 及 待 驗 設 備	合 計
成 本								
110年1月1日餘額	\$ 780,851	\$ 2,942,057	\$ 9,291,221	\$ 249,643	\$ 661,631	\$ 1,200,782	\$ 152,358	\$ 15,278,543
增 加	8,664	196,933	83,460	13,742	5,662	253,223	79,264	640,948
出售或報廢	-	(641)	(389,847)	(433)	-	(3,710)	-	(393,427)
110年12月31日餘額	<u>\$ 789,515</u>	<u>\$ 3,138,349</u>	<u>\$ 8,984,834</u>	<u>\$ 262,952</u>	<u>\$ 667,293</u>	<u>\$ 1,450,295</u>	<u>\$ 231,622</u>	<u>\$ 15,524,860</u>
累計折舊及減損								
110年1月1日餘額	\$ -	\$ 1,154,865	\$ 8,737,088	\$ 201,009	\$ 523,384	\$ 692,753	\$ -	\$ 11,309,099
折 舊	-	274,398	299,145	16,929	47,762	147,324	-	785,558
出售或報廢	-	(641)	(388,643)	(433)	-	(3,710)	-	(393,427)
110年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,428,622</u>	<u>\$ 8,647,590</u>	<u>\$ 217,505</u>	<u>\$ 571,146</u>	<u>\$ 836,367</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,701,230</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 789,515</u>	<u>\$ 1,709,727</u>	<u>\$ 337,244</u>	<u>\$ 45,447</u>	<u>\$ 96,147</u>	<u>\$ 613,928</u>	<u>\$ 231,622</u>	<u>\$ 3,823,630</u>

(接次頁)

(承前頁)

	土	地	房屋及建築	機器設備	辦公設備	租賃改良	其他設備	未完工程及 待驗設備	合 計
成 本									
109年1月1日餘額	\$ 780,851	\$ 2,063,744	\$ 9,549,931	\$ 210,041	\$ 656,448	\$ 1,020,264	\$ 15,821	\$ 14,297,100	
增 加	-	878,313	212,296	39,602	5,183	180,518	136,537	1,452,449	
出售或報廢	-	-	(471,006)	-	-	-	-	(471,006)	
109年12月31日餘額	<u>\$ 780,851</u>	<u>\$ 2,942,057</u>	<u>\$ 9,291,221</u>	<u>\$ 249,643</u>	<u>\$ 661,631</u>	<u>\$ 1,200,782</u>	<u>\$ 152,358</u>	<u>\$ 15,278,543</u>	
累計折舊及減損									
109年1月1日餘額	\$ -	\$ 963,577	\$ 8,753,175	\$ 182,785	\$ 470,203	\$ 586,607	\$ -	\$ 10,956,347	
折 舊	-	191,288	387,243	18,224	53,181	106,146	-	756,082	
減損損失	-	-	67,676	-	-	-	-	67,676	
出售或報廢	-	-	(471,006)	-	-	-	-	(471,006)	
109年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,154,865</u>	<u>\$ 8,737,088</u>	<u>\$ 201,009</u>	<u>\$ 523,384</u>	<u>\$ 692,753</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,309,099</u>	
109年12月31日淨額	<u>\$ 780,851</u>	<u>\$ 1,787,192</u>	<u>\$ 554,133</u>	<u>\$ 48,634</u>	<u>\$ 138,247</u>	<u>\$ 508,029</u>	<u>\$ 152,358</u>	<u>\$ 3,969,444</u>	

本公司建築物之重大組成部分主要有廠房主建物、機電動力設備及無塵潔淨室等，分別按其耐用年限 18 至 32 年、7 至 11 年及 10 至 11 年提列折舊；機器設備之重大組成部分主要有蝕刻機、濺鍍機等，按其耐用年限 3 至 8 年提列折舊。

另本公司評估部分機器設備之帳面價值無法回收，故於 109 年度認列減損損失 67,676 仟元，帳列其他營業收益及費損項下。

(二) 營業租賃出租

	房屋及建築	辦 公 設 備	其 他 設 備	合 計
成 本				
110年1月1日餘額	\$ 155,399	\$ 2,009	\$ 21,584	\$ 178,992
增 添	-	-	325	325
110年12月31日餘額	<u>\$ 155,399</u>	<u>\$ 2,009</u>	<u>\$ 21,909</u>	<u>\$ 179,317</u>
累計折舊				
110年1月1日餘額	\$ 77,653	\$ 1,888	\$ 14,721	\$ 94,262
折舊費用	12,638	99	3,624	16,361
110年12月31日餘額	<u>\$ 90,291</u>	<u>\$ 1,987</u>	<u>\$ 18,345</u>	<u>\$ 110,623</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 65,108</u>	<u>\$ 22</u>	<u>\$ 3,564</u>	<u>\$ 68,694</u>
成 本				
109年1月1日餘額	\$ 153,429	\$ 2,009	\$ 21,584	\$ 177,022
增 添	1,970	-	-	1,970
109年12月31日餘額	<u>\$ 155,399</u>	<u>\$ 2,009</u>	<u>\$ 21,584</u>	<u>\$ 178,992</u>
累計折舊				
109年1月1日餘額	\$ 64,954	\$ 1,788	\$ 11,120	\$ 77,862
折舊費用	12,699	100	3,601	16,400
109年12月31日餘額	<u>\$ 77,653</u>	<u>\$ 1,888</u>	<u>\$ 14,721</u>	<u>\$ 94,262</u>
109年12月31日淨額	<u>\$ 77,746</u>	<u>\$ 121</u>	<u>\$ 6,863</u>	<u>\$ 84,730</u>

本公司部分廠房及廠務設施以營業租賃方式出租予采鈺科技股份有限公司（采鈺公司），租約內容係由租賃雙方協議決定，租賃期間為1~2年，並有延展租期之選擇權，租金按月收取，租金收入及出租資產折舊帳列其他營業收益及費損項下。承租人於租賃期間結束時，對該資產不具有承購權。與采鈺公司之出租合約係依實際產能調整租賃給付。

營業租賃出租自有建築物之未來將收取之租賃給付總額如下：

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
不超過1年	\$ 69,350	\$ 73,400
1~5年	<u>-</u>	<u>63,600</u>
	<u>\$ 69,350</u>	<u>\$137,000</u>

本公司以營業租賃出租建築物係按其耐用年限2至5年予以計提折舊。

十一、租賃協議

(一) 使用權資產

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
使用權資產帳面金額 房屋及建築	<u>\$253,949</u>	<u>\$261,432</u>
	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
使用權資產之增添	<u>\$ 33,600</u>	<u>\$ 4,849</u>
使用權資產之折舊費用 房屋及建築	<u>\$ 41,083</u>	<u>\$ 45,419</u>

(二) 租賃負債

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 39,187</u>	<u>\$ 40,012</u>
非流動	<u>\$216,206</u>	<u>\$220,902</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
房屋及建築	0.84%~2.25%	1.40%~2.25%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租建築物做為廠房、辦公室使用，租賃期間為 5~15 年。於中壢工業區建築物租賃合約約定依消費者物價指數調整租賃給付。另於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	110年度	109年度
低價值資產租賃費用	<u>\$ 4,063</u>	<u>\$ 3,825</u>
租賃之現金流出總額	<u>\$ 47,017</u>	<u>\$ 52,801</u>

本公司選擇對符合低價值資產租賃之其他設備適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十二、無形資產

	專 門 技 術	電 腦 軟 體 成 本	專 利 權 及 其 他	合 計
<u>成 本</u>				
110年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 82,950	\$ 196,546	\$ 392,836
增 加	<u>-</u>	<u>4,275</u>	<u>3,930</u>	<u>8,205</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 87,225</u>	<u>\$ 200,476</u>	<u>\$ 401,041</u>
<u>累計攤銷</u>				
110年1月1日餘額	\$ 109,089	\$ 79,844	\$ 155,830	\$ 344,763
增 加	<u>4,251</u>	<u>2,486</u>	<u>11,423</u>	<u>18,160</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 82,330</u>	<u>\$ 167,253</u>	<u>\$ 362,923</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,895</u>	<u>\$ 33,223</u>	<u>\$ 38,118</u>
<u>成 本</u>				
109年1月1日餘額	\$ 113,340	\$ 80,956	\$ 154,199	\$ 348,495
增 加	<u>-</u>	<u>1,994</u>	<u>42,347</u>	<u>44,341</u>
109年12月31日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 82,950</u>	<u>\$ 196,546</u>	<u>\$ 392,836</u>
<u>累計攤銷</u>				
109年1月1日餘額	\$ 103,423	\$ 76,649	\$ 145,082	\$ 325,154
增 加	<u>5,666</u>	<u>3,195</u>	<u>10,748</u>	<u>19,609</u>
109年12月31日餘額	<u>\$ 109,089</u>	<u>\$ 79,844</u>	<u>\$ 155,830</u>	<u>\$ 344,763</u>
109年12月31日淨額	<u>\$ 4,251</u>	<u>\$ 3,106</u>	<u>\$ 40,716</u>	<u>\$ 48,073</u>

本公司未有將上述無形資產提供設定質押作為擔保。

十三、其他流動資產

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
預付費用	\$ 40,334	\$ 35,450
預付貨款	2,314	11,755
暫付款	5,989	7,586
應收退稅款	<u>-</u>	<u>189</u>
	<u>\$ 48,637</u>	<u>\$ 54,980</u>

十四、負債準備

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
<u>非流動</u>		
除役成本	<u>\$339,703</u>	<u>\$323,902</u>

	<u>除 役 成 本</u>
<u>110 年度</u>	
年初餘額	\$323,902
本年度提列	20,225
本年度沖銷	(<u>4,424</u>)
年底餘額	<u>\$339,703</u>
<u>109 年度</u>	
年初餘額	\$153,906
本年度提列	<u>169,996</u>
年底餘額	<u>\$323,902</u>

除役成本負債準備係拆卸、移除相關設備及復原其所在地點所產生之除役負債準備，其金額以預期清償義務之現金流量估計折現值衡量，於報導期間結束日進行適當之評估及調整。

十五、應付費用及其他流動負債

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
應付委外加工費	\$114,584	\$182,509
應付電費	32,892	38,808
應付勞健保	29,668	28,063
退款負債	23,033	56,669
應付退休金	14,653	14,522
應付防治污染處理費	10,930	12,571
應付租金	1,448	5,735
其 他	<u>168,949</u>	<u>229,301</u>
	<u>\$396,157</u>	<u>\$568,178</u>

十六、長期銀行借款

	<u>110年12月31日</u>	<u>109年12月31日</u>
銀行信用借款：		
自 109 年 6 月起，每 3 個月 為一期，分 9 期償還，110 年提前償清，年利率 110 年為 1.04%；109 年為 1.04%~1.21%	\$ -	\$388,889
自 111 年 3 月起，每 3 個月 為一期，分 16 期償還， 110 年提前清償，年利率 110 年及 109 年皆為 1.07%	-	50,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$438,889</u>
流 動	\$ -	\$233,333
非流 動	-	205,556
	<u>\$ -</u>	<u>\$438,889</u>

依銀行借款合同規定，銀行信用借款要求本公司於借款存續期間內，每半年度及年度財務報表須符合某些財務比例限制。截至 109 年 12 月 31 日止，本公司各項財務比率均符合規定。

十七、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休計畫，係屬確定提撥退休辦法。本公司依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。依上述相關規定，本公司於 110 及 109 年度於綜合損益表認列為費用之金額分別為 52,296 仟元及 50,801 仟元。

(二) 確定福利計畫

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定福利退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算。本公司按員工每月薪資總額 2% 提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專

戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

列入資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	110年12月31日	109年12月31日
確定福利義務現值	\$ 51,048	\$ 52,804
計畫資產公允價值	(52,904)	(50,638)
淨確定福利(資產)負債	(<u>\$ 1,856</u>)	<u>\$ 2,166</u>

淨確定福利(資產)負債變動如下：

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債 (資 產)
110年1月1日	\$ 52,804	(\$ 50,638)	\$ 2,166
服務成本			
利息費用(收入)	184	(180)	4
認列於損益	184	(180)	4
再衡量數			
計畫資產報酬	-	(711)	(711)
精算損失—人口統計 假設變動	181	-	181
精算損失—財務假設 變動	859	-	859
精算損失—經驗調整	(2,380)	-	(2,380)
認列於其他綜合損益	(1,340)	(711)	(2,051)
雇主提撥	-	(1,975)	(1,975)
福利支付	(600)	600	-
110年12月31日	<u>\$ 51,048</u>	<u>(\$ 52,904)</u>	<u>(\$ 1,856)</u>
109年1月1日	\$ 49,458	(\$ 48,500)	\$ 958
服務成本	-	-	-
利息費用(收入)	370	(369)	1
認列於損益	370	(369)	1
再衡量數			
計畫資產報酬	-	(1,565)	(1,565)
精算損失—人口統計 假設變動	53	-	53
精算損失—財務假設 變動	2,615	-	2,615
精算損失—經驗調整	2,159	-	2,159
認列於其他綜合損益	4,827	(1,565)	3,262
雇主提撥	-	(2,055)	(2,055)
福利支付	(1,851)	1,851	-
109年12月31日	<u>\$ 52,804</u>	<u>(\$ 50,638)</u>	<u>\$ 2,166</u>

確定福利計畫認列於損益之金額依功能別彙總如下：

	110年度	109年度
管理費用	<u>\$ 4</u>	<u>\$ 1</u>

本公司因「勞動基準法」之退休金制度曝露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。
2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。
3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之計畫資產及確定福利義務現值，係由合格精算師進行精算。精算評價於衡量日之主要假設如下：

	110年12月31日	109年12月31日
折現率	0.70%	0.35%
薪資預期增加率	2.50%	2.00%
離職率	0.40%	0.48%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	110年12月31日	109年12月31日
折現率		
增加 0.25%	(<u>\$ 1,515</u>)	(<u>\$ 1,657</u>)
減少 0.25%	<u>\$ 1,578</u>	<u>\$ 1,729</u>
薪資預期增加率		
增加 0.25%	<u>\$ 1,546</u>	<u>\$ 1,697</u>
減少 0.25%	(<u>\$ 1,492</u>)	(<u>\$ 1,635</u>)
離職率		
增加 10%	(<u>\$ 56</u>)	(<u>\$ 74</u>)
減少 10%	<u>\$ 57</u>	<u>\$ 74</u>

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	110年12月31日	109年12月31日
預期1年內提撥金額	<u>\$ 1,710</u>	<u>\$ 1,823</u>
確定福利義務平均到期期間	12年	12年
未折現之退休金福利支付到期分析		
不超過1年	\$ 693	\$ 401
1~5年	5,971	4,801
超過5年	<u>48,665</u>	<u>49,660</u>
	<u>\$ 55,329</u>	<u>\$ 54,862</u>

十八、權益

(一) 普通股股本

	110年12月31日	109年12月31日
額定股數(仟股)	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
額定股本	<u>\$ 4,000,000</u>	<u>\$ 4,000,000</u>
已發行且付清股款之股數(仟股)	<u>271,364</u>	<u>271,364</u>
已發行股本	<u>\$ 2,713,643</u>	<u>\$ 2,713,643</u>

已發行之普通股每股面額為10元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為12,000仟股。

(二) 資本公積

	110年12月31日	109年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註)</u>		
股票發行溢價—普通股溢價	\$387,960	\$387,960
股票發行溢價—限制員工權利股票	<u>8,464</u>	<u>8,464</u>
	<u>\$396,424</u>	<u>\$396,424</u>

註：依照法令規定，超過票面金額發行普通股股票溢額所產生之資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金

股利或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定之盈餘分派政策，年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

另本公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，請參閱附註二七。

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之 50%。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部分依法令或主管機關規定分派。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認。

法定盈餘公積應提撥至其總額達公司實收股本總額為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損；公司無虧損者，得以法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分按股東原有股份之比例發給新股或現金。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就當年底之股東權益減項淨額（如現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損益等累計餘額）提列特別盈餘公積。嗣後股東權益減項金額如有減少，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

本公司於 109 年 5 月 28 日舉行股東常會，決議 108 年度之盈餘分配案如下：

	108年度
	<u>盈 餘 分 配 案</u>
年初未分配盈餘	\$ -
確定福利計劃之再衡量數	(772)
108 年度淨利	181,978
法定盈餘公積	(<u>18,120</u>)
年底未分配盈餘	<u>\$163,086</u>

本公司於 110 年 8 月 13 日舉行股東常會，決議 109 年度之盈餘分配案如下：

	109年度
	<u>盈 餘 分 配 案</u>
年初未分配盈餘	\$ 163,086
確定福利計劃之再衡量數	(3,262)
109 年度淨利	1,727,445
法定盈餘公積	(172,418)
現金股利	(<u>678,411</u>)
年底未分配盈餘	<u>\$1,036,440</u>
每股現金股利 (元)	<u>\$ 2.5</u>

本公司 111 年 2 月 10 日董事會擬議 110 年度盈餘分配案如下：

	110年度
	<u>盈 餘 分 配 案</u>
年初未分配盈餘	\$1,036,440
確定福利計劃之再衡量數	2,051
110 年度淨利	1,877,082
法定盈餘公積	(187,913)
現金股利	(<u>814,093</u>)
年底未分配盈餘	<u>\$1,913,567</u>
每股現金股利 (元)	<u>\$ 3</u>

有關 110 年度之盈餘分配案，尚待預計於 111 年 5 月 26 日召開之股東常會決議。

(四) 其他權益項目

員工未賺得酬勞

本公司股東會分別於 107 年 5 月 31 日及 105 年 6 月 14 日決議發行限制員工權利新股，相關說明參閱附註十九。

	110年度	109年度
年初餘額	\$ -	(\$ 464)
認列股份基礎給付費用	-	464
年底餘額	\$ -	\$ -

十九、股份基礎給付

(一) 適用國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」者

限制員工權利新股

本公司於 105 年 6 月 14 日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股，發行總額新台幣 15,000 仟元，每股面額 10 元，計 1,500 仟股，發行價格為零元（即無償發行），前述決議已於 105 年 6 月 27 日經金管會申報生效。

依據上述決議，本公司董事會於 106 年 2 月 17 日通過第一次發行限制員工權利新股總額為 15,000 仟元，每股面額 10 元，計 1,500 仟股，每股發行價格為新台幣零元（即無償）。本次發行係以 106 年 2 月 17 日為給與日及 106 年 3 月 15 日為發行日，給與日股票之公平價值為 41.70 元。

既得條件係指員工同時符合公司績效及個人績效，下述既得之股份以無條件捨去計算並以股為單位：

1. 第一年既得日（發行日起算期滿一年）：

公司績效 EPS（註 1）為正數且較前一年度成長 10%（含）以上；且個人績效於第一年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績 S（含）以上者，得分批既得 20% 股份。

2. 第二年既得日（發行日起算期滿兩年）：

公司績效 EPS 為正數且較前一年成長 10%（含）以上；且個人績效於第二年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績 S（含）以上者，得分批既得 20% 股份。

3. 第三年既得日（發行日起算期滿三年）：

(1) 公司績效 EPS 為正數且較前一年成長 10%（含）以上；且個人績效於第三年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績 S（含）以上者，得分批既得 26.7% 股份。

(2) 公司績效 EPS 大於新台幣 2 元（含）以上；且個人績效於第三年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績 S（含）以上者，得再分批既得 33.3% 股份。

附註：

1. 公司績效 EPS：係指既得日當年之前一年度經會計師查核簽證之財務報表揭露之基本每股盈餘。

2. 本公司對個人績效評等以 O（Outstanding）、S（Successful）、I（Improvement Needed）、U（Unacceptable）四個績效評等為原則。

員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利如下：

1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。

2. 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。

3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權益（包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積現金（股票））。

本公司另於 107 年 5 月 31 日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股，發行總額 5,000 仟元，每股面額 10 元，計 500 仟股，預計發行價格為每股 20 元，前述決議已於 107 年 6 月 28 日經金管會申報生效。

依據上述決議，本公司董事會於 107 年 8 月 3 日通過第一次發行限制員工權利新股總額為 1,000 仟元，每股面額 10 元，計 100 仟股，每股發行價格為 20 元。本次發行係以 107 年 8 月 3 日為給與日及 107 年 8 月 9 日為發行日，給與日股票之公平價值為 60.10 元。

本公司董事會另於 108 年 2 月 15 日通過第二次發行限制員工權利新股總額為 2,000 仟元，每股面額 10 元，計 200 仟股，每股發行價格為 20 元。本次發行係以 108 年 2 月 15 日為給與日及 108 年 2 月 25 日為發行日，給與日股票之公平價值為 42 元。

既得條件係指員工自獲配限制員工權利新股之日起屆滿三個月仍在職，即可既得 100% 股份。

員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利如下：

1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。
2. 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。
3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權益（包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積現金（股票））。

本公司於 110 及 109 年度認列之限制員工權利股票酬勞成本分別為零元及 464 仟元。

110 及 109 年度限制員工權利股票變動情形如下：

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
	股數（仟股）	股數（仟股）
年初餘額	-	267
本年度既得	-	(267)
年底餘額	<u>-</u>	<u>-</u>

二十、營業收入

(一) 客戶合約之說明

晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝

依客戶約定規格提供商品封裝服務產生之收入，由於客戶於封裝服務過程中即對商品取得控制，故本公司封裝服務合約係隨時間逐步認列收入。

晶圓測試

本公司於履行測試合約時，客戶同時取得並耗用本公司履約所提供之效益，本公司對迄今已完成履約之款項具有可執行之權利，故本公司係隨時間逐步認列測試合約之收入。

(二) 客戶合約收入之細分

產 品 別	110年度	109年度
晶圓級尺寸封裝	\$ 5,538,550	\$ 5,449,402
晶圓測試	1,390,701	1,100,993
晶圓級後護層封裝	648,869	667,381
其 他	89,223	59,813
	<u>\$ 7,667,343</u>	<u>\$ 7,277,589</u>

地 區 別	110年度	109年度
台 灣	\$ 6,029,429	\$ 5,887,354
美 國	1,536,767	1,207,220
歐 洲	64,549	82,566
其 他	36,598	100,449
	<u>\$ 7,667,343</u>	<u>\$ 7,277,589</u>

客 戶 別	110年度	109年度
晶圓廠代工公司	\$ 5,597,445	\$ 5,498,556
IC 設計公司	2,069,898	1,779,033
	<u>\$ 7,667,343</u>	<u>\$ 7,277,589</u>

產 品 應 用 別	110年度	109年度
消費性電子	\$ 6,587,452	\$ 6,454,500
車用電子	1,079,891	823,089
	<u>\$ 7,667,343</u>	<u>\$ 7,277,589</u>

(三) 合約餘額

	110年12月31日	109年12月31日	109年1月1日
<u>非關係人</u>			
合約資產	\$ 68,440	\$ 44,105	\$ 59,825
備抵損失	(68)	(44)	(60)
合約資產淨額	<u>68,372</u>	<u>44,061</u>	<u>59,765</u>
<u>關係人</u>			
合約資產	329,555	230,971	159,173
備抵損失	-	-	-
合約資產淨額	<u>329,555</u>	<u>230,971</u>	<u>159,173</u>
合計	<u>\$ 397,927</u>	<u>\$ 275,032</u>	<u>\$ 218,938</u>

合約資產之變動主要係來自滿足履約義務之時點與客戶付款時點之差異。

110及109年度認列(迴轉)預期信用損失之金額分別為24仟元及(16)仟元。

合約資產備抵損失之變動資訊如下：

	110年度	109年度
年初餘額	\$ 44	\$ 60
加：本年度提列(迴轉)減損 損失	<u>24</u>	(<u>16</u>)
年底餘額	<u>\$ 68</u>	<u>\$ 44</u>

(四) 部分完成之客戶合約

尚未全部滿足之履約義務受攤之交易價格及預期認列為收入之時點如下：

	110年12月31日	109年12月31日
<u>封裝服務</u>		
111年第1季履行	<u>\$397,927</u>	<u>\$ -</u>
110年第1季履行	<u>\$ -</u>	<u>\$252,790</u>
<u>測試服務</u>		
110年第1季履行	<u>\$ -</u>	<u>\$ 22,242</u>

二一、其他營業收益及費損淨額

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
出租資產收益（費損）		
租金收入	\$ 78,900	\$ 78,900
出租資產折舊	(16,361)	(16,400)
其他	(12,171)	(12,357)
	<u>50,368</u>	<u>50,143</u>
處分不動產、廠房及設備淨益	31,564	10,442
不動產、廠房及設備減損損失	-	(67,676)
其他	<u>372</u>	<u>6,411</u>
	<u>\$ 82,304</u>	<u>(\$ 680)</u>

二二、利息收入

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
利息收入		
銀行存款	<u>\$ 3,051</u>	<u>\$ 3,081</u>

二三、財務成本

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
利息費用		
銀行借款	\$ 393	\$ 14,578
租賃負債之利息	5,089	5,835
其他	<u>1,701</u>	<u>3,901</u>
	<u>\$ 7,183</u>	<u>\$ 24,314</u>

二四、其他利益及損失

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
透過損益按公允價值衡量之金 融工具淨利益	\$ 4,997	\$ 58,270
保險理賠收入	-	541
外幣兌換淨損失	(11,478)	(79,394)
其他	<u>1,405</u>	<u>6,313</u>
	<u>(\$ 5,076)</u>	<u>(\$ 14,270)</u>

二五、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

本年度認列於損益之所得稅組成如下：

	110年度	109年度
當年度所得稅		
當年度產生者	\$156,254	\$ 25,041
以前年度之調整	27,668	-
遞延所得稅		
與暫時性差異產生及迴轉有關	45,675	26,992
與所得稅抵減及虧損扣抵有關	92,055	(52,033)
認列於損益之所得稅費用	<u>\$321,652</u>	<u>\$ -</u>

會計所得與當年度所得稅費用之調節如下：

	110年度	109年度
稅前淨利	<u>\$2,198,734</u>	<u>\$1,727,445</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 439,747	\$ 345,489
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時應予調減之項目	(47,411)	(26,386)
未分配盈餘加徵	43,815	8,154
當年度抵用之投資抵減及虧損扣抵	(90,698)	(18,886)
未認列之虧損扣抵	(97,144)	(222,053)
未認列之暫時性差異	-	(111,610)
暫時性差異之產生及迴轉	45,675	25,292
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	27,668	-
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 321,652</u>	<u>\$ -</u>

(二) 遞延所得稅

資產負債表中之遞延所得稅資產分析如下：

	110年12月31日	109年12月31日
虧損扣抵	\$ -	\$ 92,055
暫時性差異		
折 舊	77,718	118,657
退款負債	4,607	11,334
未實現存貨損失	6,965	5,648
其 他	2,424	1,750
	<u>\$ 91,714</u>	<u>\$229,444</u>

遞延所得稅資產之變動如下：

	年 初 餘 額	認列於(損)益	年 底 餘 額
<u>110 年度</u>			
虧損扣抵	\$ 92,055	(\$ 92,055)	\$ -
暫時性差異			
折 舊	118,657	(40,939)	77,718
退款負債	11,334	(6,727)	4,607
未實現存貨損失	5,648	1,317	6,965
其 他	1,750	674	2,424
	<u>\$ 229,444</u>	<u>(\$ 137,730)</u>	<u>\$ 91,714</u>
<u>109 年度</u>			
虧損扣抵	\$ 151,632	(\$ 59,577)	\$ 92,055
暫時性差異			
折 舊	31,748	86,909	118,657
退款負債	11,768	(434)	11,334
未實現存貨損失	6,298	(650)	5,648
其 他	2,957	(1,207)	1,750
	<u>\$ 204,403</u>	<u>\$ 25,041</u>	<u>\$ 229,444</u>

(三) 未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之虧損扣抵及可減除暫時性差異

	110年12月31日	109年12月31日
虧損扣抵		
117 年度到期	\$ -	\$452,965
118 年度到期	-	32,757
	<u>\$ -</u>	<u>\$485,722</u>

(四) 所得稅核定情形

本公司截至 108 年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。各年度經國稅局核定之各項投資抵減稅額差額，業已適當調整入帳。

二六、每股盈餘

	110年度	109年度
基本每股盈餘	<u>\$ 6.92</u>	<u>\$ 6.37</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.86</u>	<u>\$ 6.33</u>

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金額 (分子)	股數 (分母) (仟 股)	每 股 盈 餘 (元)
<u>110年度</u>			
基本每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 1,877,082	271,364	<u>\$ 6.92</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>2,207</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	<u>\$ 1,877,082</u>	<u>273,571</u>	<u>\$ 6.86</u>
<u>109年度</u>			
基本每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 1,727,445	271,364	<u>\$ 6.37</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>1,449</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	<u>\$ 1,727,445</u>	<u>272,813</u>	<u>\$ 6.33</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則於計算稀釋每股盈餘時，係假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二七、費用性質之額外資訊

本年度淨利（損）係包含以下項目：

	110年度	109年度
(一) 不動產、廠房及設備暨使用權資產之折舊		
認列於營業成本	\$ 803,277	\$ 778,147
認列於營業費用	23,364	23,354
認列於其他營業收益及費損	<u>16,361</u>	<u>16,400</u>
	<u>\$ 843,002</u>	<u>\$ 817,901</u>

	110年度	109年度
(二) 無形資產之攤銷		
認列於營業成本	\$ 14,570	\$ 11,254
認列於營業費用	<u>3,590</u>	<u>8,355</u>
	<u>\$ 18,160</u>	<u>\$ 19,609</u>
(三) 發生即認列為費用之研究及 發展支出	<u>\$ 283,673</u>	<u>\$ 253,999</u>
(四) 員工福利費用		
退職後福利計畫 (參閱附註十 七)		
確定提撥計畫	\$ 52,296	\$ 50,801
確定福利計畫	<u>4</u>	<u>1</u>
	<u>52,300</u>	<u>50,802</u>
股份基礎給付 (參閱附註十九)		
權益交割之股份基礎給付	<u>-</u>	<u>464</u>
其他員工福利	<u>1,697,718</u>	<u>1,638,635</u>
	<u>\$ 1,750,018</u>	<u>\$ 1,689,901</u>
員工福利費用依功能別彙總		
認列於營業成本	\$ 1,392,192	\$ 1,338,820
認列於營業費用	<u>357,826</u>	<u>351,081</u>
	<u>\$ 1,750,018</u>	<u>\$ 1,689,901</u>

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。有關員工酬勞部分，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。

本公司 110 及 109 年度估列之員工酬勞、董事酬勞及報酬分別為 290,141 仟元及 262,300 仟元 (含獨立董事報酬分別為 2,520 仟元及 1,910 仟元)，係以稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為基礎按比率估列。其中 110 及 109 年度估列之員工酬勞及董事酬勞分別於 111 年 2 月 10 日及 110 年 2 月 23 日經董事會決議如下：

估列比例

	110年度	109年度
員工酬勞	11.50%	13.04%
董事酬勞	0.07%	0.06%

金額

	110年度		109年度	
	現	金	現	金
員工酬勞		\$285,941		\$259,117
董事酬勞		1,680		1,273

年度財務報告通過發布日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

本公司於 110 年 2 月 23 日經董事會決議發放之 109 年度員工酬勞、董事酬勞及報酬為 262,300 仟元（含獨立董事報酬 1,910 仟元），前述決議配發金額與本公司 109 年度財務報告認列之金額並無差異。

本公司於 109 年 2 月 11 日經董事會決議發放之 108 年度員工酬勞、董事酬勞及報酬為 30,297 仟元（含獨立董事報酬 1,800 仟元），前述決議配發金額與本公司 108 年度財務報告認列之金額並無差異。

上述有關本公司員工及董事酬勞相關資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二八、資本管理

本公司資本管理係以確保能夠繼續經營之前提下，藉由維持債務及權益餘額之平衡及最適化，以使股東報酬極大化。本公司之資本管理乃確保具有足夠之財務資源，以支應未來 12 個月內之營運資金需求、資本支出、研究發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。

二九、現金流量資訊

來自籌資活動之負債變動如下：

110 年 12 月 31 日

	110年1月1日	現金流量	非現金之變動 因指數變動而 影響租賃給付 金額之調整	其他（註）	110年12月31日
租賃負債	\$ 260,914	(\$ 43,967)	\$ 33,357	\$ 5,089	\$ 255,393

109 年 12 月 31 日

	109年1月1日	現金流量	非現金之變動		109年12月31日
			因指數變動而 影響租賃給付 金額之調整	其他(註)	
租賃負債	\$ 297,696	(\$ 47,603)	\$ 4,986	\$ 5,835	\$ 260,914

註：其他係租賃負債之財務成本。

三十、金融工具

(一) 金融工具之種類

	110年12月31日	109年12月31日
<u>金融資產</u>		
透過損益按公允價值衡量	\$ 7,006	\$ 10,245
按攤銷後成本衡量(註1)	<u>3,165,905</u>	<u>2,609,501</u>
	<u>\$ 3,172,911</u>	<u>\$ 2,619,746</u>
<u>金融負債</u>		
透過損益按公允價值衡量	\$ 18	\$ 58
按攤銷後成本衡量(註2)	<u>782,865</u>	<u>1,692,002</u>
	<u>\$ 782,883</u>	<u>\$ 1,692,060</u>

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款(含關係人)、其他金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款、應付工程及設備款、應付費用及其他流動負債及長期銀行借款(含1年內到期部分)等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(二) 財務風險管理目的

本公司致力於確保公司於必要時具有足夠且具成本效益之營運資本。本公司積極管理與營運活動相關之外幣匯率風險、利率風險、信用風險及流動性風險等，以降低市場之不確定性對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司之重要財務規劃，均經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。本公司財務部門於執行財務計劃時，均恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

(三) 市場風險

本公司曝露於外幣匯率變動及利率變動等市場風險，並使用衍生金融工具以管理相關風險。

1. 外幣匯率風險

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對報導期間結束日之外幣貨幣性項目，因匯率變動產生之不利影響計算。當新台幣對外幣產生不利之變動達百分之十，本公司於 110 及 109 年度之稅後淨利將分別增加及減少 9,055 仟元及 379 仟元，上述數字業已考慮避險合約及被避險項目之影響。

2. 利率風險

本公司之長期銀行借款係為浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。本公司將持續關注利率變化，或向銀行承作利率交換交易，以規避利率波動之風險，降低融資成本之不確定性。

有關利率風險之敏感度分析，係假設報導期間結束日之浮動利率借款於整個報導期間持有，當利率上升一百個基點(1%)，且其他條件固定不變的情況下，本公司上述浮動利率借款之利息費用稅後淨額於 110 及 109 年度將分別增加零元及 3,511 仟元。

(四) 信用風險管理

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項與投資活動產生之銀行存款。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險曝險係資產負債表所認列之金融資產帳面價值。

1. 營運相關信用風險

本公司流通在外之應收帳款主要係來自於全球之客戶群，且大部分應收帳款並未提供擔保品或信用保證。雖然本公司訂有相關程序監督管理並減少應收帳款之信用風險，但並不能保證該程序可以完全有效排除信用風險並避免損失。

本公司之信用風險主要係集中於本公司之前二大客戶。截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，應收帳款及合約資產合計數來自前述客戶之比率分別為 92% 及 95%。

2. 財務信用風險

本公司定期根據市場狀況以及履約交易對象之財務及信用狀況調整交易額度。此外，本公司亦透過挑選信用良好之金融機構作為交易對象以降低信用風險。

(五) 流動性風險管理

本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有足夠之流動資金以支應未來營運需求。本公司係透過維持適當之資金及銀行額度，以支應各項合約義務。

銀行借款對本公司而言係為一項重要流動性來源。截至 110 年及 109 年 12 月 31 日止，本公司未動用之銀行融資額度分別為 2,866,740 仟元及 3,063,470 仟元。

下表係按到期日及未折現之到期金額（含本金及利息）彙總列示本公司已約定還款期間之金融負債分析：

	110年12月31日					合計
	短於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上		
<u>非衍生金融負債</u>						
應付帳款	\$ 239,304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,304	
應付工程及設備款	154,336	-	-	-	154,336	
應付費用及其他流動負債	389,225	-	-	-	389,225	
租賃負債	<u>43,758</u>	<u>74,968</u>	<u>70,580</u>	<u>85,697</u>	<u>275,003</u>	
	<u>826,623</u>	<u>74,968</u>	<u>70,580</u>	<u>85,697</u>	<u>1,057,868</u>	
<u>衍生金融負債(資產)</u>						
遠期外匯合約						
流出	1,381,209	-	-	-	1,381,209	
流入	(1,388,197)	-	-	-	(1,388,197)	
	(<u>6,988</u>)	-	-	-	(<u>6,988</u>)	
	<u>\$ 819,635</u>	<u>\$ 74,968</u>	<u>\$ 70,580</u>	<u>\$ 85,697</u>	<u>\$ 1,050,880</u>	

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~5年	5~10年	10年以上
租賃負債	\$ 43,758	\$ 145,548	\$ 84,989	\$ 708

	109年12月31日				
	短於1年	2至3年	4至5年	5年以上	合計
<u>非衍生金融負債</u>					
應付帳款	\$ 317,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,729
應付工程及設備款	377,594	-	-	-	377,594
應付費用及其他流動負債	557,790	-	-	-	557,790
租賃負債	44,960	74,948	56,660	107,741	284,309
長期銀行借款	237,113	181,843	25,279	-	444,235
	<u>1,535,186</u>	<u>256,791</u>	<u>81,939</u>	<u>107,741</u>	<u>1,981,657</u>
<u>衍生金融負債(資產)</u>					
遠期外匯合約					
流出	1,397,545	-	-	-	1,397,545
流入	(1,407,732)	-	-	-	(1,407,732)
	(10,187)	-	-	-	(10,187)
	<u>\$ 1,524,999</u>	<u>\$ 256,791</u>	<u>\$ 81,939</u>	<u>\$ 107,741</u>	<u>\$ 1,971,470</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~5年	5~10年	10年以上
租賃負債	\$ 44,960	\$ 131,608	\$ 101,284	\$ 6,457

(六) 金融工具之公允價值

1. 按攤銷後成本衡量金融工具之公允價值

本公司按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於財務報表中之帳面金額趨近公允價值。

2. 認列於資產負債表之公允價值衡量

本公司以公允價值衡量之金融資產及金融負債，其衡量方式依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第1等級至第3等級：

(1) 第1等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。

(2) 第2等級輸入值：係指除第1等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。

(3) 第3等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

3. 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

公允價值衡量層級

本公司以重複性基礎按公允價值衡量之金融資產及金融負債，其公允價值層級如下：

	110年12月31日			
	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 7,006	\$ -	\$ 7,006
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 18	\$ -	\$ 18
	109年12月31日			
	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 10,245	\$ -	\$ 10,245
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 58	\$ -	\$ 58

本公司於 110 及 109 年度均未有第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

本公司於 110 及 109 年度均未有取得或處分以第 3 等級公允價值衡量之金融資產等情形。

衡量公允價值所採用之評價技術及假設

本公司金融資產及金融負債之公允價值之決定，係使用下列方法及假設為之：

- (1) 遠期外匯合約公允價值係以遠期匯率報價及相對應之殖利率曲線衡量。

三一、關係人交易

除已於其他財務報表附註揭露者外，本公司與關係人間之交易明細揭露如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
台灣積體電路製造股份有限公司 (台積公司)	具重大影響之投資者
采鈺科技股份有限公司(采鈺公司)	其他關係人

(二) 營業收入

關係人名稱	110年度	109年度
台積公司	<u>\$ 5,597,445</u>	<u>\$ 5,498,556</u>

本公司與關係人之銷貨交易，其交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異。

(三) 製造費用

關係人名稱	110年度	109年度
采鈺公司	\$750,919	\$900,292
台積公司	<u>-</u>	<u>848</u>
	<u>\$750,919</u>	<u>\$901,140</u>

本公司委託關係人之加工費用，係依據雙方議定之條件為之。

(四) 租金收入

關係人名稱	110年度	109年度
采鈺公司	<u>\$ 78,900</u>	<u>\$ 78,900</u>

本公司出租不動產、廠房及設備予關係人，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按月收取，相關之租金收入帳列其他收益及費損項下。

(五) 合約資產

關係人名稱	110年12月31日	109年12月31日
台積公司	<u>\$329,555</u>	<u>\$230,971</u>

110及109年度因關係人產生之合約資產並未提列備抵損失。

(六) 應收關係人款項 (不含合約資產)

關係人名稱	110年12月31日	109年12月31日
台積公司	<u>\$ 725,261</u>	<u>\$ 1,358,624</u>

流通在外之應收關係人款項未收取保證。110 及 109 年度應收關係人款項並未提列備抵損失。

(七) 其他流動資產

關係人名稱	110年12月31日	109年12月31日
采鈺公司	<u>\$ 65</u>	<u>\$ -</u>

(八) 應付費用及其他流動負債

關係人名稱	110年12月31日	109年12月31日
采鈺公司	\$114,584	\$182,509
台積公司	<u>59</u>	<u>-</u>
	<u>\$114,643</u>	<u>\$182,509</u>

本公司與關係人交易，若無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

(九) 主要管理階層薪酬

本公司 110 及 109 年度對董事及其他主要管理階層成員之薪酬總額如下：

	110年度	109年度
短期員工福利	\$ 58,900	\$ 48,249
股份基礎給付	-	129
退職後福利	<u>648</u>	<u>584</u>
	<u>\$ 59,548</u>	<u>\$ 48,962</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

三二、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註揭露者外，本公司於資產負債表日尚有下列重大或有負債及未認列之合約承諾：

(一) 本公司承諾購置之不動產、廠房及設備合約總價約為 84,210 仟元。

三三、具重大影響之外幣資產及負債資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	外	幣	匯率 (註)	帳面金額
<u>110年12月31日</u>				
<u>外幣資產</u>				
貨幣性項目				
美 金	\$	61,132	27.674	\$ 1,691,758
日 幣		88,562	0.2405	21,299
瑞士法郎		181	30.18	5,476
歐 元		7	31.32	231
<u>外幣負債</u>				
貨幣性項目				
美 金		7,130	27.674	197,302
日 幣		88,784	0.2405	21,353
瑞士法郎		181	30.18	5,476
歐 元		7	31.32	231
<u>109年12月31日</u>				
<u>外幣資產</u>				
貨幣性項目				
美 金		58,991	28.097	1,657,463
日 幣		96,231	0.2763	26,589
瑞士法郎		300	32.31	9,682
歐 元		33	35.02	1,148
<u>外幣負債</u>				
貨幣性項目				
美 金		9,468	28.097	266,034
日 幣		91,267	0.2763	25,217
瑞士法郎		300	32.31	9,682
歐 元		33	35.02	1,148

註：匯率係每單位外幣兌換為新台幣之金額。

本公司於 110 及 109 年已實現及未實現外幣兌換損益合計數請詳綜合損益表，由於外幣交易之功能性貨幣種類繁多，故無法按各重大影響之外幣分別揭露兌換損益。

三四、營運部門資訊

(一) 營運部門資訊

經依據主要營運決策者定期覆核用以分配資源及績效衡量之營運結果，本公司係屬單一營運部門。營運部門損益、資產及負債之衡量基礎與財務報表編製基礎相同，相關營運部門資訊請參閱前述之財務報表，收入細分資訊請參閱附註二十「營業收入」。

(二) 重要客戶資訊如下：

估本公司營業收入淨額百分之十以上之客戶明細如下：

客 戶	110年度		109年度	
	金 額	所佔比例 (%)	金 額	所佔比例 (%)
甲 公 司	\$ 5,597,445	73	\$ 5,498,556	76
乙 公 司	1,249,709	16	1,041,770	14

三五、附註揭露事項

(一) 重大交易事項：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形：無。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20% 以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)之比率	授信期間	單 價	授 信 期 間	餘 額	佔總應收票據、帳款之比率	
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	銷 貨	\$5,597,445	73%	月結 60 天	參閱附註三一	參閱附註三一	\$ 725,261	70%	—

8. 應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

帳列應收 款項之公司	交易對象	關係	應收關係人 款項餘額	週 轉 天 數	逾期應收關係人款項 金額	處理方式	應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵呆帳金額
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	\$ 725,261	68	\$ -	-	\$ 455,194	\$ -

9. 從事衍生性金融商品交易：請詳附註七。

(二) 轉投資事業相關資訊：無。

(三) 大陸投資資訊：無。

(四) 主要股東資訊：

1. 股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例：

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數	持 股 比 例
台積公司	111,281,925	41%

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10% 之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：無。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，有無發生財務週轉困難情事，及其對本公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	110 年度	109 年度	差異	
			金額	變動比率
流動資產	3,881,788	3,152,343	729,445	23.14
不動產、廠房及設備	3,892,324	4,054,174	(161,850)	(3.99)
無形資產	38,118	48,073	(9,955)	(20.71)
其他資產	360,390	500,596	(140,206)	(28.01)
資產總額	8,172,620	7,755,186	417,434	5.38
流動負債	1,400,533	1,987,204	(586,671)	(29.52)
非流動負債	555,909	752,526	(196,617)	(26.13)
負債總額	1,956,442	2,739,730	(783,288)	(28.59)
股本	2,713,643	2,713,643	-	-
資本公積	396,424	396,424	-	-
保留盈餘	3,106,111	1,905,389	1,200,722	63.02
其他權益	-	-	-	-
權益總額	6,216,178	5,015,456	1,200,722	23.94

重大變動項目說明(變動達 20%以上者)：

1. 流動資產增加主要係現金及約當現金增加 1,099,294 仟元、合約資產增加 122,895 仟元、應收帳款增加 84,747 仟元及應收關係人款項減少 633,363 仟元。
2. 無形資產減少主要係專門技術減少 4,251 仟元、專利權減少 7,493 仟元及電腦軟體增加 1,789 仟元。
3. 其他資產減少主要遞延所得稅資產減少 137,730 仟元。
4. 流動負債減少主要係一年內到期之長期銀行借款減少 233,333 仟元、應付工程及設備款減少 223,258 仟元、應付費用及其他流動負債減少 172,021 仟元、應付帳款減少 78,425 仟元及所得稅負債增加 93,546 仟元。
5. 非流動負債減少主要係長期銀行借款減少 205,556 仟元。
6. 負債總額減少主要係一年內到期之長期銀行借款減少 233,333 仟元、應付工程及設備款減少 223,258 仟元、應付費用及其他流動負債減少 172,021 仟元及長期銀行借款減少 205,556 仟元。
7. 保留盈餘及權益總額增加主要係 110 年度稅後淨利增加所致。

二、財務績效：

1.最近二年度經營結果分析

國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

項目	年度	110 年度	109 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額		7,667,343	7,277,589	389,754	5.36
營業成本		5,080,128	5,062,597	17,531	0.35
營業毛利		2,587,215	2,214,992	372,223	16.80
營業費用		461,577	451,364	10,213	2.26
其他營業收益及費損淨額		82,304	(680)	82,984	(12,203.53)
營業淨利		2,207,942	1,762,948	444,994	25.24
營業外收入及支出		(9,208)	(35,503)	26,295	(74.06)
稅前淨利(損)		2,198,734	1,727,445	471,289	27.28
所得稅費用		321,652	-	321,652	100.00
稅後淨利(損)		1,877,082	1,727,445	149,637	8.66

說明：(變動達 20%以上者)：

- 1.其他營業收益及費損淨額增加主要係不動產、廠房及設備減損損失減少 67,676 仟元及處分不動產、廠房及設備利益增加 21,122 仟元。
- 2.營業淨利及稅前淨利增加，主要係營收增加使得獲利同時增加。
- 3.營業外收入及支出增加主要係財務成本減少 17,131 仟元、兌換損失減少 67,916 仟元及透過損益按公允價值衡量之金融工具淨利益減少 53,273 仟元。
- 4.所得稅費用增加主要係以前年度產生之虧損扣抵於 110 年度已使用完畢。

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃

本公司致力於開發新型態之各類感測器之封裝及後護層技術，如 106 年下半年成功導入智慧型行動裝置品牌市場，並開始產生營收及獲利。為 5G 應用而開發之 GaN 高頻功率元件相關之後護層應用技術。因應集團之策略佈局，提供 12 吋晶圓測試並於 109 年進入量產，為公司帶來營收及獲利成長。未來將積極與客戶策略合作，共同開發創新技術，持續研發新型感測器封裝及後護層應用技術，以拓展行動裝置及工業市場應用。另基於行車安全及自動駕駛的趨勢，預估車用影像感測器封裝的市場需求將持續成長。車用電子產品具有高技術門檻、產品壽命長及營收穩定等特性，本公司將持續拓展車用及工業用影像感測器之客戶與服務。

三、現金流量：

(一) 最近一年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	110 年度	109 年度	增 (減) 金 額	變 動 比 例 (%)
營業活動		3,078,580	2,357,118	721,462	30.61
投資活動		(817,485)	(998,558)	181,073	(18.13)
籌資活動		(1,161,801)	(1,148,961)	(12,840)	1.12
合 計		1,099,294	209,599	889,695	424.47
1. 本期營業活動之淨現金流入較上期增加，主要係本期獲利增加所致。 2. 本期投資活動之淨現金流出較上期減少，主要係資本支出減少所致。 3. 本期籌資活動之淨現金流出較上期增加，主要係發放現金股利增加 678,411 仟元、償還銀行長期借款減少 797,222 仟元、舉借長期借款減少 150,000 仟元及支付利息減少 15,436 仟元所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫

本公司資金需求將以自有資金支應，尚無流動性不足之疑慮。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現 金流出量(3)	預計現金 剩餘(不足) 之數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措 施	
				投資計劃	理財計劃
2,112,281	2,291,337	(1,245,849)	3,157,769	—	—
1. 未來一年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流入主要來自於營業收現。 (2) 現金流出主要係資本支出及發放現金股利。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足之情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

110 年度資本支出主要係用於擴建 12 吋晶圓測試代工服務之無塵室與廠務設施、研發機台及 8 吋晶圓級封裝之產能轉換，本公司係以自有資金支應，故對本公司之財務業務應無重大不利之影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

無。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1.利率變動風險方面：

本公司之長期銀行借款利率係採浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。本公司將持續關注利率變化，或向銀行承作利率交換交易，以規避利率波動之風險，降低融資成本之不確定性。

假設利率上升一百個基點(1%)，且其他條件不變的情況下，本公司借款之利息費用稅後淨額在 110 及 109 年度將分別增加零元及 3,511 仟元。

本公司截至年報刊印日止無長期銀行借款餘額。本公司將持續關注利率變化，降低融資成本之不確定性。

2.匯率變動風險方面：

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。有關衍生性商品交易細節，請參考本年報第 139 頁。

3.通貨膨脹風險方面：

本公司除密切掌握原物料供需狀況，積極尋求兼具品質和價格競爭力的替代來源外，並致力於製程改良、良率改善及效率提升的成本縮減活動，以減少物價上漲的影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證之情形。本公司所從事之衍生性商品交易係以避險為目的，主要為規避外幣資產及負債之匯率風險。為了控管財務交易風險，本公司已依據相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」以及「取得或處分資產處理程序」(包括衍生性商品交易處理程序)。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

因應市場及客戶對感應器的需求，持續提供新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)、三維晶片封裝技術(3D IC package)等晶圓級封裝技術在各式感測器元件的應用，並以創新之晶圓級封裝技術服務將產品線擴展至微機電(MEMS)、功率場效電晶體、電源控制及類比元件等產品。111 年度預計投入之研發費用

為 319,996 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令。110 年相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何科技改變及產業變化之相關訊息及趨勢，未來也積極投入研發以提昇競爭力；同時本公司亦會持續推動資通安全相關計畫，降低資通安全風險，以達持續營運之目標。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司重視災害發生時的緊急應變準備（例如：颱風、地震、環境污染、資訊系統服務中斷、罷工、原物料或水電氣公用設施短缺等天然或人為災難），並已建立周全的應變計劃，包括在災難發生時成立專案應變小組的流程與步驟。在危機發生時，應變計劃會徹底分析事件原因、影響範圍、替代方案及各種狀況的解決方案，並提出適當的防範措施及重建方法。使本公司於事件發生時，將人員傷害、業務中斷以及財務衝擊降至最低，並維持營運順暢。本公司截至年報刊印日止並無重大影響正常營運及企業形象的風險事項發生。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：請參閱本年報第 151 頁。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司儘可能向不同供應商採購原物料，以確保原物料供應無虞，並降低集中採購風險。雖然本公司仍有從單一供應商取得部份原物料之情形，但本公司仍將持續找尋其他購買方式以降低購買集中的風險。

110 年度最大客戶台積電集團佔本公司銷貨淨額為 73%，本公司未來將積極開發新市場及新客戶，並與原有客戶保持良好的合作關係，持續降低風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

現有股東所持有本公司股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積公司仍是本公司最大股東，持有約 41% 股權。台積公司將持續在影像感測元件與微機電系統及晶圓測試等領域與本公司保持密切合作。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉案當事人及目前處理情形：

(1) 請求給付使用補償金民事訴訟案

經濟部於108年10月，在桃園地方法院對本公司提起請求給付土地使用補償金訴訟，主張本公司無權使用其坐落於工業區內之中壢區內壢段3744號土地(下稱系爭土地)，第一審桃園地方法院判決本公司勝訴。於上訴期間內，經濟部提出上訴，台北高等法院於110年12月判決經濟部上訴駁回，本公司第二審勝訴。惟，經濟部於三審上訴期間內，提出上訴，目前由最高法院審理中，本公司已委任律師處理相關訴訟事宜，初步評估對本公司之財務及業務不致產生重大影響。

(2) 非訟或行政爭訟事件：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司董事台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司)最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：如半導體產業其他多數公司常見的情形，台積公司不定期會接獲第三人的通知，主張台積公司的技術、製程或台積公司製造之半導體產品的設計或客戶之使用，有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。這些主張有時導致雙方間的訴訟(台積公司或為原告或為被告)及台積公司支付和解金。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少可能造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。此外，台積公司亦須遵守相關地區競爭法的規範並受到主管機關之監理，該等競爭法主管機關對台積公司發動之執法程序若其結果對台積公司不利，可能會損害台積公司之業務或影響台積公司之營運策略，從而對台積公司營運成果或展望造成負面影響，並使台積公司面臨潛在高度法律責任。

民國110年及截至年報刊印日止，並無台積公司為案件主體的重大法律案件。

上述董事-台積公司之訟訴事件係屬法人董事之商業行為所致，且與本公司並無關係，故對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：不適用。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

五、其他必要補充說明事項：無。

精材科技股份有限公司



負 責 人：陳 家 湘

